

A large, light blue arrow graphic pointing to the right, spanning the width of the page and partially overlapping the text.

**SCHNELLER
SCHLANKER
LEISTUNGSFÄHIGER**

Geschäftsbericht 2011

INHALT

KENNZAHLEN
& SEGMENT-
INFORMATIONEN

- 2 BRIEF AN UNSERE AKTIONÄRE
- 6 BERICHT DES AUFSICHTSRATS



10
KEINE KOMMUNIKATION
OHNE SMARTPHONE
UND TABLET-PC



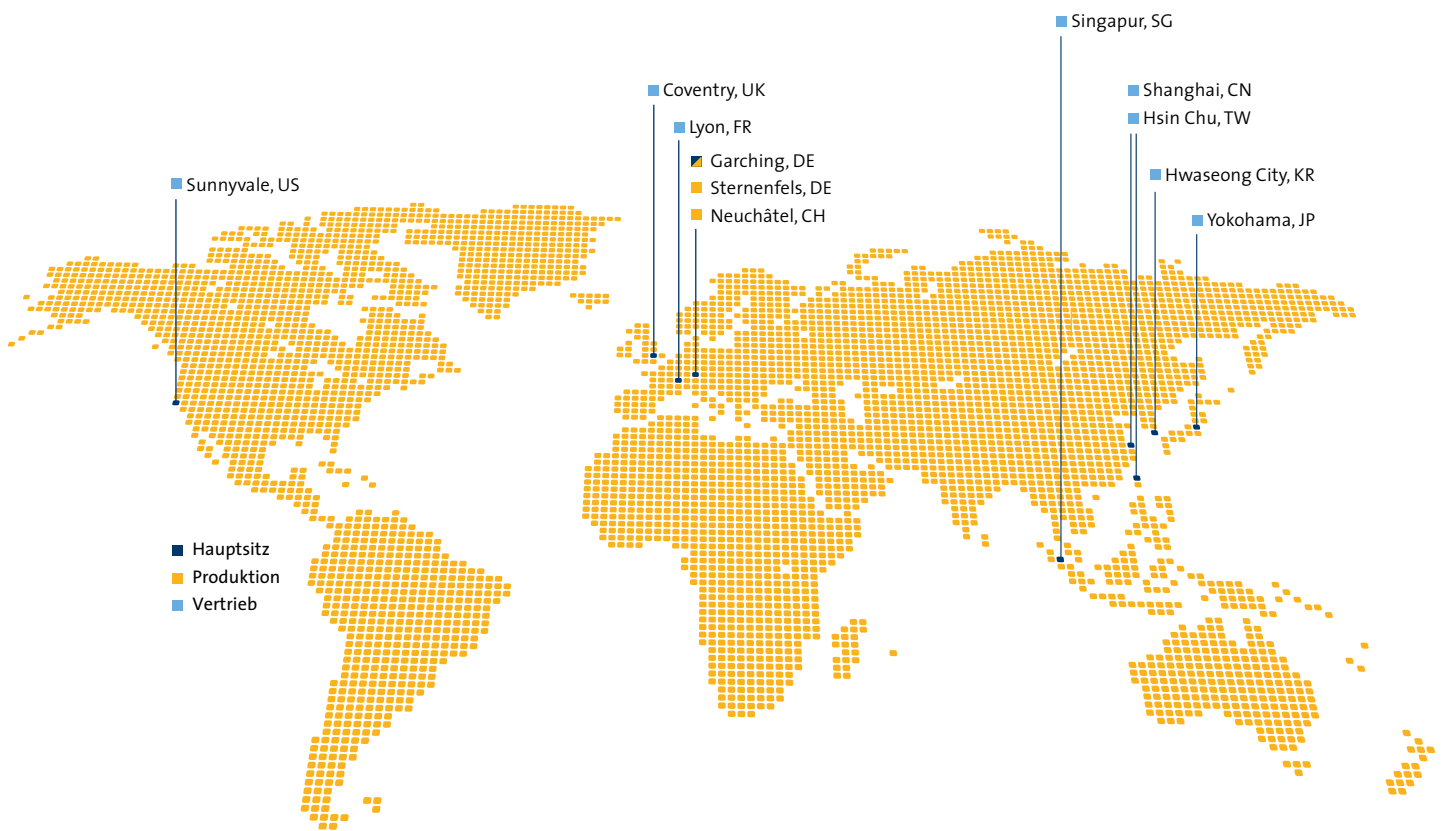
16
SCHNELL UND
SICHER ANS ZIEL –
AUCH ZU FUSS



20
GANZ
SCHÖN
HELLE

- 24 INVESTOR RELATIONS
- 28 CORPORATE GOVERNANCE
- 40 KONZERNLAGEBERICHT
- 73 KONZERNABSCHLUSS
- 88 KONZERNANHANG
- 146 SERVICE

SÜSS MICROTEC WELTWEIT



NORDAMERIKA

Mitarbeiter 81
Umsatz 29,5 Mio.€

EUROPA

Mitarbeiter 423
Umsatz 40,2 Mio.€

JAPAN

Mitarbeiter 24
Umsatz 13,0 Mio.€

SONSTIGES ASIEN

Mitarbeiter 96
Umsatz 92,8 Mio.€

KENNZAHLEN

in Mio. €	2011	2010	2009	Veränderung 2011 / 2010
FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN				
Auftragseingang	143,1	189,3	96,3	-24,4 %
Auftragsbestand zum 31.12.	83,7	116,1	57,0	-27,9 %
Umsatz gesamt	175,4	139,1	103,9	26,1 %
Umsatzrendite	7,9 %	9,3 %	0,5 %	-1,4 %-Punkte
Rohertrag	66,4	51,1	38,8	29,9 %
Rohertragsmarge	37,9 %	36,7 %	37,4 %	+1,2 %-Punkte
Herstellungskosten	109,1	88,0	65,1	23,9 %
Forschungs- und Entwicklungskosten	12,9	6,8	4,9	89,7 %
FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN				
EBITDA	24,9	20,5	7,6	21,5 %
EBITDA-Marge	14,2 %	14,7 %	7,3 %	-0,5 %-Punkte
EBIT	18,6	14,3	2,8	30,1 %
EBIT-Marge	10,6 %	10,3 %	2,7 %	+0,3 %-Punkte
Ergebnis nach Steuern	13,8	13,0	0,5	6,2 %
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,72	0,71	0,03	1,4 %
FORTGEFÜHRTE UND NICHT FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN				
Ergebnis nach Steuern	13,8	13,4	-4,9	3,0 %
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,72	0,73	-0,28	-1,4 %
Bilanz und Cashflow				
Eigenkapital	120,4	106,4	86,1	13,2 %
Eigenkapitalquote	64,1 %	58,6 %	63,1 %	+5,5 %-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	11,5 %	12,2 %	0,6 %	-0,7 %-Punkte
Bilanzsumme	187,7	181,6	136,4	3,4 %
Net Cash	42,0	34,6	18,4	21,4 %
Free Cashflow ⁽¹⁾	3,5	14,1	8,9	-75,2 %
Weitere Kennzahlen				
Investitionen ⁽²⁾	3,4	3,0	3,1	13,3 %
Investitionsquote	1,9 %	2,2 %	3,0 %	-0,3 %-Punkte
Abschreibungen	6,4	6,2	4,8	3,2 %
Mitarbeiter zum 31.12. ⁽³⁾	624	616	498	1,3 %
Mitarbeiter zum 31.12. ⁽⁴⁾	624	616	614	1,3 %

⁽¹⁾ vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben, Wertpapierverkäufen und Sondereffekten aus Erwerb und Verkauf von Tochtergesellschaften

⁽²⁾ ohne Berücksichtigung des Erwerbs HamaTech und des Grundstücks Sternenfels

⁽³⁾ fortgeführte Aktivitäten

⁽⁴⁾ fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten

SEGMENTINFORMATIONEN

FOTOMASKEN-EQUIPMENT

Umsatz 2011

36,3 MIO.€

EBIT 2011

5,3 MIO.€



PRODUKTE
Mask Track

ADRESSIERTE MÄRKTE
Halbleiterindustrie

LITHOGRAFIE

Umsatz 2011

111,5 MIO.€

EBIT 2011

25,5 MIO.€



PRODUKTE
Mask Aligner
Entwicklungssysteme
Spin- und Spray-Coater

ADRESSIERTE MÄRKTE
Advanced Packaging
Mikrosystemtechnik (MEMS)
Verbindungshalbleiter
3D-Integration

SUBSTRAT-BONDER

Umsatz 2011

20,5 MIO.€

EBIT 2011

-11,1 MIO.€



PRODUKTE
Substrat-(Wafer)-Bonder

ADRESSIERTE MÄRKTE
3D-Integration
Mikrosystemtechnik (MEMS)
Verbindungshalbleiter

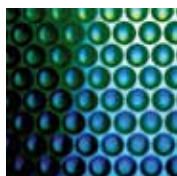
SONSTIGE

Umsatz 2011

7,1 MIO.€

EBIT 2011

-1,1 MIO.€



PRODUKTE
Masken
Mikrooptik und -linsen
C4NP

ADRESSIERTE MÄRKTE
Mikrooptik
Halbleiterindustrie
Advanced Packaging (C4NP)

Brief an unsere Aktionäre



*Liebe Aktionärinnen und Aktionäre,
meine Damen und Herren,*

lassen Sie uns heute gemeinsam auf eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre für SÜSS MicroTec zurückblicken. Wir haben ein Umsatzniveau von mehr als 175 Mio. Euro und ein EBIT von 18,6 Mio. Euro erreicht, darüber hinaus konnten wir unseren Bestand an liquiden Mitteln weiter ausbauen. Dies ist insbesondere bemerkenswert, da das Jahr 2011 von ökonomischen und finanzpolitischen Turbulenzen geprägt war.

Nachdem sich die Weltwirtschaft 2010 rasant von der Finanzkrise in 2009 erholt hatte und die Wirtschaft auch im ersten Quartal 2011 ein starkes Wachstum erfahren hat, verschlechterten sich die konjunkturellen Aussichten für die Weltwirtschaft seit dem Sommer 2011 zunehmend. Zur Jahresmitte blickten viele Unternehmen und Haushalte verstärkt pessimistisch in die Zukunft, was auf eine Eintrübung der Konjunktur hindeutete. Dieser Trend spiegelte sich auch an den Finanzmärkten wider, die seither von großer Kursvolatilität geprägt sind. Viele Unternehmen mussten in der zweiten Jahreshälfte deutliche Kursrückgänge hinnehmen. Dazu kommt die anhaltende Unsicherheit über den Ausgang der Staatsschuldenkrise in Europa. Die Ansichten hierzu gehen auch bei den Experten weit auseinander, sie reichen von der Erwartung des Auseinanderbrechens der Währungsunion bis hin zur Erwartung einer schnellen Lösung der Probleme und einer raschen Rückkehr auf den Wachstumspfad spätestens ab Mitte 2012. Sofern sich der europäische Finanzsektor stabilisiert, die Maßnahmen zur Krisenbewältigung erste Ergebnisse zeigen und es



FRANK AVERDUNG
Vorstandsvorsitzender

DER UMSATZ DES
GESCHÄFTSJAHRES
KONNTE GEGEN-
ÜBER DEM VORJAHR
UM RUND
26 PROZENT
GESTEIGERT
WERDEN.

gelingt, die derzeit vorherrschende Verunsicherung zu mildern, erwarten deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute eine schwache Expansion der europäischen Wirtschaft ab dem Frühjahr 2012, wie in der Gemeinschaftsprognose vom Herbst 2011 zu lesen ist.

Für SÜSS MicroTec war das abgelaufene Geschäftsjahr operativ in weiten Teilen von der Umsetzung und Etablierung der in den vorangegangenen zwei Jahren in Angriff genommenen Maßnahmen geprägt. Wir haben das Konzernportfolio nicht nur optimiert, sondern es ist uns darüber hinaus gelungen, die Komplexität der Unternehmensstruktur deutlich zu verringern. Erste Erfolge dieser Verschlinkung sind bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr realisiert worden. Bereiche wie Forschung und Entwicklung sowie Einkauf und Logistik arbeiten produktübergreifend. Die Zusammenführung der drei Produktlinien Coater/ Developer, Wafer Bonder und Fotomasken Equipment am Standort Sternenfels generiert bereits Effizienzen. Auch das Thema Synergien in der Bauweise der verschiedenen Maschinen – Stichwort Plattformstrategie – wurde weiter vorangetrieben. Da es sich hier um teilweise weitreichende Veränderungen in der Organisationsstruktur handelt, wird die finale Umsetzung der verschiedenen Projekte noch bis ins Jahr 2012 hineinreichen.

Wir haben den im Vorjahr eingeschlagenen Weg der Portfoliobereinigung und der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens durch den Verkauf der Süss MicroTec Precision Photomask Inc. fortgeführt. Im ersten Quartal 2012 konnte der Bereich Lithografie durch die Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. gestärkt werden.

DAS GESCHÄFTSJAHR IN ZAHLEN

Zum Jahresbeginn 2011 hatten wir an dieser Stelle vorsichtig optimistisch in die Zukunft geblickt und haben in der ersten Jahreshälfte 2011 sogar eine deutlich bessere Geschäftssituation vorgefunden, als noch am Jahresanfang erwartet. Diese positive Grundstimmung konnte sich trotz Natur- und Atomkatastrophe in Japan bis zum Sommer 2011 halten. Das spiegelte sich auch in den positiven Ergebnissen wider, die SÜSS MicroTec unterjährig berichten konnte. Betrachtet man nur das erste Halbjahr, so lag der Auftragseingang fast auf dem Niveau des sehr starken Vorjahres. Der Umsatz des ersten Halbjahres konnte gegenüber dem Vorjahr um rund 42 Prozent gesteigert werden. Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag zum 30. Juni 2011 deutlich über dem Wert des Vorjahres.

MICHAEL KNOPP
Finanzvorstand



Betrachtet man nun das gesamte Jahr 2011, so muss man feststellen, dass zum Jahresende eine erhebliche Eintrübung der Konjunkturaussichten stattgefunden hat, welche sich auch in den Auftragsbüchern von SÜSS MicroTec spiegelt. So beläuft sich der Auftragseingang im Gesamtjahr 2011 auf 143,1 Mio. Euro, was einen Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet (Vorjahr: 189,3 Mio. Euro). Der Umsatz konnte im Jahresvergleich deutlich gesteigert werden und lag mit 175,4 Mio. Euro um rund 26 Prozent über dem Wert des Vorjahres (Vorjahr: 139,1 Mio. Euro). Dieser starke Umsatzanstieg beruht zu einem großen Teil auf den sehr hohen Auftragseingängen und dem entsprechend hohen Auftragsbestand aus dem Jahr 2010 sowie dem starken Auftragseingang des ersten Quartals 2011.

Die Rohertragsmarge konnte im abgelaufenen Gesamtjahr gesteigert werden und lag für die SÜSS MicroTec-Gruppe bei 37,9 Prozent (Vorjahr: 36,7 Prozent). Das EBIT lag mit 18,6 Mio. Euro erneut über dem Wert des Vorjahres in Höhe von 14,3 Mio. Euro.

Das bereinigte EBIT beträgt 20,0 Mio. Euro (bereinigtes EBIT Vorjahr: 14,0 Mio. Euro) und war im Wesentlichen von finalen Restrukturierungskosten für die Verlagerung der Wafer Bonder von USA nach Deutschland in Höhe von 1,4 Mio. Euro beeinflusst. Das Ergebnis nach Steuern (EAT) belief sich auf 13,8 Mio. Euro nach 13,0 Mio. Euro im Vorjahr. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie (EPS) konnte gesteigert werden und betrug 0,72 Euro (Vorjahr: 0,71 Euro).

Der Free Cashflow belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapieren und Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten zum Ende des Geschäftsjahres auf 3,5 Mio. Euro nach 14,1 Mio. Euro im Vorjahr. Damit verfügte die SÜSS MicroTec-Gruppe zum 31. Dezember 2011 über liquide Mittel und verzinsliche Wertpapiere in Höhe von 56,4 Mio. Euro. Die Net Cash-Position erhöhte sich im Vergleich zum 31. Dezember 2010 von 34,6 Mio. Euro auf 42,0 Mio. Euro zum Jahresende.

MEILENSTEINE 2011

Neben den operativen Verlagerungsaktivitäten und der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens haben wir die Grundlage unseres Wachstums und Erfolgs, nämlich die Innovationen und Produktentwicklungen, gestärkt. So gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr wichtige Produkteinführungen, die unsere Position als einer der technologisch führenden Equipment-Anbieter in den von uns bedienten Märkten bekräftigt. Zu diesen Produktinnovationen gehört beispielsweise das MaskTrackPro InSync, ein neuentwickeltes System zur reibungslosen Synchronisierung der Prozessschritte, von der Reinigung über den Transport bis hin zur Inspektion und Lagerung der Maske.

Im Dezember 2011 haben wir mit dem Bond Cluster XBS300 die neueste Generation temporärer Bonder für die Volumenfertigung in den Markt eingeführt. Der Bond Cluster wurde bereits an einen strategisch wichtigen Kunden aus Asien ausgeliefert.

Auch im Jahr 2011 sind wir verschiedene Kooperationen, beispielsweise mit Forschungsinstituten bzw. Universitäten, zur Weiterentwicklung unseres Produkt- und Dienstleistungsspektrums eingegangen. An dieser Stelle sei die Zusammenarbeit mit der Cornell University, USA, im Bereich Nanoforschung sowie die Kooperation mit dem Centre for NanoHealth der Universität Swansea, Großbritannien, genannt. Auf der Prozessseite sind wir mit Brewer Science, USA, eine wichtige Kooperation im Hinblick auf Wafer Bonding und Thin Wafer Handling eingegangen.

Auf der Kapitalmarktseite gibt es aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr Erfreuliches zu berichten. Nach fünf Jahren ist SÜSS MicroTec im März 2011 wieder in den TecDAX – den Technologieindex der Deutschen Börse – zurückgekehrt.

Im Nachgang zur vollständigen Auflösung der Aktienposition von Sterling Strategic Value Investment im Dezember 2010, hat Sebastian Reppegather sein Aufsichtsratsmandat niedergelegt. Wir freuen uns, dass mit Gerhard Pegam, ehemals Vorstandsvorsitzender der EPCOS AG in München, ein Kenner der Technologiebranche als Nachfolger für Reppegather in den Aufsichtsrat eingetreten ist.

AUSBLICK

Die Weltwirtschaft zeichnet derzeit ein sehr uneinheitliches Bild. Während das Wachstum in den sogenannten Schwellenländern weiterhin robust ist und somit auch das Geschäftsvolumen in Nordamerika und Westeuropa befeuert, sind die Konjunkturaussichten, insbesondere für Westeuropa und Nordamerika, eher moderat. Belastet von der Unsicherheit, die die anhaltende Staatsschuldenkrise und die nicht enden wollende politische Diskussion mit sich bringt, sind die Endverbraucher eher vorsichtig in ihrem Konsumverhalten. Diese Kaufzurückhaltung bekam zum Jahresende 2011 auch das produzierende Gewerbe zu spüren, und es gab etliche Unternehmen, die ihre Ziele im Hinblick auf Auftragseingang nach unten korrigieren mussten. Für uns heißt dies konkret, dass einige unserer Kunden die Platzierung von Aufträgen hinausgezögert haben, da die Unsicherheit über die konjunkturelle Entwicklung 2012 weiterhin sehr hoch ist. In den ersten Monaten des Jahres 2012 hat sich die Stimmung zwar wieder etwas aufgehellt und Unternehmen, Konsumenten und auch die Börsen blicken wieder mit größerer Zuversicht in die Zukunft, aber viele Probleme, welche die Wirtschaft 2011 beschäftigt haben, bleiben weiterhin ungelöst.

Insgesamt rechnen wir für das Geschäftsjahr 2012 mit einem Umsatz von mehr als 145 Mio. Euro und einer EBIT-Marge zwischen fünf Prozent und zehn Prozent. Der freie Cashflow kann aus heutiger Sicht einen mittleren einstelligen Millionenbetrag erreichen. Entwickeln sich die von uns adressierten Märkte wie erwartet und stabilisieren sich die makroökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, gehen wir für 2013 von erneut steigenden Auftrags-eingängen und Umsätzen aus.

Alles in allem blicken wir zufrieden auf ein wiederum bewegtes Geschäftsjahr zurück und möchten hiermit allen Mitarbeitern für ihre tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung der verschiedenen Projekte danken.

Garching, im März 2012



Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand

Bericht des Aufsichtsrats



DER AUFSICHTSRAT MÖCHTE SIE, SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, IM NACHFOLGENDEN BERICHT ÜBER SEINE TÄTIGKEIT IM GESCHÄFTSJAHR 2011 INFORMIEREN.

SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

wir haben den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Tätigkeit überwacht. Damit ist der Aufsichtsrat seinen gesetzlichen Verpflichtungen sowie den in Geschäftsordnung und Satzung verankerten Aufgaben nachgekommen. In allen Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens stimmte der Vorstand mit uns ab. Der Vorstand unterrichtete uns regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und umfassend über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden uns im Einzelnen erläutert und von uns anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir auf Basis der Berichte des Vorstands ausführlich erörtert, und zu zustimmungspflichtigen Geschäften haben wir unsere Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2011 fanden insgesamt sieben ordentliche Sitzungen sowie eine außerordentliche Sitzung des Aufsichtsrats statt. An diesen Sitzungen haben stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats teilgenommen. Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.



DR. STEFAN REINECK
Aufsichtsratsvorsitzender

Der Aufsichtsratsvorsitzende stand über die Aufsichtsratsitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Es gab keine Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber unverzüglich offenzulegen waren und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre.

SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Die Finanzlage, die Investitions- bzw. Desinvestitionsprojekte sowie die Geschäftsentwicklung der SÜSS MicroTec AG, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns wurden im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. Der Vorstand unterrichtete umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Entwicklung von Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis. Der Aufsichtsrat hat sich darüber hinaus mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers befasst. Im Folgenden wird auf die Schwerpunkte der Aufsichtsrats-Sitzungen eingegangen.

Die erste ordentliche Aufsichtsratsitzung fand am 9. Februar 2011 statt. Hierbei befassten wir uns intensiv mit dem Bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2010 und zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2010. Der vom Vorstand vorgelegte Planung für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach ausführlicher Erörterung zugestimmt. Zudem wurden die Ziele für die erfolgsabhängige Vergütung des Vorstands erörtert. Der Aufsichtsrat diskutierte in dieser Sitzung auch die Vor- und Nachteile einer Umstellung auf Namensaktien. Außerdem legte der Aufsichtsrat Ziele hinsichtlich seiner Zusammensetzung fest.

An der zweiten Sitzung am 29. März 2011 haben Vertreter unseres Abschlussprüfers teilgenommen. Sie informierten den Aufsichtsrat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2010. Wir diskutierten mit den Vertretern des Abschlussprüfers Fragen der Bilanzierung sowie die wesentlichen Sachverhalte des abgelaufenen Geschäftsjahres und deren Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns. Des Weiteren erläuterte uns der Abschlussprüfer die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2010 und zur aktuellen Geschäftslage haben wir zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der

SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2010. Außerdem wurde Beschluss über den Bericht des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr gefasst. Weiterhin setzte der Aufsichtsrat die Ziele für die variable Vergütung des Vorstands fest. Darüber hinaus wurden die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung am 21. Juni 2011 beschlossen. Der Aufsichtsrat setzte sich in dieser Sitzung eingehend mit dem Thema TecDAX Zugehörigkeit auseinander und wurde zudem über den Status des Umzugs der Bonder-Aktivitäten von Waterbury, USA, nach Deutschland informiert. In dieser Sitzung haben wir des Weiteren über die Verlängerung der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden Frank Averdung und dessen Anstellungsvertrag diskutiert.

In der dritten ordentlichen Sitzung am 2. Mai 2011 hat sich der Aufsichtsrat mit den aktuellen Zahlen zum ersten Quartal 2011 und der Prognose für das Gesamtjahr befasst. Ferner wurde der Aufsichtsrat über den aktuellen Status des Umzugs des Bereichs Bonder informiert. Der Aufsichtsrat hat beschlossen, die Bestellung von Frank Averdung, dessen Amtszeit am 31. Januar 2012 ausgelaufen wäre, bis zum 31. Januar 2017 zu verlängern. Im Rahmen dieser Aufsichtsratsitzung hat der Aufsichtsrat darüber hinaus eine Umgestaltung von Teilaspekten des variablen Vergütungssystems der Vorstände. Des Weiteren wurde über die zukünftige Besetzung des Aufsichtsrats beraten, nachdem Herr Reppegather sein Amt mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 21. Juni 2011 niedergelegt hatte. Der Beschluss über den Wahlvorschlag an die Hauptversammlung wurde am 5. Mai 2011 im Umlaufverfahren gefasst. Im Anschluss an diese Sitzung hat der Aufsichtsrat seine Effizienzprüfung gemäß Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durchgeführt und dokumentiert. Dabei konnten keine Defizite festgestellt werden. Die Überprüfung der Effizienz der Aufsichtsrats-tätigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln und im Plenum unter Zuhilfenahme von unternehmensspezifischen Frage- und Checklisten statt.

In der Sitzung am 21. Juni 2011, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, hat uns der Vorstand vornehmlich über die aktuelle Geschäftslage informiert. Wir haben außerdem vom Vorstand ein Update zu den laufenden strategischen Projekten erhalten. Gerhard Pegam hat bereits als Gast an dieser Aufsichtsratssitzung teilgenommen.

Am 28. Juli 2011 fand die fünfte ordentliche Aufsichtsratsitzung statt. In dieser Sitzung wurde dem Aufsichtsrat ein erneutes Update der laufenden strategischen Projekte präsentiert. Insbesondere erörterten Vorstand und Aufsichtsrat die jüngste Geschäftsentwicklung des Geschäftes mit Fotomasken sowie strategische Optionen für die Weiterentwicklung der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc., vormals ITI Inc. Der Aufsichtsrat autorisierte den Vorstand, Verhandlungen mit möglichen Kaufinteressenten für die SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. aufzunehmen.

Der Vorstand erläuterte uns überdies die aktuellen Zahlen für das zweite Quartal. Der Aufsichtsrat fasste über die Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex Beschluss.

In einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats am 26. September 2011 hat der Vorstand den Aufsichtsrat über eines der laufenden strategischen Projekte informiert und vorgeschlagen, das Projekt im definierten Rahmen weiter zu verfolgen. Der Aufsichtsrat hat dem zugestimmt.

Am 12. Oktober 2011 stimmte der Aufsichtsrat dem Verkauf des Geschäftsbetriebs der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. im Wege eines Asset Deals zu.

In der ordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats vom 7. November 2011 berichtete der Vorstand über die aktuelle Geschäftslage im dritten Quartal sowie den Ausblick auf das Gesamtjahr. Darüber hinaus berichtete der Vorstand über den Status der laufenden strategischen Projekte. Weiterhin stellte der Vorstand den neuen Risikomanagementprozess und das dazugehörige Risikoreporting vor, nachdem zu Beginn des Jahres konzernweit eine Software zur Prozessunterstützung eingeführt worden war. Vorstand und Aufsichtsrat diskutierten im Anschluss den erstmals im neuen Berichtsformat erstellten Risikobericht zum 30. Juni 2011.

Gegenstand der letzten Sitzung des Geschäftsjahres 2011, die am 15. Dezember 2011 stattfand, waren im Wesentlichen die aktuelle Geschäftslage sowie die vorläufige Planung für das Geschäftsjahr 2012. Der Aufsichtsrat befasste sich ferner mit der Verlegung des Firmensitzes der SUSS Micro-Optics S.A. innerhalb von Neuchâtel und genehmigte das damit verbundene Budget. Darüber hinaus präsentierte der Vorstand dem Aufsichtsrat ein weiteres Update zum Stand der strategischen Projekte.

CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2011 erneut mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen sowie der ausführliche Bericht zu Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im separaten Corporate Governance-Bericht auf den Seiten 28 ff. des Geschäftsberichts widergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben in ihren Sitzungen am 28. Juli 2011 die Entsprechenserklärung nach § 161 AktG beschlossen und diese den Aktionären auf der Website der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, hat den nach HGB-Grundsätzen aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2011 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2011 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden gemäß § 315a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der Europäischen Union anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung sowie unter ergänzender Beachtung der International Standards on Auditing (ISA) vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 27. März 2012 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abgegeben und uns für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein. Schwerpunkte der diesjährigen Abschlussprüfung waren der Verkauf des Geschäftsbetriebes der SÜSS MicroTec Precision Photomask Inc., die Werthaltigkeit der Finanzanlagen sowie die Umsatzrealisierung sowie die Plausibilität der prognostischen Angaben.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht wurden von uns geprüft. Es bestanden keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers haben wir nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens haben wir zugestimmt.

VERÄNDERUNGEN IN AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

Zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2011 hat Sebastian Repegather sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats niedergelegt. Als sein Nachfolger wurde Gerhard Pegam von der Hauptversammlung gewählt.

Im Geschäftsjahr 2011 gab es keine personellen Änderungen im Vorstand.

In einem wirtschaftlich von großer Unsicherheit geprägten Marktumfeld ist die engagierte Mitarbeit jedes einzelnen Beschäftigten von außerordentlicher Bedeutung. Für die erfolgreiche und tatkräftige Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr spricht der Aufsichtsrat den Vorständen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank und Anerkennung aus.

Garching, 27. März 2012

Für den Aufsichtsrat

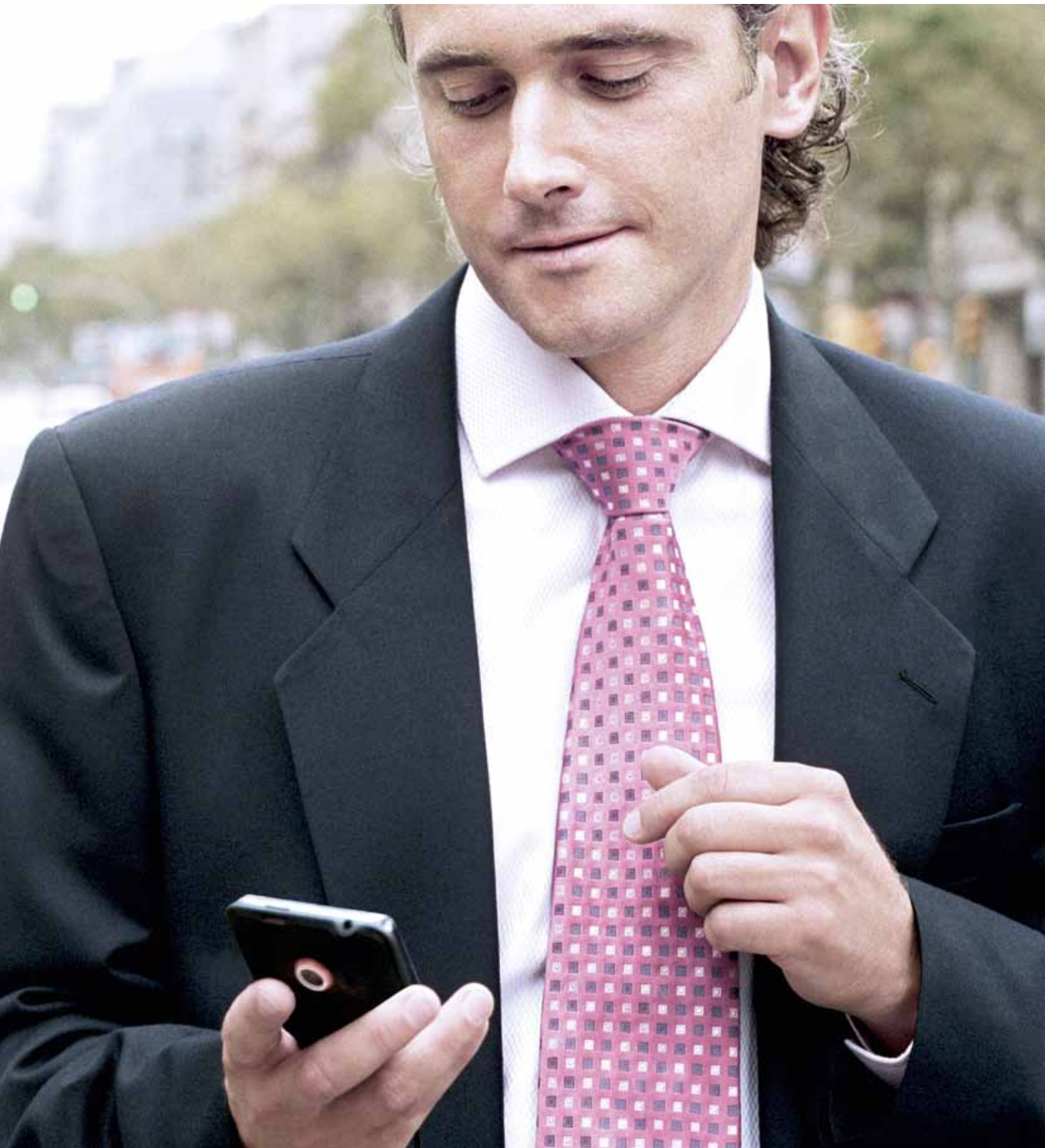


Dr. Stefan Reineck
Aufsichtsratsvorsitzender

HALBLEITER

KEINE KOMMUNIKATION OHNE SMARTPHONE UND TABLET-PC

DER MARKT FÜR SMARTPHONE UND TABLET-PCS HAT SICH IM LETZTEN JAHR RASANT ENTWICKELT. WURDEN 2010 WELTWEIT RUND 305 MILLIONEN SMARTPHONES VERKAUFT, WAREN ES 2011 BEREITS MEHR ALS 490 MILLIONEN STÜCK UND BIS 2015 SOLLEN ES LAUT EINER SCHÄTZUNG DES MARKTFORSCHUNGSINSTITUTS IDC MEHR ALS 900 MILLIONEN STÜCK SEIN.





XBS300

SÜSS MicroTecs XBS300 Bonder-Plattform repräsentiert die neueste Gerätegeneration für die Massenfertigung beim temporären Bonden von Wafern für 3D-Applikationen.

>> SCHNELLER

Hoher Durchsatz beim Aufbringen der Haft- und Release-Schichten

>> SCHLANKER

Offene Plattform für das temporäre Bonden von 200mm und 300mm Wafern

>> LEISTUNGSFÄHIGER

GYSET-Beschichtungsverfahren und hervorragende Dickenvariation der gebondeten Wafer, Unterstützung aller derzeit gängigen temporären Bondverfahren

>> KOSTENGÜNSTIGER

Geringe Betriebskosten bei allen verfügbaren Klebstoffen



SCHNELLER, SCHLANKER, LEISTUNGSFÄHIGER: DIES SIND GENAU DIE ATTRIBUTE, DIE EIN MODERNES SMARTPHONE ODER EINEN TABLET-PC AUSMACHEN. DER ENDKUNDE ERWARTET BEIM KAUF EINES NEUEN SMARTPHONES MEHR FUNKTIONALITÄT, MEHR SPEICHER UND IDEALERWEISE EINE LÄNGERE AKKULAUFZEIT ALS IN SEINEM ALTEN MOBILTELEFON.

„STATUS QUO“ IN DER HALBLEITERINDUSTRIE

Derzeit können in der Halbleiterindustrie Strukturgrößen von bis zu 22 Nanometern, dies entspricht 0,000022 Millimetern, in der Produktion dargestellt werden. Dazu kommen im Frontend der Halbleiterproduktion Lithografiegeräte zum Einsatz, die die sogenannte 193nm Immersionslithografie

einsetzen. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem das Licht mit einer Wellenlänge von 193 Nanometern ein System von Linsen und einen dünnen Flüssigkeitsfilm durchquert, bevor es den Fotolack auf der Oberseite des Wafers erreicht. Um diese besonders kleinen Strukturen darstellen zu können, musste bereits ab der Strukturgröße von

SÜSS MICROTEC UNTERSTÜTZT
DIE FORTSCHREITENDE
MINIATURISIERUNG



32 Nanometern die sogenannte Doppelstrukturierung (Double Patterning) eingesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Belichtung des Wafers mit zwei verschiedenen Masken in zwei Schritten vollzogen wird, um die erwünschten Strukturen darzustellen.

In der Halbleiterindustrie wurde bisher etwa alle zwei Jahre eine neue Generation von kleineren und leistungsfähigeren Mikrochips entwickelt. Damit war es möglich, auf einer gegebenen Fläche, bei unterproportionalem Kostenanstieg, mehr Mikrochips zu installieren. Diese Entwicklung nennt man in der Halbleiterindustrie „Moore’s Law“, benannt nach dem Intel Mitgründer Gordon Moore, der diese Gesetzmäßigkeit bereits im Jahr 1965 hergeleitet hat.

Nach heutigem Erkenntnisstand wird sich diese Entwicklung auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen, jedoch mit dem Unterschied, dass die Herstellung der einzelnen Mikrochips auf einer gegebenen Fläche nicht billiger, sondern teurer wird. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die neueste Maschinengeneration für die Herstellung noch kleinerer Strukturen deutlich teurer wird. Ein Beispiel hierfür sind Lithografiegeräte, welche die sogenannte EUV-Lithografie unterstützen. Hierbei handelt es sich um ein Fotolithografie-Verfahren, das extrem ultraviolette Strahlung (EUV) zur Belichtung nutzt. Dies soll es ermöglichen, auch zukünftig die Strukturverkleinerungen in der Halbleiterindustrie fortzusetzen, um kleinere, effizientere und schnellere integrierte Schaltkreise herstellen zu können. Diese deutlich teurere Technologie werden sich allerdings nur noch wenige große Halbleiterhersteller leisten können.

Neben der Verteuerung der einzelnen Mikrochips wird in absehbarer Zukunft eine „minimale Größe“ der Strukturen erreicht sein, ab welcher die physikalischen Eigenschaften der Mikrochips nicht mehr wie gewünscht funktionieren. SÜSS MicroTec unterstützt mit seiner Produktpalette die Kunden bei der weiteren Verkleinerung der Strukturgrößen der Mikrochips, beteiligt sich aber auch aktiv an der Entwicklung von alternativen Technologien, wie beispielsweise dem 3D Packaging und der 3D Integration. Der folgende Überblick zeigt die von SÜSS MicroTec bedienten Märkte und Technologien, welche die eben beschriebenen Entwicklungen im Halbleitersegment unterstützen.

FOTOMASKEN EQUIPMENT – UNTERSTÜTZUNG DER FORTSCHREITENDEN MINIATURISIERUNG

Wie eingangs beschrieben, ist die Halbleiterindustrie im Frontend seit Jahren bestrebt, die Leistungsfähigkeit der einzelnen Mikrochips durch fortschreitende Reduzierung der Strukturgrößen zu steigern und gleichzeitig deren Kosten zu verringern. Dieser Trend zur ständigen Miniaturisierung wird auch in Zukunft mit unverminderter Kraft die Innovationen und die technologische Weiterentwicklung im Frontend der Halbleiterfertigung treiben. Die gewünschten Strukturen werden im Frontend mittels lithografischer Verfahren und einer sogenannten Fotomaske auf den Wafer übertragen. Die Masken, die bei den Frontendprozessen in der Lithografie zum Einsatz kommen, sind sehr teuer und extrem empfindlich. Je kleiner die Strukturen, desto empfindlicher die Maske. Daher ist der Einsatz der adäquaten Technologien für die Entwicklung und die Reinigung äußerst wichtig. Ein Defekt auf der Maske bedeutet viele defekte Mikrochips. Mit unseren Reinigungsgeräten, die bereits bei der Herstellung und später im Einsatz dieser hochempfindlichen Fotomasken benötigt werden, unterstützt SÜSS MicroTec die weitere Entwicklung immer kleinerer Strukturen. In Fachkreisen wird dies häufig als 2D Skalierung bezeichnet, was nichts anderes bedeutet, als dass die einzelnen Mikrochips immer kleiner und kleiner werden und somit auf einer gegebenen Fläche mehr

Mikrochips untergebracht werden können. Treibende Kraft in dieser Hinsicht sind vor allem mobile Kommunikationsgeräte wie Smartphones, Tablet-PCs und Laptops, deren Leistungsfähigkeit von Jahr zu Jahr erhöht wird.

**Beim Advanced Packaging und der
Reinigung von Fotomasken unterstützt
SÜSS MicroTec den Trend zur stetigen
Verkleinerung der Strukturgrößen –
genannt 2D Skalierung oder
„Moore’s Law“.**

Auf der einen Seite führt die Ausweitung der 193nm Immersionslithografie zur doppelten oder mehrfachen Strukturierung, was die Empfindlichkeit der Strukturen exponentiell erhöht. Auf der anderen Seite entstehen gleichzeitig – mit der Verbreitung der EUV-Lithografie im Frontend – neue technologische Herausforderungen, welche nicht nur die Lithografiegeräte, sondern auch die Fotomaske selbst betreffen.

Die EUV-Strahlung, die eine sehr kurze Wellenlänge besitzt, wird bereits von einem atmosphärischen Umfeld vollständig absorbiert. Somit ist es notwendig, den Belichtungsprozess im Vakuum zu vollziehen. Weiterhin können keine refraktiven Optiken verwendet werden, sondern es müssen Spiegeloptiken eingesetzt werden. Die EUV-Maske ist aus mehr als 80 einzelnen Schichten aufgebaut – manche nur wenige Nanometer dick – und sie muss ebenfalls eine stark spiegelnde Oberfläche besitzen. Damit werden erneut andere und viel höhere Ansprüche an die Reinigung dieser Fotomasken gestellt. SÜSS MicroTecs Geräte und Prozesslösungen zur Reinigung von konventionellen Fotomasken, aber auch von Fotomasken, die in der EUV-Lithografie eingesetzt werden, sind weltweit führend und unterstützen die fortschreitende Strukturverkleinerung in der Halbleiterindustrie.

ADVANCED PACKAGING

Hierbei handelt es sich um eine alternative Verpackungstechnologie zum klassischen Wire Bonding. Mit dem Wire Bonding wird heute der größte Teil der Mikrochips verdrahtet, denn bisher kommt es nicht bei allen Anwendungen auf die Größe der einzelnen Bauteile an. In einem Fernsehgerät ist beispielsweise genug Platz, um vergleichsweise großzügig verpackte Mikrochips zu verbauen. Mit der zunehmenden Verbreitung von ultraflachen Laptops, Tablet-PCs und Smartphones wird die Packungsdichte weiter an Bedeutung gewinnen. In diesen Endgeräten kommen bereits heute ausschließlich Advanced Packaging-Technologien zum Einsatz. Mit unseren Coatern werden Fotolacke mittels Spin- oder Spraycoatingverfahren auf den Wafer aufgebracht und ausgehärtet. Nach dem Belichten in einem Mask Aligner wird die belichtete Fotoschicht in unserem Developer entwickelt. Damit decken die Geräte von SÜSS MicroTec wesentliche Prozessschritte im Advanced Packaging ab und helfen den Kunden, immer leistungsfähigere Komponenten zu möglichst günstigen Preisen und auf kleinstem Raum herzustellen.

**Mit unseren Lösungen zum 3D Packaging
und der 3D Integration unterstützen wir
den Trend des Übereinanderstapelns von
gedünnten Wafern in die dritte Dimension
– auch „More than Moore“ genannt.**

3D INTEGRATION – „MORE THAN MOORE“

Die Verkleinerung der Strukturgrößen – entsprechend Moore's Law – war in der Vergangenheit technologisch möglich und ökonomisch sinnvoll, denn trotz Leistungssteigerung reduzierten sich die Kosten pro Transistorfunktion. Heute gerät jedoch die herkömmliche Lithografie an ihre Grenzen. Es gibt alternative Technologien, wie beispielsweise die

bereits beschriebene EUV-Lithografie, die aber die Entwicklung und Herstellung verteuern. Aus diesem Grund werden nur diejenigen Chiphersteller den Weg der weiteren Strukturverkleinerung beschreiten, die weiterhin auf eine höhere Leistungsfähigkeit angewiesen sind. Hersteller, deren Ziel es ist, eine höhere Komplexität auf engem Raum darzustellen, können alternativ den Weg der 3D Integration gehen.

Um die Leistungsfähigkeit eines Computers, Tablet-PC's oder Smartphones zu erhöhen, sind nicht notwendigerweise kleinere Strukturen notwendig, alternativ kann man mehrere Mikrochips mit verschiedenen Funktionen übereinander stapeln und so die Komplexität erhöhen. Besonders bei einem Smartphone oder Tablet-PC ist jedoch der Raum, der einem einzelnen Baustein zur Verfügung steht, äußerst begrenzt. Es muss somit sichergestellt sein, dass der Stapel, bestehend aus mehreren Bausteinen, nicht größer ist als der ursprünglich vorgesehene Platzbedarf eines einzelnen Mikrochips. Das erreicht man, indem man die einzelnen Mikrochips dünnt und elektrisch miteinander verbindet. Dies erfolgt durch sogenannte Through Silicon Vias (TSV). Da die gedünnten Wafer äußerst instabil und zerbrechlich sind, müssen sie vor dem Dünnen auf einen Träger aufgebracht werden. Diesen Vorgang nennt man temporäres Bonden. Das endgültige Zusammenfügen und Stapeln der einzelnen Wafer passiert beim permanenten Bonden.

Wir unterstützen diese Entwicklung mit Geräten und Prozesslösungen, die rund um das Thema Thin Wafer Handling angesiedelt sind. Unser Produktportfolio umfasst komplette Anlagenlösungen für das Aufbringen und Wiederablösen sowie das anschließende Reinigen der Wafer beim temporären Waferbonden. Anschließend werden die vielen metallischen Anschlusspunkte auf den einzelnen Mikrochips, die sich noch immer auf dem Wafer befinden, unter hohem Druck und hoher Temperatur permanent miteinander verbunden. Auch dies geschieht auf unseren Maschinen, den Wafer Bondern. Schlussendlich erfolgt dann das Vereinzeln der gestapelten Mikrochips.



GYRSET COATING TECHNOLOGIE
SÜSS MICROTEC



MEMS

SCHNELL UND SICHER ANS ZIEL – AUCH ZU FUSS

DAS ANGEBOT AN NAVIGATIONSLÖSUNGEN IST UNGEBROCHEN
GROSS: FESTEINBAU, NAVI-APPS FÜRS SMARTPHONE UND
PORTABLE LOTSEN BUHLEN UM DIE GUNST DER KUNDEN.
BELIEBT BEI NUTZERN, DIE HÄUFIG VERSCHIEDENE FAHRZEUGE
FAHREN, IST DIE GRUPPE DER PORTABLEN NAVIGATIONSSYSTEME.





GAMMA - COATER / DEVELOPER

Die Gamma Plattform, mit ihren Modulen wie Spin- und Sprühbelacker oder Nassentwickler, dient zur vollautomatischen Bearbeitung von Fotolacken und erfüllt alle Anforderungen der Industrie an saubere, zuverlässige und durchsatzstarke sowie kostengünstige Fotolithografie-Prozesse.

» SCHNELLER

Unterschiedliche Wafergrößen können gleichzeitig ohne mechanischen Umbau prozessiert werden.

» SCHLANKER

Hohe Wartungsfreundlichkeit durch leichten Zugang zu allen wichtigen Komponenten

» LEISTUNGSFÄHIGER

Geeignet für Substrate aus Silizium, III / V-Halbleitermaterialien, Saphir, Glas oder flexiblem Kunststoff

» KOSTENGÜNSTIGER

Konfigurierbar für Kleinserien und für die Massenproduktion



DER MARKT FÜR MIKROELEKTROMECHANISCHE SYSTEME (MEMS) HAT SICH IN DEN VERGANGENEN ZWEI JAHREN SEHR DYNAMISCH ENTWICKELT. NAHEZU TÄGLICH KOMMEN IN DIESEM MARKTSEGMENT NEUE ANWENDUNGEN HINZU. MEMS WERDEN IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE, TELEKOMMUNIKATION, KONSUMELEKTRONIK UND MITTLERWEILE AUCH VERSTÄRKT IN DER MEDIZINTECHNIK EINGESETZT.

FERTIGUNG DER KLEINEN HELFER

Bei der Herstellung von MEMS-Bausteinen werden die gleichen bekannten Technologien und Prozesse eingesetzt, wie in der Halbleiterfertigung. Aus der SÜSS MicroTec Produktpalette kommen hierfür sowohl die Coater / Developer als auch Wafer Bonder und Mask Aligner zum Einsatz. Die Lithografiegeräte werden hier beispielsweise zur Strukturierung von Ätzmasken und elektrischen Kontakten oder zur Herstellung von kleinsten mechanischen Strukturen wie Mikrozahnradern verwendet. Unsere Wafer Bonder werden in der Fertigung zum hermetischen Kapseln der MEMS-Bauelemente eingesetzt.

VORSPRUNG DURCH ERFAHRUNG

Die Spin- und Sprühbelacker von SÜSS MicroTec stehen seit vielen Jahren für erstklassige Leistung, einfache Bedienung und große Flexibilität. Es ist uns gelungen, diese jahrzehntelange Erfahrung im Belacken und Entwickeln auf den vergleichsweise jungen Markt der MEMS-Fertigung zu übertragen. Mit unserem Prozessequipment zur MEMS-Herstellung haben wir uns als Marktführer insbesondere für hochwertige MEMS-Produkte auf Wafer-Ebene positioniert und sind somit zu einem der wichtigsten Lieferanten innovativer Lösungen im MEMS-Markt geworden. Mit unserer umfassenden Produktpalette aus kompakten und benutzerfreundlichen Spin- und Sprühbelackern, die vom preiswerten Laborgerät bis hin zur hochleistungsfähigen Produktionsanlage reicht, können beispielsweise Fotolackschichten von unter einem Mikrometer bis über einige 100 Mikrometer in der gleichen Prozesskammer erzielt werden. Damit schaffen wir Prozessflexibilität, verkürzen die Umrüstzeiten für unsere Kunden und erhöhen somit die Menge an Wafern, die auf unseren Maschinen pro Stunde bearbeitet

werden können. Mit all diesen Maßnahmen unterstützen wir unsere Kunden, die vom Endverbraucher nachgefragten Produkte zu einem wettbewerbsfähigen Preis herzustellen.

Die Verwendung von MEMS in Mobiltelefonen wird sich zukünftig nicht mehr nur auf das Drehen der Bildschirmdarstellung, Stromsparfunktionen, Bewegungserkennung, einen elektronischen Kompass und 3D-Spiele beschränken, sondern es wird weitere Funktionen geben, die dem Anwender zusätzliche Informationen liefern und das Leben erleichtern.

EIN MEMS-BAUSTEIN MIT POTENZIAL: DER ELEKTRONISCHE KOMPASS

Die zunehmende Leistungsfähigkeit der Smartphones und anderen mobilen Geräten hat zu einer fast serienmäßigen Ausstattung dieser Geräte mit Sensoren geführt, die deren Bewegungen und Standort erfassen. Diese elektronischen Kompass, Drehratensensoren und Beschleunigungsmesser unterstützen nicht nur ortsbasierte Dienste, sondern auch die Steuerung der Geräte mittels Kippen oder Drehen. Elektronische Kompass beispielsweise werden heute wie integrierte Schaltkreise mittels Lithografieverfahren aus Halbleitermaterialien hergestellt.

In modernen Mobiltelefonen sind heute standardmäßig Navigationssoftware und die nötige Hardware enthalten. Allein der Markt für MEMS-basierte elektronische Kompass ist nach Einschätzung der Experten von IHS iSuppli 2011 um mehr als 70 Prozent gewachsen. Damit dürfte dieses Marktsegment im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Größe von rund 420 Millionen US-Dollar erreicht haben. Weiterhin wird erwartet, dass sich dieser Markt bis 2015 noch einmal verdoppeln wird. In naher Zukunft wird es selbstverständlich sein, z.B. die Kamera in einem Smartphone auf ein bestimmtes Objekt zu richten und unmittelbar Informationen zu diesem

Objekt und zu Sehenswürdigkeiten oder Restaurants und Geschäften in der Nähe zu bekommen. Diese zunehmende Funktionalität in den mobilen Endgeräten wird auch in Zukunft dazu führen, dass die Komplexität und Leistungsfähigkeit der einzelnen Bauelemente weiter gesteigert werden muss. Hierzu leistet SÜSS MicroTec mit den Maschinen und Prozesslösungen einen wertvollen Beitrag.

Die Einsatzmöglichkeiten von MEMS sind sehr vielfältig und die Wachstumsperspektiven sind nach wie vor enorm. Findet man heute beispielsweise in einem modernen Mobiltelefon etwa neun MEMS-Funktionen, so soll sich dieser Anteil laut Expertenschätzungen in den nächsten Jahren mehr als verdoppeln.

WEITREICHENDE EINSATZMÖGLICHKEITEN VON MEMS

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der MEMS-Markt sehr stark durch die wachsende Anzahl von Smartphones und Tablet-PCs getrieben. Es gibt darüber hinaus noch vielfältige Anwendungsbereiche für MEMS-Bausteine im Automotive-Bereich, der Konsumelektronik und in medizinischen Anwendungen. Dazu gehören im Einzelnen Sensoren für Druck-, Beschleunigungs- und Drehratenmessung sowie Bausteine im Optikkbereich und der Mikrofluidik.

Der Preisdruck sowie die Notwendigkeit, die einzelnen MEMS-Bausteine stetig zu verkleinern, sind nach wie vor enorm hoch. Die Anlagen und Lösungen von SÜSS MicroTec unterstützen die Kunden dabei, diese Vorgabe erfolgreich umsetzen zu können, z.B. durch innovative, kosteneffiziente und leistungsstarke Geräteplattformen mit intelligenter Ablaufsteuerung.



BLICK IN DAS
INNENLEBEN EINES
COATER / DEVELOPER

LED

GANZ SCHÖN HELLE

LEDS SIND WEITERHIN AUF DEM BESTEN WEGE, GLÜHBIRNEN ALS WICHTIGSTE KÜNSTLICHE LICHTQUELLE ABZULÖSEN. DER LED-MARKT TEILT SICH GENERELL IN MASSENARTIKEL, HIGH BRIGHTNESS-LEDS UND ULTRA HIGH BRIGHTNESS-KOMPONENTEN, WOBEI JEDES MARKTSEGMENT SEINE EIGENEN HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN BIRGT.





MA100E GEN2 - MASK ALIGNER

Die zweite Generation dieses Mask Aligners ist eine von SÜSS MicroTec speziell für die Herstellung von LEDs entwickelte Lithografie-Lösung.

>> SCHNELLER

Die gleichzeitige Verarbeitung von drei Wafern ermöglicht einen hohen Durchsatz von bis zu 145 Wafern pro Stunde.

>> SCHLANKER

Hohe Auflösung von bis zu $2,5 \mu\text{m}$ L/S bei einer Abstandsbelichtung von $20 \mu\text{m}$

>> LEISTUNGSFÄHIGER

Die beugungsreduzierte Optik von SÜSS MicroTec ermöglicht Abstandsbelichtung selbst bei anspruchsvollen Auflösungsanforderungen.

>> KOSTENGÜNSTIGER

Senkung der Kosten per Lumen für unsere Kunden durch einen hohen Durchsatz bei gleichzeitig hoher Ausbeute



NICHT ZULETZT DURCH DIE STEIGENDE TECHNISIERUNG UNSERES ALLTÄGLICHEN LEBENS UND DIE DAMIT EINHERGEHENDE RASANTE VERBREITUNG VON LEDS, DIE IN COMPUTERBILDSCHIRMEN, FERNSEHERN, AUTOMOBILBELEUCHTUNG UND MOBILTELEFONEN ZUM EINSATZ KOMMEN, HAT SICH DER MARKT FÜR LEDS IM VERGANGENEN JAHR SEHR DYNAMISCH ENTWICKELT.

DER LED-MARKT

Dieser Beleuchtungsmarkt lässt sich im Wesentlichen in drei Hauptsegmente einteilen. Es gibt einen Markt für Massenartikel, die beispielsweise als Statusanzeige in elektronischen Geräten zum

Einsatz kommen und die zu Preisen von etwa zehn Dollarcent zu haben sind. Im Massen-LED-Markt ist der Stückpreis ausschlaggebend und dieser ist abhängig von den Gesamtkosten für die Herstellung der einzelnen Bauteile. Das mittlere Marktsegment wird von den sogenannten High Brightness-LEDs abgedeckt. Hierbei handelt es sich um LEDs, die gegenwärtig verstärkt in der Automobilbranche, z.B. für die Rückbeleuchtung, eingesetzt werden. Der Markt für Ultra High Brightness-Komponenten, die einen Stückpreis von ein bis drei US-Dollar haben, deckt beispielsweise den Bereich Gebäude- und Straßenbeleuchtung ab. Dieser Markt wird zukünftig mehr an Bedeutung gewinnen, da Länder wie China, die heute noch am Beginn der großflächigen Elektrifizierung stehen, aufgrund der steigenden Rohstoff- und Energiepreise umweltfreundliche, kostengünstige und energieeffiziente Technologien einsetzen müssen.



SÜSS MICROTEC
BIETET VIELSEITIGE
LÖSUNGEN

TRENDWENDE IN DER BELEUCHTUNGSINDUSTRIE

Betrachtet man den speziellen Bereich Gebäude- und Straßenbeleuchtung, so haben die steigenden Energiepreise und das wachsende Umweltbewusstsein der Menschen – nicht nur in China – eine Trendwende eingeleitet. War noch vor einigen Jahren die Glühbirne das Leuchtmittel der Wahl, so haben sich heute wegen der steigenden Energiepreise viele Konsumenten für den Kauf von Energiesparlampen entschieden, auch wenn diese deutlich teurer als herkömmliche Glühbirnen sind. Mittlerweile haben auch die Gesetzgeber diesen Trend bzw. die Notwendigkeit zur effizienten Nutzung der Energie erkannt und die Glühbirne mittelfristig aus dem Handel verboten. Doch auch der Einsatz von Energiesparlampen ist keine dauerhafte Lösung, denn deren Entsorgung bereitet aufgrund des Quecksilbergehalts im Sockel der Lampe neue umwelttechnische Probleme und Belastungen. Eine aus heutiger Sicht praktikable Lösung ist der Einsatz von den sogenannten Ultra High Brightness-LEDs. Diese Form der Beleuchtung ist derzeit noch vergleichsweise teuer, wird aber langfristig die Glühbirne und auch die Energiesparlampe, insbesondere in Wohn- und Geschäftsräumen sowie der Straßenbeleuchtung, ersetzen.

Auch wenn sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2011 deutlich verlangsamt hat, ist die mittel- bis langfristige Wachstumsperspektive weiterhin sehr groß.

UNSERE GERÄTE UND PROZESSLÖSUNGEN UNTERSTÜTZEN LED-HERSTELLER

Die verschiedenen Verbindungshalbleiter (hier LEDs) stellen besondere Anforderungen an die Maschinen, mit denen sie verarbeitet werden, und zwar sowohl im Hinblick auf die Wafergröße als auch auf die Bruchigkeit oder Porosität des Materials. Die Anlagen von SÜSS MicroTec sind eigens auf diese Herausforderungen zugeschnitten und optimiert. Unsere komplette Produktpalette für die LED-Herstellung wurde

für eine größtmögliche Flexibilität und höchsten Durchsatz in der Produktion optimiert. Dazu gehören Lampenhäuser mit extrem hohen Intensitäten oder besonders schnelle roboterunterstützte Handlingsysteme. Viele unserer Geräte sind vollständig modular aufgebaut, sodass deren Leistungsfähigkeit und Durchsatz durch Nachrüstung im Feld den Kundenbedürfnissen entsprechend erweiterbar ist.

Die Verfahren zur Herstellung von LEDs unterliegen einem ständigen Prozess der technologischen Weiterentwicklung, welchen wir in unserem Marktsegment mit unseren Lösungen und Anlagen bestmöglich unterstützen. Ein Beispiel, neben der klassischen Lithografie, ist die Abformung von Mikro- und Nanostrukturen mittels sogenannter Nano-Imprint-Verfahren, die eine Strukturgröße von weniger als 50 Nanometern erlauben. Hierbei werden die gewünschten Strukturen mittels eines Stempels auf das Substrat übertragen. Philips Research hat in Zusammenarbeit mit SÜSS MicroTec das SCIL-Substrate Conformal Imprint Lithography-Verfahren speziell für den LED-Markt entwickelt. Es adressiert insbesondere Applikationen, bei denen eine großflächige Prägung von Nanostrukturen stattfindet.

SÜSS MICROTecs PRODUKTPALETTE FÜR DIE LED-HERSTELLUNG

Im Marktsegment LED kommen nicht nur unsere Mask Aligner zum Einsatz. Um z.B. alle in der LED erzeugten Photonen optimal nutzbar zu machen, führen SÜSS MicroTec-Bonder das finale Packaging durch und steigern somit das Output der LEDs. Dies passiert, indem das Licht, das ansonsten als Wärme verloren gehen würde, gezielt in die gewünschte Richtung gelenkt wird. Darüber hinaus kommen bei der Herstellung von LEDs auch unsere Coater / Developer zum Einsatz. Zu den typischen Prozessschritten gehören hier unter anderem die lithografische Strukturierung von Kontaktflächen, Elektroden und Ätzmasken sowie die Mikrostrukturierung von Saphir-Substraten. Auch hier ist ein hoher Durchsatz bei gleichzeitig hoher Qualität im Produktionsprozess von entscheidender Bedeutung für unsere Kunden.

Investor Relations



DAS POLITISCHE RINGEN UM EINE LÖSUNG DER SCHULDENPROBLEMATIK IN EUROPA HAT DAS BÖRSENGESCHEHEN DES GESCHÄFTSJAHRES 2011 MASSGEBLICH BESTIMMT. DIE SITUATION IN GRIECHENLAND IST NACH WIE VOR ANGESpanNT UND MITTLERWEILE STEHEN DARÜBER HINAUS NICHT NUR LÄNDER WIE SPANIEN UND ITALIEN UNTER GENAUER BEOBACHTUNG DER RATINGAGENTUREN, SONDERN AUCH LÄNDER WIE BEISPIELSWEISE PORTUGAL UND FRANKREICH. ES WURDE DEUTLICH, DASS DIE SCHULDENKRISE AUCH REALWIRTSCHAFTLICHE FOLGEN IN EUROPA UND MÖGLICHERWEISE AUCH WELTWEIT HABEN KANN. DIESE BEFÜRCHTUNGEN WURDEN INSBESONDERE IN DER ZWEITEN JAHRESHÄLFTE 2011 IN VIELEN AKTIENKURSEN EINGEPREIST.

WEITERE INFORMATIONEN ZUR KURSENTWICKLUNG, DER AKTIONÄRSSTRUKTUR SOWIE DER INVESTOR RELATIONS-ARBEIT BEI SÜSS MICROTEC ERHALTEN SIE IN DIESEM KAPITEL.

ANHALTENDE SCHULDENSITUATION VERUNSICHERTE DIE KAPITALMÄRKTE

Die positive Stimmung an den Finanz- und Kapitalmärkten, die Ende 2009 und im Jahr 2010 vorgeherrscht hat, ist im abgelaufenen Geschäftsjahr einer großen Unsicherheit über die Konjunkturaussichten für die kommenden Jahre und insbesondere über die Zukunft der Eurozone gewichen. So begann der DAX das Börsenjahr 2011 bei 6.990 Punkten und schloss im Dezember 2011 bei 5.898 Punkten. Dies entspricht einem Rückgang von 16 Prozent. Auch der MDAX und der SDAX haben sich auf Jahressicht deutlich, um 13 Prozent bzw. 20 Prozent, verschlechtert. Der TecDAX hat sich im gleichen Betrachtungszeitraum von 860 Punkten im Januar 2011 auf 685 Punkte im Dezember 2011 verschlechtert, dies entspricht einem Rückgang um rund 20 Prozent.

Unsere Aktie hat das Geschäftsjahr 2010 mit einem Kurs von 9,14 Euro am 30.12.2010 beendet und ist im Januar 2011 mit einem Kurs von 9,44 Euro in das Geschäftsjahr 2011 gestartet. Die bereits im Herbst 2010 begonnene Kursrallye hat sich in den ersten beiden Monaten des Geschäftsjahres 2011 – unter anderem beflügelt durch positive vorläufige Unternehmenszahlen – mit unverminderter Geschwindigkeit fortgesetzt. Die SÜSS MicroTec-Aktie hat teilweise Kursgewinne von bis zu 48 Prozent gegenüber dem Jahresbeginn verzeichnen können. Im März ist die positive Stimmung an den nationalen und internationalen Börsen einer großen allgemeinen Verunsicherung gewichen. Die Natur- und Atomkatastrophe in Japan sowie der Beginn eines NATO-Militäreinsatzes in Libyen haben damals zur weiteren Verunsicherung der Anleger beigetragen. Leider konnten auch die positiven Zahlen zum ersten Quartal, welche Anfang Mai veröffentlicht wurden, diesen Abwärtstrend

nicht aufhalten. Die SÜSS MicroTec-Aktie musste deutliche Kursverluste hinnehmen und ihr Wert lag zeitweise wieder unter dem Jahresanfangskurs.

Zum Ende des Monats Juni war jedoch eine deutliche Aufwärtsbewegung der Märkte zu verzeichnen. Ein Grund hierfür könnte die Genehmigung der umfassenden Sparpakete in Griechenland und Italien sowie die damit einhergehende allgemeine Beruhigung der Kapitalmärkte sein. Darüber hinaus hatte der Vorstand der SÜSS MicroTec AG auf der Hauptversammlung am 21. Juni 2011 den Ausblick für das erste Halbjahr und das Gesamtjahr 2011 bestätigt. Anfang des dritten Quartals hatte sich unsere Aktie von den Tiefstständen des ersten Halbjahres sehr gut erholt und lag zeitweise wieder deutlich über der 10-Euro-Marke. Diese Verschnaufpause hielt leider nicht lange an. Von August bis Mitte September war die Kursentwicklung von starken Schwankungen begleitet, wobei in dieser Zeit die Kursbewegungen fast eins zu eins mit dem

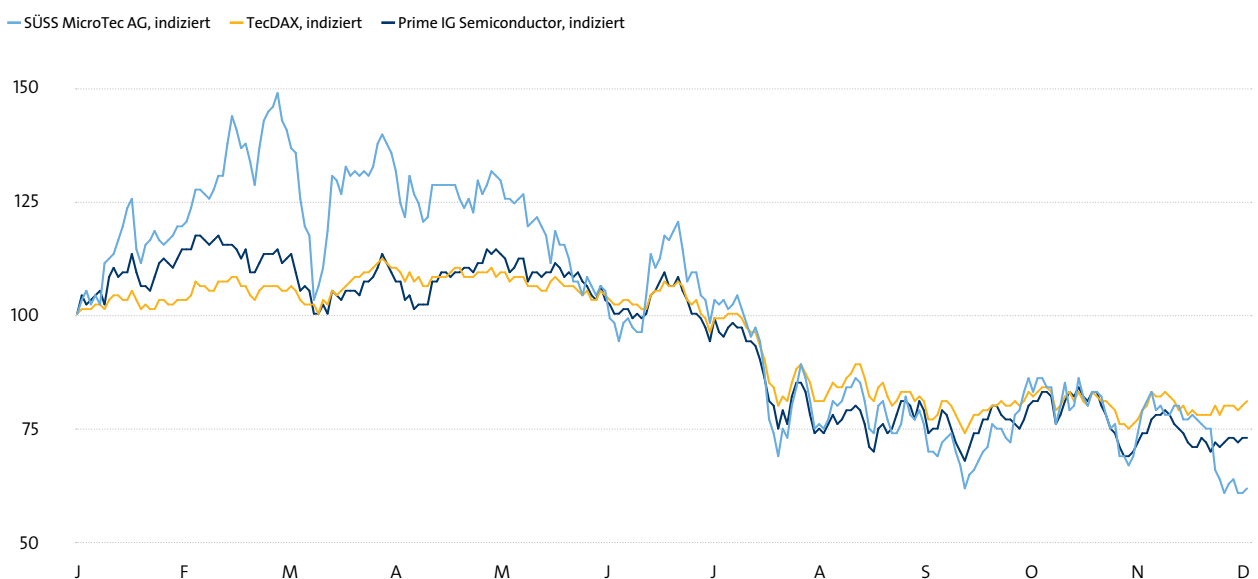
Vergleichsindex TecDAX und dem Prime IG Semiconductor verliefen. Ende September erlebten die Börsen und somit auch die SÜSS MicroTec-Aktie einen erneuten Einbruch und so stand der Kurs am 30. September bei 6,40 Euro. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Börsensommer 2011 mehr von den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen und weniger von den tatsächlichen Unternehmensleistungen geprägt war.

Nach einem sehr bewegten vierten Quartal hat unsere Aktie das Geschäftsjahr 2011 mit einem Kurs von 5,63 Euro abgeschlossen, was einem Minus von rund 40 Prozent gegenüber Jahresende 2010 entspricht. Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt an allen deutschen Börsenplätzen gehandelten SÜSS MicroTec-Aktien erhöhte sich 2011 erneut deutlich und lag für das Gesamtjahr bei 261.090 Stück (2010: durchschnittlich 117.654 Aktien pro Tag).

Einen Überblick über den Kursverlauf im Jahr 2011 bietet die folgende grafische Darstellung.

DIE KURSENTWICKLUNG DER SÜSS MICROTREC-AKTIE 2011

(Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2011: 9,44 €)

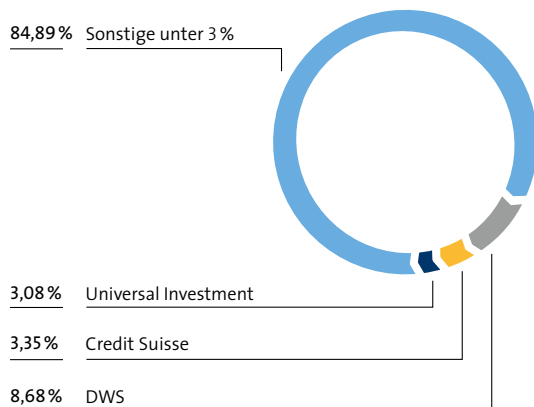


VERGLEICH DER KURSENTWICKLUNG VON SÜSS MICROTEC, TECDAX UND PRIME IG SEMICONDUCTOR IM GESCHÄFTSJAHR 2011

	30.12.2010	30.12.2011	VERÄNDERUNGEN
TecDAX	860	685	-20 %
Prime IG Semiconductor	163	115	-29 %
SÜSS MicroTec	9,44	5,63	-40 %

AKTIONÄRSSTRUKTUR ZUM 31. DEZEMBER 2011

in %



DIE SÜSS MICROTEC-AKTIE IM ÜBERBLICK

Wertpapierkennnummer	A1K023
ISIN-Nummer	DE000A1K0235
Reuters-Kürzel	SMHN
Bloomberg-Kürzel	SMHN:GR
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2011)	19.101.028
Wertpapiergattung	Namensaktien
Designated Sponsor	equinet Bank AG Close Brothers Seydler Bank AG
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs- / -schlusskurs in €	9,44 / 5,63
Jahreshoch- / tief in €*	13,57 / 5,57

*XETRA Schlusskurs

RÜCKKEHR IN DEN TECDAX

Seit dem 21. März 2011 sind die Aktien der SÜSS MicroTec AG wieder im führenden Technologiewerteindex der Deutschen Börse – dem TecDAX – vertreten. Wir versprechen uns von der Wiederaufnahme in den Index eine verstärkte Wahrnehmung am Kapitalmarkt, insbesondere bei internationalen Investoren.

UMSTELLUNG AUF NAMENSAKTIEN

Die Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG hat am 21. Juni 2011 die Umwandlung der nennwertlosen Inhaberaktien auf Namensaktien beschlossen, welche schließlich zum 12. September 2011 erfolgte. Im Rahmen dieser Umstellung hat sich die WKN / ISIN der Aktie geändert. Die neue WKN lautet A1K023, die entsprechende ISIN lautet DE000A1K0235.

Die Umstellung auf Namensaktien bietet nicht nur mehr Transparenz bei der Analyse der Aktionärsstruktur, sondern erleichtert darüber hinaus die direkte Kontaktaufnahme zu unseren Aktionären. Insbesondere im Vorfeld der Hauptversammlung versprechen wir uns eine deutliche Vereinfachung des Einladungs- und Anmeldeprozesses. Weitere Informationen zum Thema Namensaktie finden Sie auf unserer Internetseite unter www.suss.com/ir.

WEITERER AUSBAU UND INTERNATIONALISIERUNG DER INVESTOR RELATIONS-AKTIVITÄTEN

Die Investor Relations-Arbeit umfasst alle Maßnahmen, die der Pflege der Beziehungen eines börsennotierten Unternehmens zu den (potenziellen) Investoren dienen. Mit anderen Worten geht es bei der IR-Arbeit unter anderem darum, den Kapitalmarkt zeitnah mit aktuellen Informationen über das Unternehmen zu versorgen und somit eine angemessene Bewertung der Aktie an der Börse zu gewährleisten. Zu den Kapitalmarktteilnehmern und damit zu den direkten Ansprechpartnern gehören beispielsweise Privataktionäre, Fondsmanager, Finanzanalysten in Bankhäusern und natürlich auch die Finanzpresse.

Dieser Aufgabe fühlt sich auch der Vorstand der SÜSS MicroTec AG verpflichtet. So besuchten Vorstand und Investor Relations 2011 insgesamt 14 Kapitalmarktkonferenzen, darunter acht internationale Konferenzen, und absolvierten elf Roadshows. Dies ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr, dort waren wir auf fünf Kapitalmarktkonferenzen und haben insgesamt acht Roadshows durchgeführt.

Die Kapitalmarktkonferenzen fanden beispielsweise in Frankfurt, Zürich, Genf, Paris, London, San Francisco und New York statt. Zusätzlich wurde in vielen Einzelgesprächen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen fanden auch im abgelaufenen Geschäftsjahr Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt.

ANALYSTEN-RESEARCH

Mit der DZ Bank AG, der Warburg Research GmbH (vormals SES Research GmbH), der equinet Bank AG und der GBC AG Investment Research haben vier Research-Häuser ihre Berichterstattung des Vorjahres fortgesetzt. Close Brothers Seydler Research AG hat dann zusätzlich im Januar 2011 eine Coverage der SÜSS-Aktie aufgenommen. Im März 2011 kam eine weitere Coverage durch die Hauck & Aufhäuser Institutional Research AG in Hamburg hinzu. Im Dezember 2011 haben fünf von sechs Analysten eine Kaufempfehlung

für die SÜSS MicroTec-Aktie ausgesprochen. Lediglich ein Analyst empfiehlt, die Aktie zu halten. Eine Übersicht über aktuelle Researchstudien zur SÜSS MicroTec-Aktie finden Sie im Internet unter www.suss.com/ir.

AUSGEZEICHNETER GESCHÄFTSBERICHT

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde der Geschäftsbericht der SÜSS MicroTec AG bereits zum siebten Mal von der LACP (League of American Communications Professionals) ausgezeichnet. In der Wettbewerbskategorie „Technology – Semiconductors & Equipment“ erhielt der Geschäftsbericht 2010 den „Silver“-Award und lag damit an dritter Stelle aller eingereichten Finanzberichte in seiner Branche.

HAUPTVERSAMMLUNG

Am 21. Juni 2011 fand die ordentliche Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Insgesamt waren mehr als 100 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt, damit lag die Besucherzahl über der des vorangegangenen Jahres. Es waren somit rund 23 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Die Aktionäre haben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen gegeben, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der Hauptversammlung präsentierten.

Neben der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2010 und der Bestellung des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers stand eine Satzungsanpassung im Rahmen der geplanten Umstellung auf Namensaktien zur Abstimmung. Darüber hinaus wurde Beschluss gefasst über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 6.500.000,00 Euro mit Ermächtigung zu teilweisem Bezugsrechtsausschluss und entsprechender Satzungsänderung. Ein weiterer Beschluss zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der SÜSS MicroTec AG als herrschender Gesellschaft und der SÜSS MicroTec Lithography GmbH als beherrschter Gesellschaft wurde gefasst. Schlussendlich gab es eine Nachwahl zum Aufsichtsrat. Gerhard Pegam, ehemals CEO der EPCOS AG, wurde zum Nachfolger von Sebastian Reppegather gewählt.

Corporate Governance bei SÜSS MicroTec



DER BEGRIFF CORPORATE GOVERNANCE STEHT FÜR EINE VERANTWORTUNGSBEWUSSTE UND AUF LANGFRISTIGE WERTSCHÖPFUNG AUSGERICHTETE FÜHRUNG UND KONTROLLE DER UNTERNEHMEN. BEI SÜSS MICROTEC ORIENTIEREN WIR UNS AM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX, DER SICH ALS MASSSTAB GUTER UNTERNEHMENSFÜHRUNG IN DEUTSCHLAND BEWÄHRT HAT. EINZELHEITEN HIERZU FINDEN SIE IN DEM NACHFOLGENDEN BERICHT.

CORPORATE GOVERNANCE-BERICHT

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben sich auch im abgeschlossenen Geschäftsjahr intensiv mit dem Thema Corporate Governance auseinander gesetzt. Das klar definierte Ziel, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung nicht nur den Fortbestand des Unternehmens, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts zu erreichen, hat weiterhin einen enorm hohen Stellenwert im Unternehmen. SÜSS MicroTec strebt in seinem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Umfangreiche Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website unter www.suss.com.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG erklären gemäß § 161 Abs. 1 AktG:

Die SÜSS MicroTec AG hat den Empfehlungen des „Deutsche Corporate-Governance-Kodex“ in der Fassung vom 26. Mai 2010 seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärungen vom 2. November 2010 und 28. Juli 2011 mit den folgenden fünf Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung, Briefwahl, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprochen und wird ihnen mit diesen fünf Ausnahmen entsprechen.

Einladung zur Hauptversammlung

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 2.3.2 allen in- und ausländischen Finanzdienstleistern, Aktionären und Aktionärsvereinigungen, die Einberufung der Hauptversammlung mitsamt den Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege zu übermitteln, sofern die Zustimmungserfordernisse erfüllt sind. SÜSS MicroTec übermittelt die Einberufung nebst Einberufungsunterlagen auf elektronischem Wege nur den Aktionären, Aktionärsvereinigungen und Finanzdienstleistern, die dies verlangen. Eine automatische elektronische Übermittlung an alle in Ziffer 2.3.2 Genannten kann nicht erfolgen, da die SÜSS MicroTec AG Inhaberaktien ausgegeben hat und ihr die Aktionäre und deren Adressen nicht bekannt sind. Nach Abschluss der von der Hauptversammlung vom 21. Juni 2011 beschlossenen Umstellung von Inhaber- auf Namensaktien wird die Gesellschaft prüfen, ob dieser Empfehlung in Zukunft entsprochen werden kann.

Briefwahl

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 2.3.3 Satz 2, dass die Gesellschaft die Aktionäre bei der Briefwahl unterstützen soll. Die durch das ARUG eröffnete Möglichkeit der Briefwahl ist noch mit zahlreichen rechtlichen und praktischen Problemen behaftet. Vor diesem Hintergrund und in Ansehung des mit der Briefwahl verbundenen administrativen Aufwands sowie der Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auf elektronischem Weg zu bevollmächtigen, verzichtet SÜSS MicroTec einstweilen auf die Anwendung dieser Empfehlung.

Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors' and Officers' Liability Insurance (D&O-Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert.

Bildung von Ausschüssen

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat von der SÜSS MicroTec AG nur aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist die Bildung von Ausschüssen, die im Regelfall aus mindestens drei Mitgliedern bestehen müssen, nicht möglich und im Übrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern

In Ziffer 5.4.6 Absatz 2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex eine erfolgsorientierte Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 19 der Satzung festgelegt. Die Satzung der SÜSS MicroTec AG sieht aktuell keine erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats vor. Nach Ansicht der Gesellschaft wird das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats durch Vereinbarung einer erfolgsorientierten Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern nicht zusätzlich gefördert.

Der Wortlaut der aktuellen Entsprechenserklärung sowie alle vorhergehenden Erklärungen zum Kodex sind auf der Website des Unternehmens unter www.suss.com/ir veröffentlicht.

Des Weiteren erfüllt die SÜSS MicroTec AG freiwillig auch die nicht obligatorischen Anregungen des Kodex mit den folgenden Einschränkungen:

- >> Abweichend von Ziffer 2.3.3 des Deutschen Corporate Governance Kodex ist der Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung nicht erreichbar, da sich dies mit vertretbarem finanziellen Aufwand nicht mit der rechtlich erforderlichen Sicherheit gewährleisten lässt.
- >> In Ziffer 2.3.4 regt der Kodex an, den Aktionären der Gesellschaft die Verfolgung der Hauptversammlung über moderne Kommunikationsmedien (z.B. Internet) zu ermöglichen. Im Hinblick auf die zusätzlichen Kosten, die durch die Nutzung dieser Technologie entstehen können, wird derzeit von der Umsetzung dieser Anregung abgesehen.
- >> Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG nicht mitbestimmt ist, findet abweichend von Ziffer 3.6 Abs. 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex keine getrennte Vorbereitung der Aufsichtsratssitzungen statt.
- >> Außerdem werden die sich auf Ausschüsse des Aufsichtsrats und die erfolgsabhängige Vergütung des Aufsichtsrats beziehenden Anregungen des Kodex nicht befolgt, da den diesbezüglichen Empfehlungen nicht entsprochen wird.

HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der jährlich stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG können sich unsere Aktionäre mit ihren Fragen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat wenden. SÜSS MicroTec bereitet die Hauptversammlung stets mit dem Ziel vor, den Aktionären alle für sie relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptversammlung beschließt darüber hinaus unter anderem über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Gewinnverwendung.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel fünf bis sechs Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der IR-Abteilung angefordert werden. Zudem sind wir bemüht, den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausübung können vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.

KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ

Um größtmögliche Transparenz und Chancengleichheit für alle Kapitalmarktteilnehmer zu gewährleisten, folgt die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec dem Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren. Dazu nutzt das Unternehmen verschiedene Medien. Neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten sowie Telefongesprächen, Konferenzen und Roadshows nutzen wir insbesondere die Website des Unternehmens, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über Entwicklungen im Konzern zu informieren. SÜSS MicroTec unterrichtet seine Aktionäre im Wesentlichen vier Mal im Jahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Sie können unter www.suss.com/ir neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereitgestellt sind, Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder Audioformat frei einsehen bzw. abrufen. Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir unsere Aktionäre, Analysten und Medien sowie die interessierte Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Als Aktiengesellschaft (AG) unterliegt SÜSS MicroTec dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zielgerichtet und effizient zusammen, um – unter Einhaltung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre – eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens voranzutreiben. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Ihnen obliegt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren verantwortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – zum Beispiel Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt, und es wurden keine Ausschüsse gebildet, daher ist über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse nicht zu berichten.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, stets sehr eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet.

Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehört dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an, womit eine unabhängige Beratung und Überwachung des Vorstands gewährleistet ist. Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden auch im Berichtsjahr 2011 nicht. Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2011 nicht auf.

ZIELE DES AUFSICHTSRATS HINSICHTLICH SEINER ZUSAMMENSETZUNG

Durch die Kompetenzvielfalt der Mitglieder des Aufsichtsrats sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen von SÜSS MicroTec eingebracht werden.

Die SÜSS MicroTec AG ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermögen und einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab erforderlich.

Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrats, neben dem Finanzexperten erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Für die technologische Expertise sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie und deren Equipment-Industrie von besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können, sollten im Aufsichtsrat internationale Erfahrung und möglichst aktive Verbindungen vertreten sein. Mit der Wahl von Gerhard Pegam ist dem Aufsichtsrat weitere Kompetenz, insbesondere aus der internationalen Technologiebranche, hinzugefügt worden.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von erfolgreichen Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrats beitragen. Dazu gehören Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung inklusive Mergers & Acquisitions, des Kapitalmarktes und der Kapitalmarkt-kommunikation, der Rekrutierung von Führungskräften und moderner Vergütungsmodelle für alle Ebenen sowie eine erhöhte Sensibilität für ökonomisch-ökologische Grundsatzfragen.

Abhängig von der aktuellen Unternehmenssituation kann es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende Veränderungen im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dazu beobachtet der Aufsichtsrat die Unternehmenssituation, bewertet die Aufsichtsratsbesetzung einmal jährlich im Vorfeld der Hauptversammlung und gibt der Hauptversammlung eine Einschätzung zur kompetenten Besetzung des Aufsichtsrats.

Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollen zukünftig Frauen mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen, ohne dass Aufsichtsrat und Vorstand die Festschreibung einer Quote derzeit für sinnvoll halten.

Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder liegt bei 71 Jahren. Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des Aufsichtsrats vermieden, indem die Kandidaten bereits im Vorfeld einer Wahl Negativerklärungen abgeben. Sollte es während einer Wahlperiode zu potenziellen oder tatsächlichen Konflikten kommen, dann führen entsprechende Regelungen zu deren Offenlegung und zu einer angemessenen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrats.

VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat es keine Veränderung im Vorstand der SÜSS MicroTec AG gegeben.

Der Aufsichtsrat hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr in seiner Zusammensetzung verändert. Sebastian Repegather hat sein Amt als Aufsichtsrat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung vom 21. Juni 2011 niedergelegt. Bis zum Ende der regulären Amtszeit von Herrn Repegather wurde Gerhard Pegam, ehemals Vorstandsvorsitzender der EPCOS AG, in den Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG gewählt.

AKTIENGESCHÄFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 Euro erreicht oder übersteigt.

Der SÜSS MicroTec AG wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr folgende Geschäfte gemeldet:

DIRECTORS DEALINGS 2011

Datum der Transaktion	Käufer / Verkäufer	Art und Ort der Transaktion	Anzahl in Stück	Kurs / Preis in €	Gesamtvolumen in €
31.03.2011	Michael Knopp	Verkauf über XETRA	5.000	11,95	59.750,00
31.03.2011	Michael Knopp	Verkauf über XETRA	5.000	11,75	58.726,30
31.03.2011	Michael Knopp	Verkauf über XETRA	7.500	11,83	88.720,36
31.03.2011	Michael Knopp	Verkauf über XETRA	5.000	11,90	59.500,00
31.03.2011	Michael Knopp	Verkauf über XETRA	5.000	11,76	58.795,90
22.06.2011	Michael Knopp	Erwerb durch Optionsausübung, außerbörslich	56.100	1,30	72.930,00
22.06.2011	Michael Knopp	Verkauf, außerbörslich	35.000	8,90	311.500,00
22.06.2011	Frank Averdung	Erwerb durch Optionsausübung, außerbörslich	67.500	1,30	87.750,00
22.06.2011	Frank Averdung	Verkauf, außerbörslich	32.500	8,90	289.250,00
28.06.2011	Michael Knopp	Kauf, XETRA*	2.500	8,89	22.233,62
29.06.2011	Michael Knopp	Kauf, XETRA*	1.400	9,92	13.888,66
04.07.2011	Frank Averdung	Kauf, XETRA*	347	10,27	3.563,69
04.07.2011	Frank Averdung	Kauf, XETRA*	2.715	10,27	27.883,05
04.07.2011	Frank Averdung	Kauf, XETRA*	1.438	10,27	14.768,26
05.08.2011	Michael Knopp	Kauf, Börse Frankfurt	3.000	6,30	18.900,00
05.08.2011	Michael Knopp	Kauf, Börse Frankfurt	5.000	6,40	32.000,00
05.08.2011	Michael Knopp	Kauf, Börse Stuttgart	2.000	6,30	12.600,00
15.08.2011	Michael Knopp	Verkauf, XETRA	10.000	8,06	80.570,00

* Aktienwerb wegen Verpflichtung im Rahmen variabler Vorstandsvergütung

Sämtliche Geschäfte wurden auch auf der Website des Unternehmens unter www.suss.com/de/investor-relations/corporate-governance/directors_dealings veröffentlicht.

AKTIONSOPTIONSPROGRAMME

Die SÜSS MicroTec AG sieht in der Aufstellung von Aktienoptionsplänen ein wichtiges Element in der Mitarbeiterbeteiligung an dem Erfolg des Unternehmens sowie die Möglichkeit, Führungskräfte langfristig an das Unternehmen zu binden. Die Gesellschaft verfügt derzeit über zwei Aktienoptionsprogramme. Die Optionen können an Mitglieder des Vorstands, Mitglieder der Geschäftsführung von nachgeordneten verbundenen Unternehmen i.S. der §§ 15 ff. AktG sowie an Führungskräfte der SÜSS MicroTec AG und mit ihr verbundener nachgeordneter Unternehmen i.S. der §§ 15 ff. AktG ausgegeben werden.

Aktienoptionsprogramm 2005

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2011 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2005 insgesamt 294.800 Optionen aus, wobei eine Ausgabe von Optionen unter diesem Programm nur bis zum 31. Dezember 2009 möglich war. Insgesamt sind 108.000 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2005 im Geschäftsjahr 2011 verfallen. Optionen aus diesem Programm wurden im Geschäftsjahr 2011 nicht ausgeübt. Die Anzahl der noch ausstehenden Optionen betrug zum Ende des Geschäftsjahres 186.800 Stück, davon wurden insgesamt 70.000 an Mitgliedern des Vorstands ausgegeben. Die ausgegebenen Optionen können nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern eines der nachfolgend beschriebenen Erfolgsziele erreicht wird: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich 7,5 Prozent p. a. gestiegen und der Börsenkurs der Gesellschaft hat sich in diesem Zeitraum gleich oder besser entwickelt als der TecDax oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie ist im Zeitraum zwischen Ausgabe und Ausübung der Optionen um durchschnittlich zehn Prozent p. a. gestiegen. Die Ausübungs- bzw. Bezugspreise betragen 8,39 Euro für 156.800 am 23. Mai 2007 und 8,42 Euro für 30.000 am 22. August

2007 ausgegebene Optionen. Die Ausübungsfrist endet fünf Jahre nach der Ausgabe der Optionen.

Aktienoptionsprogramm 2008

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2011 standen unter dem von der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 beschlossenen Aktienoptionsprogramm 2008 insgesamt 402.000 Optionen aus. Im Berichtsjahr 2011 wurden 0 Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Insgesamt sind 7.500 Optionen des Aktienoptionsprogramms 2008 im Geschäftsjahr 2011 verfallen und 379.990 Optionen sind ausgeübt worden. Am Ende des Geschäftsjahres 2011 standen noch 14.510 Optionen aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 aus. Davon wurden insgesamt 11.400 Optionen an Mitglieder des Vorstands ausgegeben. Die ausgegebenen Optionen können nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit ausgeübt werden, sofern folgende Erfolgsziele erfüllt sind: (i) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 Prozent pro vollem Kalendermonat gestiegen und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDax entwickelt hat oder (ii) der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und dem ersten Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,833 Prozent pro vollem Kalendermonat gestiegen ist. Zusätzlich zu den Erfolgszielen (i) und (ii) muss der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie für die Ausübungszeiträume, die innerhalb der ersten 36 Monate der Laufzeit der Aktienoptionen liegen, während der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausübungszeitraumes, mindestens einmal bei 5,00 Euro, für die Ausübungszeiträume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei 5,75 Euro und für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 49. Monat und dem 60. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei 6,60 Euro gelegen haben. Die Ausübungs- bzw. Bezugspreise betragen 1,30 Euro für 14.510 am 14. April 2009 ausgegebene Optionen.

RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 21. Juni 2011 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011 die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben.

Besitz von Aktien und Bezugsrechten

Die im Geschäftsjahr 2011 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2011 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

VERGÜTUNGSBERICHT

Vergütung des Vorstands

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTec ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden, aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen, darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber 31.12.2010	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2011	Veränderung gegenüber 31.12.2010
Aufsichtsrat				
Dr. Stefan Reineck	9.600	-	40.000	-
Jan Teichert	0	-	0	-
Sebastian Reppegather	0	-	0	-
Gerhard Pegam	0	-	0	-
Vorstand				
Frank Averdung	82.000	+39.500	-	-67.500
Michael Knopp	35.000	- 2.500	41.400	-56.100

Vergütungsstruktur

Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

Feste Vergütung

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

Erfolgsbezogene Vergütung

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung und einer aktienbasierten Vergütung.

Variable Vergütung

Für das Geschäftsjahr 2011 ist die variable Vergütung auf maximal 100 Prozent der Festvergütung zu Beginn dieses Geschäftsjahrs begrenzt. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2012 kann die variable Vergütung höchstens 150 Prozent der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahrs betragen. 70 Prozent der variablen Vergütung bestimmen sich nach quantitativen und 30 Prozent nach qualitativen Kriterien.

An quantitativen Zielen orientierte variable Vergütung (variable Vergütung A)

Die quantitativen Kriterien (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70 Prozent oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130 Prozent ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 Prozent und 130 Prozent, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an quantitativen Kriterien orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrags („Vorbehaltshälfte“) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrags Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten. Für das Bezugsjahr 2010 ist der Erwerb der Aktien der Gesellschaft während des Handelsfensters nach der ordentlichen Hauptversammlung im Juni / Juli 2011 erfolgt.

An qualitativen Zielen orientierte variable Vergütung (variable Vergütung B)

30 Prozent der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige, nachhaltige und qualitative Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden. Dabei sind für die jeweiligen Geschäftsjahre Zwischenziele („Milestones“) zu definieren, die in den einzelnen Geschäftsjahren erreicht werden sollen. Erstmals erfolgt eine Festlegung der Milestones für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. Der Aufsichtsrat legt nach Abschluss eines Geschäftsjahres und nach Anhörung des Vorstandes durch Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die für die Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen 70 und 130 Prozent vorläufig fest. Abhängig vom festgelegten Zielerreichungsgrad für die jeweiligen Milestones wird der Anteil an der variablen Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr festgelegt. Dieser Anteil wird zu 50 Prozent als Vorschuss ausgezahlt und zu 50 Prozent auf das Verrechnungskonto für die variable Vergütung als vorläufiges Guthaben vorgetragen. Nach Ablauf der Gesamtlaufzeit der mehrjährigen Ziele wird der Aufsichtsrat für diese Ziele insgesamt in einer Bandbreite von 70 bis 130 Prozent den Grad der Zielerreichung für die jeweiligen Ziele abschließend feststellen. Für die endgültige Berechnung der variablen Vergütungsanteile für die in die Gesamtlaufzeit

fallenden Geschäftsjahre sind nur diese abschließend festgestellten Zielerreichungsgrade maßgeblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximalbeträge der betreffenden Geschäftsjahre. Die zuvor festgestellten Zielerreichungsgrade hinsichtlich der Milestones dienen nur der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

Aktienbasierte Vergütung

Zweites Element der erfolgsabhängigen Vergütung ist eine am langfristigen Erfolg des Unternehmens ausgerichtete aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen. Die Aktienoptionsprogramme sind auf den Seiten 34 dieses Geschäftsberichts beschrieben.

Abfindungen

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrags. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels („Change of control“-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

Im Geschäftsjahr 2011 hat die SÜSS MicroTec AG folgende Vergütungen an die Vorstandsmitglieder gezahlt:

VORSTANDSVERGÜTUNG 2011

Vorstand	Grundgehalt in €*	Variable Vergütung für 2010 in €	Aktienoptionen in Stück	Sonstige Leistungen in €**	Aufwand für Altersversorgung in €
Frank Averdung	265.601,52	189.550,51	-	6.567,00	2.148,00
Michael Knopp	227.470,24	151.640,41	-	6.567,00	2.148,00

* Im Grundgehalt enthalten sind jeweils Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie ein Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit

** Zuschuss zur freiwilligen Rentenversicherung

Ergänzend verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

Vergütung des Aufsichtsrats

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 Euro pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 Euro, sein Stellvertreter 40.000,00 Euro und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 Euro pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

Im Geschäftsjahr 2011 haben weder die ausgeschiedenen noch die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

AUFSICHTSRATSVERGÜTUNG 2011

Aufsichtsrat	Vergütung in €	Sitzungsgeld in €	Auslagenersatz in €	Abzug für anteilige D&O- Versicherungsprämie in €
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	13.500,00	7.352,44	2.174,45
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	13.500,00	295,65	1.087,23
Sebastian Reppegather	17.500,00	4.500,00	5.292,66	362,41
Gerhard Pegam	17.500,00	6.000,00	83,00	362,41

ORGANE

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats und deren Mandate:

Frank Averdung

- >> VDMA Fachverband Productronic, Frankfurt am Main (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)

Michael Knopp

Dr. Stefan Reineck

- >> AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- >> NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- >> Phoseon Technology Inc., Hillsboro, OR / USA (Mitglied im Board of Directors)
- >> Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der Havel (Mitglied im Beirat)
- >> Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)
- >> Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchardt

Jan Teichert

- >> Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG

Gerhard Pegam

(im Aufsichtsrat seit 21. Juni 2011)

- >> Vorstandsvorsitzender EPCOS AG, München (bis 31.01.2012)
- >> TDK-EPC Corporation, Tokio, Japan (bis 31.01.2012) (Mitglied des Board of Directors)
- >> OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats) sowie folgende Tochtergesellschaften der EPCOS AG: (bis 31.01.2012)
 - >> EPCOS (Shanghai) Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors)
 - >> EPCOS (China) Investment Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors)
 - >> EPCOS Limited, Hong Kong, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors)
 - >> EPCOS Inc., Iselin, New Jersey, USA (Vorsitzender des Board of Directors)
 - >> Becromal S.p.A., Mailand, Italien (Vorsitzender des Board of Directors)
 - >> Becromal Iceland ehf, Akureyri, Island (Vorsitzender des Board of Directors)

Sebastian Reppegather

(im Aufsichtsrat bis 21. Juni 2011)

- >> Fidinam S.A., Lugano, Schweiz (Investment Director)
- >> Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands (Mitglied im Board of Directors)
- >> International Equity Development S.L., Barcelona, Spanien

Konzernlagebericht und Lagebericht

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2011



41 GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

- 41 Konzernstruktur und Geschäftstätigkeit
- 43 Unternehmenssteuerung, Ziele und Strategie
- 44 Forschung und Entwicklung
- 46 Überblick über den Geschäftsverlauf

51 ERTRAGS-, FINANZ-, UND VERMÖGENSLAGE

- 51 Ertragslage
- 55 Finanz- und Vermögenslage
- 57 Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage
- 57 Investitionen
- 57 Die Holding – SÜSS MicroTec AG
- 59 Mitarbeiter im Konzern

60 ANGABEN GEMÄSS § 315 ABS. 4 HGB

61 ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENS- FÜHRUNG GEMÄSS § 289A HGB

61 NACHTRAGSBERICHT

- 61 Aktuelle Ereignisse nach dem Stichtag
- 61 Stimmrechtsmitteilungen nach dem Stichtag

62 RISIKOBERICHT

- 62 Risikomanagement-System
- 64 Allgemeine wirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken
- 65 Betriebliche Risiken
- 66 Finanzmarktrisiken

69 PROGNOSEBERICHT

- 69 Halbleiterindustrie
- 70 Halbleiter-Equipment-Industrie
- 70 Erwartete Entwicklung in den Hauptmärkten
- 72 Endogene Indikatoren
- 72 Gesamtaussage zur voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns

72 VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

GESCHÄFT UND RAHMENBEDINGUNGEN

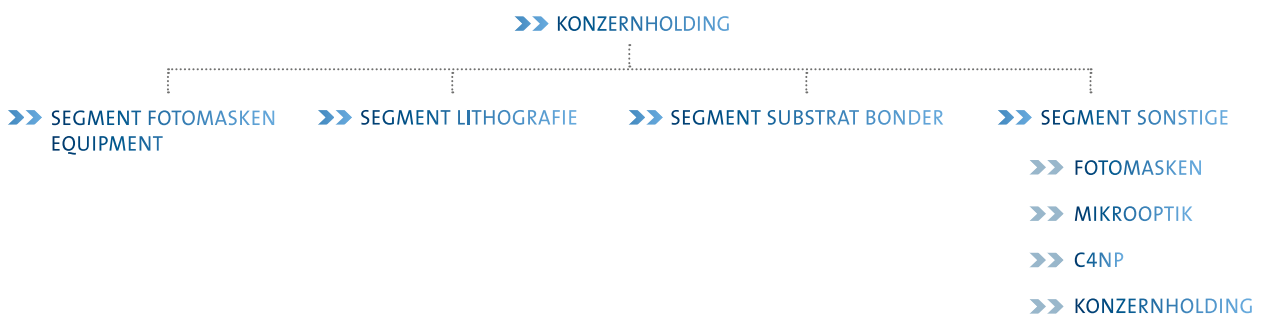
KONZERNSTRUKTUR UND GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Geschäftstätigkeit und Geschäftsfelder

Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeits-schwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt stehen die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung.

Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo für die SÜSS MicroTec-Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

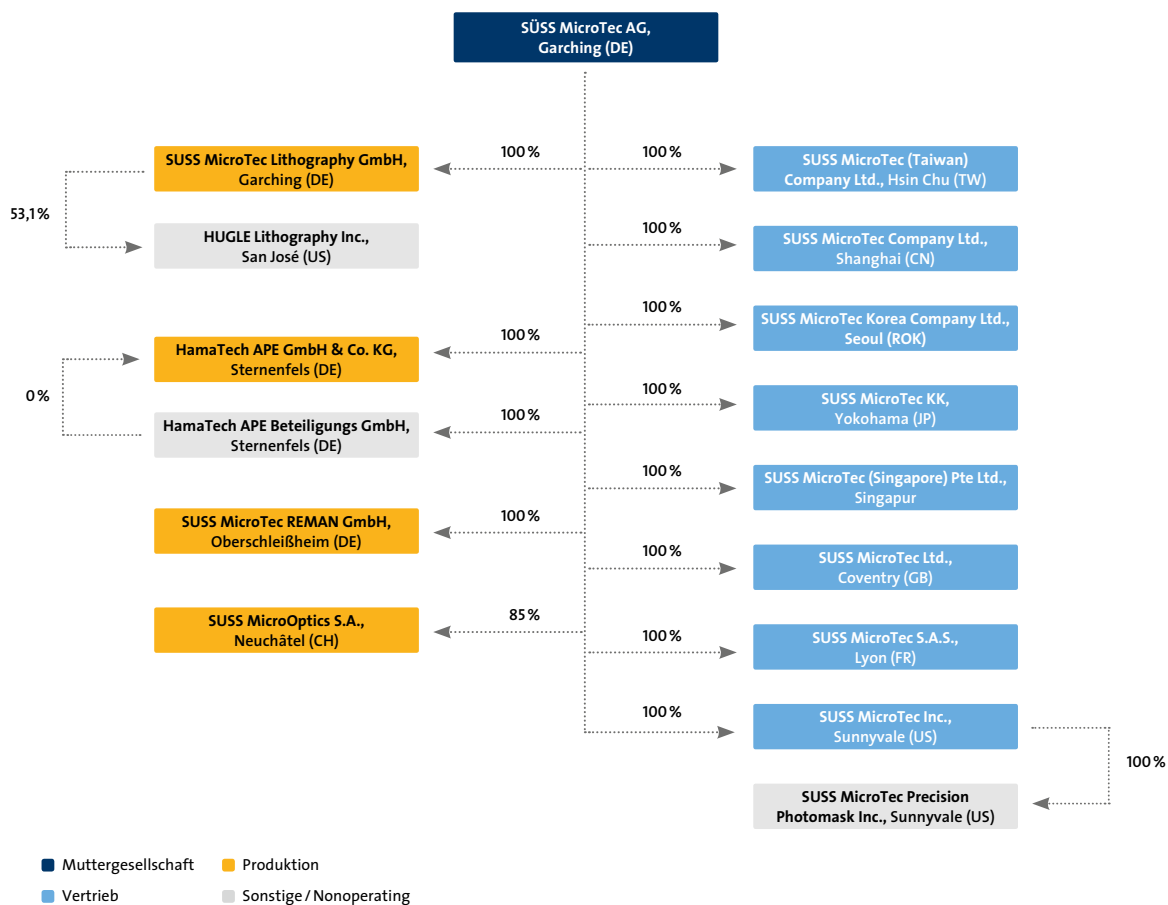
Der Konzern ist zum 31. Dezember 2011 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken Equipment – geschaffen.



Rechtliche Konzernstruktur

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den in der Regel mehrheitlich in Besitz der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebstätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan.

Daneben besteht noch eine geringfügige Beteiligung von 10% an der ELECTRON MEC S.R.L., Mailand (IT). Diese geringfügige Beteiligung hat nur unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft des Konzerns.



Leitung und Kontrolle

Vergütungsstruktur für die Organmitglieder

Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden. Neben diesen festen und variablen Vergütungskomponenten erhalten die Mitglieder des Vorstands in unregelmäßigen Abständen eine dritte, am langfristigen Unternehmenserfolg orientierte aktienbasierte Vergütung bestehend aus Aktienoptionen gemäß dem jeweils gültigen Aktienoptionsprogramm.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000 €, sein Stellvertreter 40.000 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND STRATEGIE

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns.

Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt.

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top 3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Schneller, schlanker, leistungsfähiger – maßgeschneiderte Lösungen für Kunden sind die Basis unseres langjährigen Geschäftserfolgs. Um in der von Fortschritt und Innovation geprägten Halbleiterbranche und deren anverwandten Märkten weiterhin erfolgreich sein und wachsen zu können, haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr unsere Anstrengungen im Bereich Forschung und Entwicklung ausgeweitet. Aus diesem Grund lag der Aufwand für Forschung und Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 12,9 Mio. €, nach 6,8 Mio. € im Vorjahr. Alle Produktlinien haben von unseren gesteigerten Entwicklungsaktivitäten und einer regen Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen und Universitäten profitiert.

Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr konsequent die Einführung einer spartenübergreifenden Entwicklungsorganisation umgesetzt und die Prozesse auf höchstmögliche Geschwindigkeit und Effizienz ausgerichtet. Die wichtigsten Entwicklungsprojekte der einzelnen Produktlinien werden im Folgenden kurz vorgestellt.

Lithografie

Acht Produktneueinführungen im Lithografiebereich erweitern das Produktportfolio der manuellen Maschinen.

Mit SELECT hat SÜSS MicroTec eine innovative Zukunftstechnologie vorgestellt, die das Anwendungsspektrum des Mask Aligners MA/BA8 Gen3 erweitert. Die SELECT-Plasmabehandlung ermöglicht die gezielte selektive Veränderung von mikrometerkleinen Bereichen auf Materialoberflächen. Völlig neue Möglichkeiten für die Gestaltung und Herstellung von Bauelementen werden so eröffnet, insbesondere bei MEMS-Anwendungen wie z. B. mikrofluidischen Kanälen, Biochip-Produktion oder Solartechnik.

Bei der Nanoimprintlithografie mit SCIL (Substrate Conformal Imprint Lithography) wird mit Hilfe eines patentierten Verfahrens ein vollflächiger Abdruck eines Stempels auf dem Wafer erzeugt. Die neue 200mm-SCIL-Option ermöglicht die vollflächige Herstellung von Nanostrukturen kleiner als 50nm Strukturgröße auf Wafergrößen bis zu 200mm Durchmesser.

Die neue Generation des hochpräzisen Alignment-Vermessungstools DSM200 Gen2 präsentiert ein modernes Gerätekonzept. Erweiterte Möglichkeiten zur Infrarot-Vermessung und die verbesserte Ergonomie und Bedienfreundlichkeit sprechen besonders Kunden im Bereich der 3D-Integration an.

Ein völlig neuer manueller Coater für 200mm-Wafer, die RCD8, vereint erstmals Resistbelackung und -entwicklung in einem Gerät und schafft so deutliche Kostenvorteile für unsere institutionellen Kunden. Durch die einheitliche Technologieplattform mit zukünftigen automatischen 200mm-Systemen, kann der Kunde entwickelte Prozesse zudem leicht in die spätere Serienfertigung überführen.

Der neue AltaSpray12 ist der große Bruder des erfolgreichen 200mm-Spraycoaters Delta AltaSpray. So steht erstmals eine manuelle 300mm-Version für das Spraycoaten zur Verfügung, das besonders für Substrate mit signifikanter Topografie, z.B. für zahlreiche MEMS-Technologien und im Advanced Packaging-Bereich Verwendung findet, speziell für Packaging von CMOS-Bildsensoren.

Weitere Überarbeitungen der SÜSS MicroTec-Lithografieproduktpalette, zwei 200mm-Hotplates und ein passendes Primer-Modul, unterstützen unsere Kunden zukünftig bei der Prozessoptimierung und Ausbeutensteigerung.

Nach den erfolgreichen Markteinführungen im manuellen Lithografie-Bereich konzentrieren sich die laufenden Entwicklungsaktivitäten und die wichtigsten Zukunftsprojekte nun auf die automatischen Produktionssysteme.

Substrat Bonder

Zwei wichtige Produkteinführungen im abgelaufenen Geschäftsjahr schaffen die Grundlage für das zukünftige Wachstum der Bonder Division.

Mit dem neuen Temporary Bonder XBS300 und dem neuen Produktionsdebonder XBC300 Gen2 hat SÜSS MicroTec auch eine neue universelle Geräteplattform in den Markt eingeführt. Erstmals setzen alle 300mm Bonder und Coater auf einheitliche Technologien. Gleichartige Robotik, Handling, Kontroll- und Steuerungshardware, Verkabelung sowie eine vereinheitlichte Software schaffen die Basis für die schnelle Marktreife zukünftiger Produktgenerationen bei gleichzeitig hoher Qualität und Produktionstauglichkeit. Dies ist ein wichtiger Meilenstein der neuen unternehmensübergreifenden Entwicklungsorganisation.

Technologisch setzt SÜSS MicroTec bei den temporären Bond- und Debond-Systemen für die 3D-Massenfertigung ganz auf die zukunftsweisenden Raumtemperatur-Debondprozesse. Durch frühzeitige Entwicklungszusammenarbeit mit Leitkunden und Materialanbietern bietet SÜSS MicroTec dem Kunden zugeschnittene Lösungen, insbesondere die Freiheit, zwischen verschiedenen Prozessen und Materialien zu wählen. Dazu gehören derzeit Prozesse der Firmen Thin Materials (TMAT) und Brewer Science, hier handelt es sich um den sogenannten ZoneBOND™-Prozess. Die ersten Tools wurden bestellt und erfolgreich ausgeliefert. Sie werden nun unter industriellen Bedingungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden für die Massenfertigung optimiert.

Fotomasken Equipment

Die Innovationen in der Frontend-Maskenreinigung sind sowohl von den Anforderungen der ITRS-Roadmap der Halbleiterindustrie getrieben als auch von den spezifischen Anforderungen der großen Hersteller von elektronischen Schaltkreisen und Speicherbauelementen.

Immer kleinere Strukturen und eine immer höhere Integrationsdichte verlangen stets nach neuen Lithografie-Technologien und in Folge der Anpassung der damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken wie der Fotomaskenreinigung, eine der Kernkompetenzen von SÜSS MicroTec.

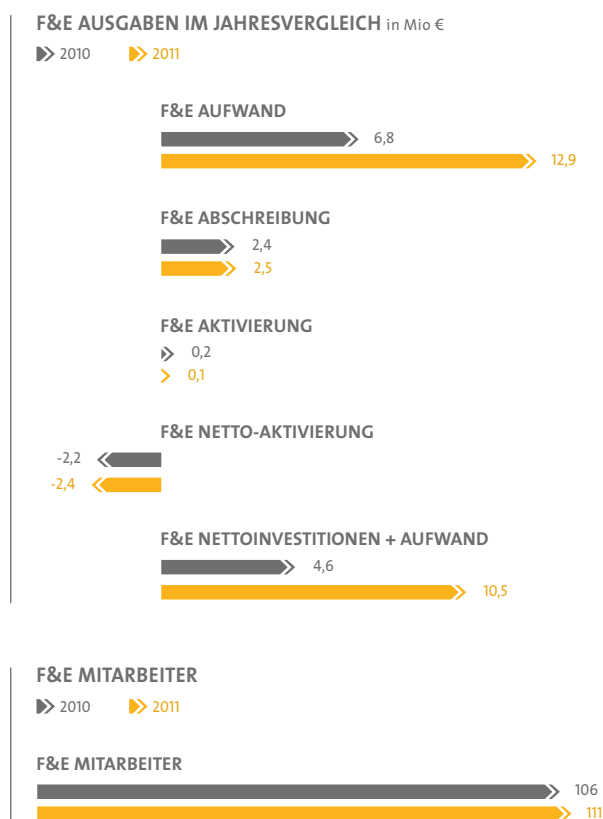
Die Erweiterbarkeit und Flexibilität dieser Prozess- und Anlagentechnologien ist daher ein wesentliches Kriterium. Unter anderem müssen sie mehrere Technologieknoten der optischen Lithografie für 193nm Immersionslithografie abdecken sowie auch auf Extreme UV Lithografie (EUVL) anwendbar sein.

Im Zusammenhang mit EUVL spielt neben der Reinigung als solches auch die Handhabung der EUV-Fotomaske eine ganz kritische Rolle, da diese nicht wie konventionelle Fotomasken durch ein sogenanntes Pellicle, eine Art Schutzfolie, vor Verunreinigung und Beschädigung geschützt ist. Stattdessen wird sie in einem sogenannten „Dualen Pod-System“ transportiert. Dieses soll eine Kontamination sowohl der Vorder- als auch der Rückseite verhindern. Dieses Duale Pod-System stellt besondere Anforderungen an die Automation, was zur Entwicklung von MaskTrack® Pro InSync und dessen Einführung 2011 führte. Diese Automationsanlage stellt die Schnittstelle zwischen dem etablierten MaskTrack® Pro-Fotomaskenreiniger und der übrigen EUVL-Infrastruktur, insbesondere der Belichtungsanlage, innerhalb der Wafer Fabs dar.

Mit der zusätzlichen Integration eines Rückseiteninspektionsgerätes in MaskTrack® Pro InSync zum Ende des Jahres 2011, wurde MaskTrack® Pro InSync um eine wesentliche Funktion erweitert. Diese adressiert das Problem der Rückseitenkontamination von EUV-Masken, indem über eine Defektmessung der Fotomaskenrückseite der vorangegangene Reinigungsprozess verifiziert wird.

Mit diesen und anderen Entwicklungen stellt SÜSS MicroTec die entsprechenden Weichen, um auch weiterhin seine Marktvorherrschaft zu behaupten und auszubauen sowie Komplettlösungen für die EUVL und 193nm Immersions-Technologie anzubieten.

Um ein umfassendes Bild über die finanziellen Auswirkungen unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu geben, haben wir in der folgenden Tabelle die relevanten Positionen aufgelistet. Auch in diesem Berichtsjahr übertrafen die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsprojekte den Aktivierungsbetrag. Dies hat zu einer Nettobelastung der Gewinn- und Verlustrechnung von 2,4 Mio. € geführt (Belastung im Vorjahr 2,2 Mio. €).



ÜBERBLICK ÜBER DEN GESCHÄFTSVERLAUF

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das im Rahmen des ifo World Economic Survey erhobene Weltwirtschaftsklima hat sich nach einem guten Start ins Geschäftsjahr 2011 in der zweiten Jahreshälfte merklich verschlechtert. So lag der Indikator im vierten Quartal 2011 deutlich unter seinem langfristigen Durchschnitt. Weltweit wurde „fehlendes Vertrauen in die Wirtschaftspolitik des eigenen Landes“ als wichtigster Grund für die aktuelle Verunsicherung genannt. Laut ifo-Institut besteht darüber hinaus nach wie vor die Gefahr, dass die Schuldenkrise in eine europaweite Banken- und Wirtschaftskrise ausartet, die auch andere Regionen der Welt stark belasten wird.

Die Weltwirtschaft ist 2011 insgesamt um etwa 2,6 % gewachsen. Am stärksten war das Wachstum erneut in China mit 9,0 % gegenüber Vorjahr. Aber auch Indien und das restliche Asien (ohne China) haben 2011 mit Wachstumsraten von 8,0 % und 4,8 % weiter zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt der USA ist mit 1,6 % gewachsen und lag damit auf dem gleichen Niveau wie die 27 EU-Länder. Auch das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ist gewachsen und lag in 2011 um etwa 3,0 % über dem Vorjahr (rwi Essen, Dezember 2011).

Branchenspezifische Rahmenbedingungen

Dem Marktforschungsinstitut Gartner zufolge verzeichnete die weltweite Halbleiterbranche 2011 einen Umsatzanstieg von knapp 1 % auf rund 302 Mrd. US-Dollar (2010: 300 Mrd. US-Dollar). Nach einem starken Jahresauftakt haben die makroökonomischen Rahmenbedingungen zu einer deutlichen Verlangsamung des Geschäfts im zweiten Halbjahr 2011 geführt. Der Markt für Halbleiter-Equipment ist laut Gartner jedoch insgesamt um 13,7 % gewachsen. Im Bereich Halbleiter-Verpackung und Montage gab es einen Rückgang um rund 6 % gegenüber dem Vorjahr.

Nach Angaben des Fachverbands Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. verzeichnete der deutsche Halbleitermarkt in 2011 einen Umsatzanstieg von rund 8% auf ein Gesamtvolumen von mehr als 11 Mrd. € (Vorjahr 10,3 Mrd. €). Als Grund hierfür wird das Wachstum in der Automobilbranche, im Sektor Industrieelektronik sowie in der Kommunikationselektronik genannt. Der übrige europäische Markt hat 2011 stagniert und hat sich somit deutlich schlechter als der deutsche Markt entwickelt. Die Region Asien / Pazifik hält weiterhin ihren Platz als umsatzstärkste Region mit einem Marktanteil von über 50 %, wovon China nach wie vor die Hälfte beisteuert.

Unternehmensentwicklung

Die SÜSS MicroTec-Gruppe hat ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2011 absolviert, sie erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 175,4 Mio. € und übertraf damit deutlich den Vorjahreswert von 139,1 Mio. € um 26 %. Der Auftragseingang ist im Jahresvergleich um 24 % auf 143,1 Millionen € gesunken (Vorjahr: 189,3 Mio. €).

Dank des Umsatzanstiegs konnte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2011 ein deutlich verbessertes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 18,6 Mio. € erwirtschaften. Im Vorjahr betrug das EBIT 14,3 Mio. €. Um dieses Ziel zu erreichen hat das Unternehmen die in den Vorjahren eingeleiteten operativen und strukturellen Maßnahmen konsequent weitergeführt. Im Rahmen der positiven Geschäftsentwicklung konnte auch die Liquiditätssituation der SÜSS MicroTec-Gruppe weiter verbessert werden. Die liquiden Mittel und verzinslichen Wertpapiere beliefen sich zum Ende des Geschäftsjahres 2011 auf 56,4 Mio. €. Die Nettoliquidität erhöhte sich zum Jahresende 2011 auf 42,0 Mio. € (31. Dezember 2010: 34,6 Mio. €). Der Free Cashflow für das Gesamtjahr belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen sowie Sondereffekten aus den getätigten M&A-Aktivitäten auf 3,5 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €).

Der Auftragsbestand betrug zum Stichtag 83,7 Mio. € und lag aufgrund des rückläufigen Auftragseingangs unter dem Vorjahresniveau von 116,1 Mio. €.

Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) belief sich 2011 auf 0,82 nach 1,36 im Vorjahr.

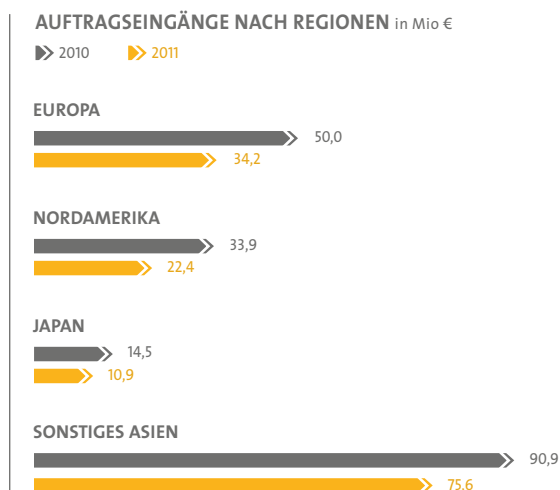
Umsätze und Auftragslage in den Regionen

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

Auftragseingänge nach Regionen

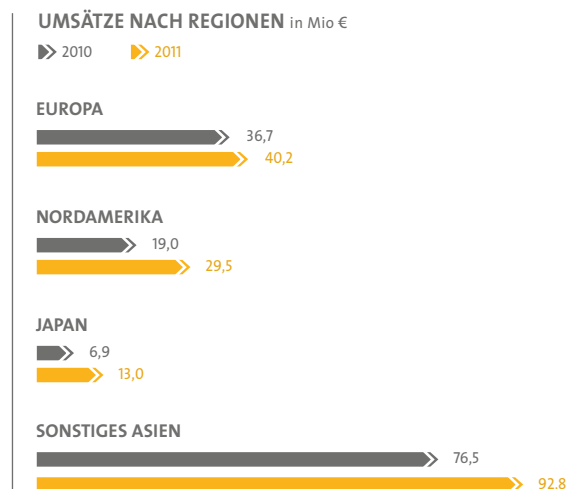
Im Vergleich zum sehr starken Geschäftsjahr 2010 haben alle Regionen rückläufige Auftragseingänge hinnehmen müssen. In Europa verringerte sich der Auftragseingang um rund 32 % auf 34,2 Mio. € nach 50,0 Mio. € im Vorjahr. Auch die Region Nordamerika verzeichnete einen Rückgang um 34 % im Auftragseingang und erreichte im Gesamtjahr 2011 Aufträge in Höhe von 22,4 Mio. € (Vorjahr: 33,9 Mio. €). Die Region Japan verzeichnete im Jahr 2011 einen Auftragseingang von 10,9 Mio. €, was ein Minus von 25 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die SÜSS MicroTec-Gruppe hat in der Region Asien (ohne Japan) den geringsten Auftragsrückgang in Höhe von 17 % auf 75,6 Mio. € (Vorjahr: 90,9 Mio. €) verzeichnet.

Die schwächere Entwicklung der Auftragseingänge ist erneut der gesamtwirtschaftlichen Lage geschuldet. Hat 2010 die positive Stimmung an den Weltmärkten zu allgemein deutlich steigenden Auftragseingängen geführt, so hat die Verunsicherung der Unternehmen und Konsumenten durch die Schuldenkrise in Europa 2011 zu einem eher zurückhaltenden Orderverhalten geführt. Unsere speziell auf Kundenbedürfnisse und wachstumsstarke Märkte ausgerichteten Produkte haben sich jedoch auch in diesen schwierigen Zeiten bewährt.



Umsätze nach Regionen

Ein sehr positives Bild zeichnet sich bei der Entwicklung des Umsatzes nach Regionen. Alle Regionen konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich zulegen. In Europa erhöhte sich der Umsatz um rund 10 % auf 40,2 Mio. € nach 36,7 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen starken Anstieg von 55 % auf 29,5 Mio. € (Vorjahr 19,0 Mio. €). Auch Japan erreichte mit 13,0 Mio. € einen deutlich höheren Wert als im Vorjahr (6,9 Mio. €). Eine deutliche Umsatzsteigerung konnte auch in der Region Sonstiges Asien erzielt werden, hier lag der Umsatz in 2011 bei 92,8 Mio. € und damit 21 % über dem Vorjahreswert von 76,5 Mio. €.



Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten

Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater. Die Entwicklung und Herstellung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels angesiedelt. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von 64 % der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe. Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D Integration und das Advanced Packaging.

Im Geschäftsjahr 2011 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 98,5 Mio. € sowie einen Umsatz von 111,5 Mio. €, dies entspricht einem Rückgang im Auftragseingang um 17 % bzw. einem Plus im Umsatz von 25 % gegenüber Vorjahr. Treiber der Nachfrage waren weiterhin asiatische Produktionskunden, aber auch Nordamerika konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatzanteil deutlich steigern. Das Segmentergebnis (EBIT) verbesserte sich von 17,0 Mio. € im Vorjahr auf 25,5 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr, dies entspricht einem Zuwachs von 51 %. Die Bruttomarge hat sich erneut gegenüber Vorjahr kaum verändert und lag 2011 bei 43,7 % (Vorjahr 43,8 %). Der Grund für die positive Entwicklung im Umsatz liegt an der gestiegenen Nachfrage nach den beiden großen Produktlinien des Segments: Sowohl Coater / Developer als auch Mask Aligner haben sich im Umsatz sehr positiv entwickelt. Allgemein hat jedoch die Verunsicherung der Endkunden und Unternehmen über den Fortgang der Schuldenkrise und die möglichen makroökonomischen Folgen zu einem vorsichtigen Bestellverhalten, insbesondere zum Jahresende, geführt.

SEGMENTÜBERSICHT LITHOGRAFIE in Mio €

▶▶ 2010 ▶▶ 2011

AUFTRAGSEINGANG



SEGMENTUMSATZ



SEGMENTERGEBNIS



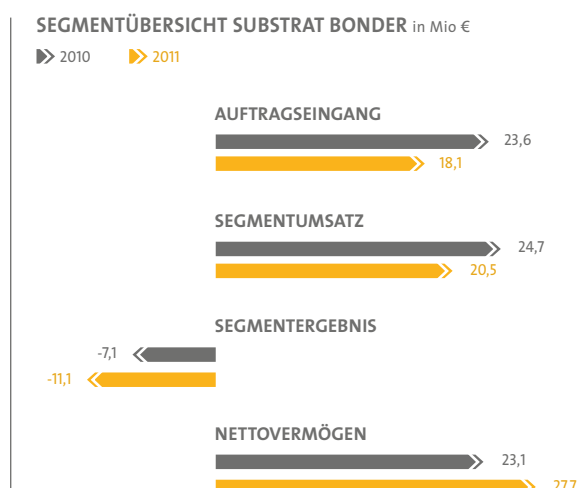
NETTOVERMÖGEN



Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Seit 2011 ist die Fertigung in Sternenfels angesiedelt, der Bonder-Vertrieb sowie das nordamerikanische Service- und Applikationscenter wurden im letzten Jahr nach Kalifornien verlegt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

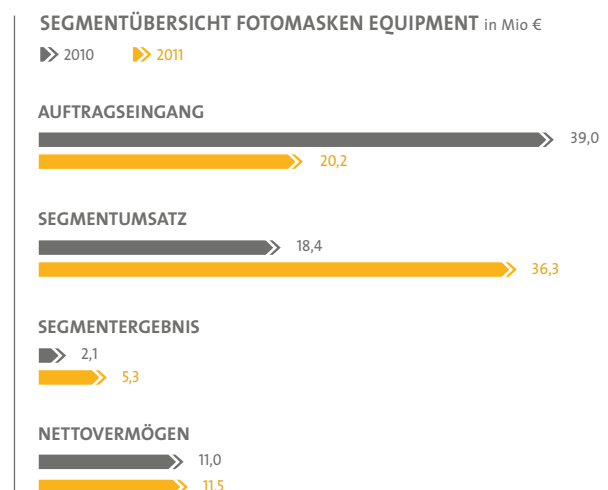
Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 18,1 Mio. € (Vorjahr 23,6 Mio. €) als auch im Umsatz mit 20,5 Mio. € (Vorjahr 24,7 Mio. €) schlechter als erwartet. Grund für diese Entwicklung war im Wesentlichen eine Verlängerung der Lieferzeiten aufgrund der Verlagerungsaktivitäten im ersten Halbjahr 2011. Dennoch wird mittelfristig die Bedeutung von Bondingsystemen im Fertigungsprozess für zukünftig dreidimensionale Chipstrukturen (3D-Integration) weiter ansteigen. Das Segmentergebnis (EBIT) fiel von vormals -7,1 Mio. € auf -11,1 Mio. €. Grund für die schwächere Ergebnisentwicklung waren finale Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Geschäftsbereichsverlagerung nach Deutschland in Höhe von 1,4 Mio. € und darüber hinaus die sehr niedrigen Margen für einige große Produktionssysteme, die 2011 an strategische Kunden sowie Forschungs- und Entwicklungspartner ausgeliefert wurden. Darüber hinaus wurden in diesem Segment die Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen deutlich erhöht, um einen Teil der durch die Verlagerung verlorenen Marktanteile wieder zurückzugewinnen. Die Bruttomarge verschlechterte sich entsprechend von 3,6 % auf -2,6 %.



Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisiert sind, und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS MicroTec im Frontend tätig.

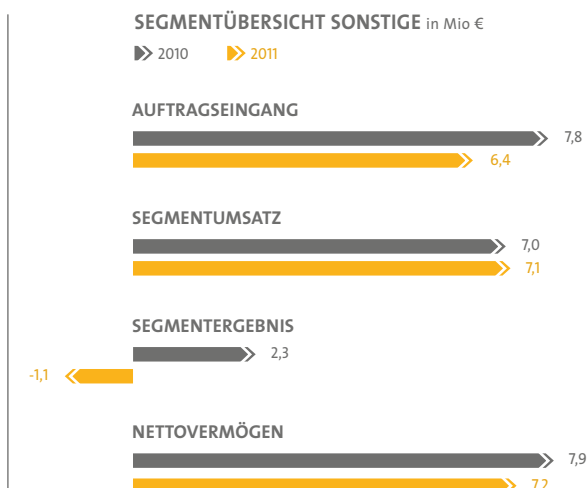
Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut positiv. Allerdings lag der Auftragseingang Ende Dezember 2011 bei 20,2 Mio. € (Vorjahr: 39,0 Mio. €). Der Rückgang im Auftragseingang lässt sich im Wesentlichen durch die allgemein schwächeren Auftragseingänge im Halbleitersegment, aber auch durch die Tatsache, dass 2010 der Auftragseingang ungewöhnlich hoch war, erklären. Der Segmentumsatz belief sich auf 36,3 Mio. € nach 18,4 Mio. € 2010. Das Segmentergebnis (EBIT) weist im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,3 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €) aus. Die Bruttomarge lag nach 36,9 % im Vorjahr bei 34,2 %.



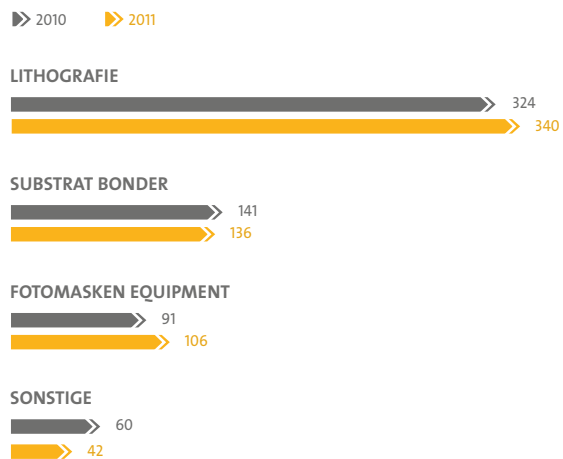
Sonstige

Das Segment Sonstige umfasste im abgelaufenen Geschäftsjahr neben dem Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie auch die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Neuchâtel, Schweiz, sowie das Geschäftsfeld C4NP und die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Das in den USA ansässige Maskengeschäft für die Halbleiterindustrie wurde im Oktober 2011 an die Compugraphics Inc. verkauft. Dieser Schritt unterstützt das Geschäft von SÜSS MicroTec mit Fotomasken-Equipment, indem mögliche Konkurrenzsituationen mit Kunden ausgeschlossen werden.

Das abgelaufene Geschäftsjahr verlief für das Segment Sonstige stabil. Der Auftragseingang verringerte sich von 7,8 Mio. € 2010 auf 6,4 Mio. € 2011. Der Segmentumsatz belief sich auf 7,1 Mio. € nach 7,0 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hierbei verzeichnete das Geschäftsfeld Mikrooptik im Auftragseingang einen Rückgang von 5,1 Mio. € auf 3,8 Mio. € sowie eine Steigerung im Umsatz von 4,3 Mio. € auf 4,6 Mio. €. Im Maskengeschäft verringerte sich der Umsatzbeitrag von 2,4 Mio. € im Vorjahr auf 1,7 Mio. €. Der Auftragseingang fiel um 37% auf 1,5 Mio. €. Das Segmentergebnis 2010 wurde durch einen einmaligen Währungseffekt in Höhe von 1,8 Mio. € sowie den im Rahmen der Erstkonsolidierung der HamaTech APE festgestellten Badwill in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. € positiv beeinflusst und belief sich im Gesamtjahr 2010 auf 2,3 Mio. €. Für das Geschäftsjahr 2011 belief sich das Segmentergebnis auf -1,1 Mio. €.



MITARBEITER NACH SEGMENTEN



ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

ERTRAGSLAGE

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns entwickelte sich im Geschäftsjahr 2011 sehr positiv. Die Umsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahr um rund 26% und beliefen sich auf 175,4 Mio. €, während im Vorjahr noch 139,1 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) aus fortgeführten Aktivitäten erhöhte sich von 14,3 Mio. € 2010 auf 18,6 Mio. € im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Das EBIT für das Geschäftsjahr 2011 ist nur in sehr geringem Umfang von Sondereffekten beeinflusst. So entstanden im Zusammenhang mit der Schließung des Standortes Waterbury (Vermont / USA) und der Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs nach Sternenfels 2011 Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. €. Bereinigt um diese Sondereffekte betrug das EBIT des aktuellen Geschäftsjahres rund 20,0 Mio. € (nach einem um Sondereffekte bereinigten EBIT von 14,0 Mio. € im Vorjahr).

Der Anstieg der Umsatzerlöse aus den fortgeführten Aktivitäten um 36,3 Mio. € auf 175,4 Mio. € resultiert aus einer gestiegenen Nachfrage nach unseren Produkten vor allem in den Segmenten Lithografie und Fotomaschinen Equipment. So kletterten die Umsätze im umsatzstärksten Bereich Lithografie um 22,6 Mio. € auf 111,5 Mio. € und im Segment Fotomaschinen Equipment um 17,9 Mio. € auf 36,3 Mio. €. Im Segment Substrat Bonder war hingegen ein Umsatzrückgang um 4,2 Mio. € auf 20,5 Mio. € zu verzeichnen, der vor allem dem Umzug und der Integration des Substrat-Bonder-Bereichs in die SUSS MicroTec Lithography GmbH (Sternenfels) geschuldet war. Im Segment Sonstige zeigte sich eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Die Umsätze im Bereich Mikrooptik stiegen weiter an und erhöhten sich von 4,3 Mio. € im Vorjahr auf nun 4,6 Mio. €. Die C4NP-Technologie trug mit 0,7 Mio. € (Vorjahr 0,2 Mio. €) zum Konzernumsatz bei. Im Konzernumsatz sind darüber hinaus Umsätze des Bereichs Fotomaschinen in Höhe von 1,7 Mio. € (Vorjahr 2,4 Mio. €) enthalten, die von der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. (Palo Alto, Kalifornien / USA) erzielt wurden. Der Geschäftsbetrieb der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. wurde im Oktober 2011 verkauft. Die Umsätze in diesem Bereich wurden somit in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2011 erzielt. Nach dem Verkauf des Geschäftsbetriebs fielen keine weiteren Umsätze mehr an.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 2,5 Mio. € enthalten. Damit sind die Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten um rund 2,4 Mio. € höher als die Neuaktivierungen, die sich im Berichtsjahr auf lediglich 0,1 Mio. € summierten. In 2010 beliefen sich die Aktivierungen von Entwicklungskosten auf 0,2 Mio. €, während die Abschreibungen rund 2,4 Mio. € betragen (fortgeführte Aktivitäten).

Im Berichtsjahr konnte aus den fortgeführten Aktivitäten ein Rohertrag von 66,4 Mio. € erzielt werden, was einer Rohertragsmarge von 37,9 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 51,1 Mio. €; die Rohertragsmarge 2010 belief sich auf 36,7 %. Der absolute Anstieg des Rohertrags resultiert aus Umsatzzuwächsen in den Bereichen Lithografie, Fotomaschinen Equipment und Mikrooptik. Das Rohergebnis im Segment Substrat Bonder war hingegen leicht negativ, da bei gesunkenen Umsätzen immer noch hohe Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten anfielen. Zudem wurde im Zusammenhang mit dem Umzug des Bonder-Bereichs von Waterbury nach Sternenfels der Lagerbestand bereinigt, woraus erhöhte Aufwendungen für Lagerabwertungen und Verschrottungen resultierten.

Infolge der konsequenten Fortführung des implementierten Sparkurses sind die Vertriebskosten erneut nur unterproportional angestiegen. Die Vertriebskosten erhöhten sich von 17,4 Mio. € im Vorjahr auf 19,0 Mio. €, was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 10,8 % (2010: 12,5 %) entspricht. Während vor allem bei der SUSS MicroTec Inc. (USA) und bei der SUSS MicroTec K.K. (Japan) aufgrund der Neuordnung der Geschäftsbetriebe Einsparungen zu verzeichnen waren, erhöhten sich bei den produzierenden Gesellschaften in Deutschland vor allem die Aufwendungen für Vertriebsprovisionen und trugen somit dem gestiegenen Umsatzniveau Rechnung. Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 17,8 Mio. € auf 15,7 Mio. € und entsprechen damit 2011 einer Aufwandsquote von 9,0 % (2010: 12,8 %). Im Vorjahr waren in den Verwaltungskosten Sonderaufwendungen für die Verlagerung des Bereichs Substrat Bonder von Waterbury (Vermont / USA) nach Sternenfels in Höhe von 1,2 Mio. € sowie die Kosten für die Verlagerung des Werks Vaihingen nach Sternenfels in Höhe von 0,3 Mio. € enthalten. Darüber hinaus konnten in nahezu allen Gesellschaften des Konzerns die Verwaltungskosten durch Einsparungsmaßnahmen weiter reduziert werden. Die Verlagerung wesentlicher Teile des Substrat-Bonder-Bereichs nach Sternenfels führte zu deutlich gesunkenen Verwaltungskosten bei der SUSS MicroTec Inc.; zusätzlich sind auch die Verwaltungskosten der SUSS MicroTec Lithography GmbH – trotz Integration des Substrat-Bonder-Bereichs – weiter zurückgegangen.

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich von 6,8 Mio. € auf 12,9 Mio. € und betrafen mit 6,2 Mio. € den Bereich Lithografie und mit 3,8 Mio. € den Bereich Substrat Bonder. 2,4 Mio. € waren dem Segment Fotomasken Equipment zuzuordnen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen im Berichtsjahr 4,8 Mio. € (nach 10,0 Mio. € im Vorjahr) und beinhalteten vor allem Erträge aus Fremdwährungsumrechnungen. In den sonstigen betrieblichen Erträgen des Vorjahres war die erfolgswirksame Vereinnahmung des Badwills in Höhe von 2,7 Mio. € enthalten, der aus der Erstkonsolidierung der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der nachträglichen Kaufpreisanpassung resultierte. Außerdem war im Vorjahr der positive Fremdwährungseffekt aus der Rückführung des US-Dollar-Darlehens der Suss MicroTec Inc., Waterbury, in Höhe von 1,8 Mio. € erfasst.

Der Bereich Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 25,5 Mio. € (2010: 17,0 Mio. €) zum Konzern-EBIT aus fortgeführten Aktivitäten (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für den Bereich Lithografie eine Umsatzrendite von 22,9 %, die sich im Vergleich zum Vorjahr (2010: 19,1 %) deutlich verbessert hat.

Im Bereich Substrat Bonder ergibt sich ein EBIT von -11,1 Mio. € nach -7,1 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis war erneut belastet durch hohe Entwicklungskosten im Bereich Thin Wafer Handling. Zudem musste SÜSS MicroTec – bedingt durch den Umzug des Bonder-Bereichs von Waterbury (Vermont / USA) nach Sternenfels – einige Anlaufschwierigkeiten in Kauf nehmen: So wurde die Produktion in Sternenfels mit ca. 50 Mitarbeitern neu aufgebaut. Auch in der Zusammenarbeit zwischen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH in Sternenfels mit den größtenteils in den USA ansässigen Zulieferern galt es, einige Startschwierigkeiten zu überwinden, was zu erhöhten Lieferzeiten und einzelnen Verlusten von Aufträgen führte. Außerdem ist das Ergebnis im Geschäftsjahr belastet durch Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs nach Deutschland anfielen. Im Vorjahr wurden einige margenschwache Aufträge für die strategisch wichtigen Kooperationspartner IMEC und ITRI abgewickelt. Die Restrukturierungsaufwendungen betrugen im Vorjahr 3,9 Mio. €.

Das 2010 neu erworbene Segment Fotomasken Equipment trug mit 2011 einem Ergebnis von 5,3 Mio. € zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 14,6 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2010: 11,4 %) verbessert. Im Vorjahr erzielte das Segment Fotomasken Equipment in den zehn Monaten seit der Erstkonsolidierung ein EBIT von 2,1 Mio. €.

Das Finanzergebnis belief sich 2011 auf 1,0 Mio. € (nach -0,3 Mio. € im Vorjahr) und resultierte im Wesentlichen aus gestiegenen Zinserträgen, während die Zinsaufwendungen sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert haben. Zudem ist im Finanzergebnis 2011 der Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf von 747.530 Cascade-Aktien erfasst, der sich auf 0,8 Mio. € belief.

Das Konzernergebnis ist mit Ertragsteuern in Höhe von 5,8 Mio. € belastet, was einer durchschnittlichen Steuerquote von rund 30 % entspricht. Im Vorjahr fiel die steuerliche Belastung des Konzernergebnisses mit 1,0 Mio. € deutlich geringer aus. Der am Vorsteuerergebnis gemessen unverhältnismäßig geringe Ertragsteueraufwand resultierte im Vorjahr im Wesentlichen aus positiven Effekten aus der Aktivierung von latenten Steueransprüchen, die sich im Zusammenhang mit der Verlagerung des Substrat-Bonder-Bereichs von den USA nach Deutschland ergaben. Die tatsächlich anfallenden laufenden Steueraufwendungen betrugen 2010 rund 4,8 Mio. €, während aus den latenten Steuern ein Steuerertrag in Höhe von rund 3,8 Mio. € resultierte.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern aus fortgeführten Aktivitäten von 13,8 Mio. €. Dem steht im Vorjahr ein Gewinn von 13,0 Mio. € gegenüber.

Aus nicht fortgeführten Aktivitäten erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von -21 T€ (Vorjahr: 0,3 Mio. €), das ausschließlich dem nicht fortgeführten Bereich Test Systeme zuzuschreiben ist. Im Vorjahr wurde hier zum einen das operative Ergebnis von -1,3 Mio. € ausgewiesen, das aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie aus nachlaufenden Kosten für die Abwicklung des Bereichs Test von Jahresbeginn bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt am 27. Januar 2010 resultierte. Zum anderen wurde hier im Vorjahr der Gewinn aus Entkonsolidierung abgebildet, der sich auf 1,6 Mio. € belief.

Insgesamt erzielte der Konzern im Berichtsjahr ein Ergebnis nach Steuern von 13,8 Mio. € (Vorjahr: 13,4 Mio. €). Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten betrug 0,72 € nach 0,73 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 24,5% von 226 T€ auf 281 T€ (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

Dem Konzern ist es gelungen, seine Net Cash-Position – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – von 34,6 Mio. € im Vorjahr auf 42,0 Mio. € weiter auszubauen. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 50,1 Mio. € im Vorjahr auf 56,4 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 6,1 Mio. € (2010: 16,1 Mio. €). Hier machte sich vor allem der weitere Anstieg des Konzernlagerbestands bemerkbar, aus dem ein Mittelabfluss in Höhe von 7,7 Mio. € resultierte. Neben einem Zuwachs der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 1,5 Mio. € erhöhte sich auch der Bestand an Demonstrationsgeräten (insbesondere im Bonder-Bereich) um 1,7 Mio. €. Zudem stieg der Bestand an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Endabnahme jedoch noch aussteht, auf 17,4 Mio. € (nach 15,8 Mio. € im Vorjahr). Auch der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sorgten für Mittelabflüsse von insgesamt 3,8 Mio. €. Zur Reduzierung des Cashflows trug außerdem der Rückgang der erhaltenen Kundenanzahlungen bei, die sich von 23,6 Mio. € um 5,2 Mio. € auf nun 18,4 Mio. € verringerten.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere -2,6 Mio. €. Investiert wurde im Wesentlichen in Sachanlagen. Im Vorjahr betrug der investive Cashflow ohne Berücksichtigung des Erwerbs der HamaTech APE GmbH & Co. KG sowie des Grundstücks und des Gebäudes Sternenfels, der Veräußerung des Test Business und der Investitionen in Wertpapiere -2,8 Mio. €.

Der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 3,5 Mio. €, nachdem im Vorjahr (bereinigt um den Erwerb der HamaTech inklusive des Grundstücks und des Gebäudes Sternenfels und Veräußerung des Test Business und vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben) ein freier Cashflow von 14,1 Mio. € erzielt wurde.

Im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt sich die planmäßige Tilgung des Immobiliendarlehens Sternenfels sowie die planmäßige Tilgung des Finanzierungsleasings für das konzernweite SAP-System. Im Vorjahr spiegelte sich im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit der Mittelzufluss aus der im Mai 2010 durchgeführten Kapitalerhöhung wider, aus der ein Nettozufluss von 6,6 Mio. € resultierte. Darüber hinaus wurde im Vorjahr ein Darlehen zur Finanzierung des neu erworbenen Betriebsgrundstücks in Sternenfels aufgenommen, das zu einem Mittelzufluss von 4,5 Mio. € führte.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 56,4 Mio. € (Vorjahr: 50,1 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 13,5 Mio. € (Vorjahr: 9,5 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 2,9 Mio. €.

Mit Vertrag vom 30./31. März 2011 haben die SÜSS MicroTec AG und die SÜSS MicroTec Lithography GmbH mit dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB Kreditverträge unterzeichnet, mit denen eine Kreditlinie von insgesamt 8 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Mit Vertrag vom 1./5. April 2011 haben die SÜSS MicroTec AG und die SÜSS MicroTec Lithography GmbH mit der DZ BANK AG einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 2 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft bis zum 31. März 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Zwischen der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der BW Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die HamaTech APE GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die aktivierten Entwicklungskosten sowie das Betriebsgrundstück in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert betrug wie im Vorjahr 13,6 Mio. € und ist ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen.

Die aktivierten Entwicklungskosten entwickelten sich im Berichtsjahr rückläufig: Nach 7,6 Mio. € im Vorjahr betragen sie zum Bilanzstichtag noch 5,4 Mio. €. Die planmäßigen Abschreibungen auf die aktivierten Entwicklungsprojekte übertrafen im abgelaufenen Geschäftsjahr die getätigten Investitionen um 2,4 Mio. €, was zu einer entsprechenden Belastung in der Gewinn- und Verlustrechnung führte. Die zum Bilanzstichtag aktivierten Entwicklungsleistungen entfielen in Höhe von 2,0 Mio. € (Vorjahr: 2,6 Mio. €) auf das Segment Lithografie und in Höhe von 3,4 Mio. € (Vorjahr: 4,9 Mio. €) auf das Segment Substrat Bonder.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie aktivierte Leasing-Gegenstände (SAP-Lizenzen) in Höhe von 2,8 Mio. € (Vorjahr: 3,8 Mio. €). Der Restbuchwert von 2,8 Mio. € entfällt in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment sowie in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorjahr: 2,2 Mio. €) auf das Segment Sonstige.

Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der HamaTech-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 0,3 Mio. € aufweist.

Das Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich im Berichtsjahr auf 2,8 Mio. € im Vergleich zu 7,4 Mio. € im Vorjahr. Als größte Investition ist der Einbau eines Reinraums in die gemieteten Geschäftsräume der SÜSS MicroTec Inc. in Sunnyvale (Kalifornien / USA) zu nennen, der Anschaffungskosten von rund 1 Mio. USD verursachte. Im Vorjahr betraf die größte Anschaffung die Immobilie und das Grundstück Sternenfels, das im Zuge der HamaTech-Akquisition erworben wurde und im Vorjahr Anschaffungskosten von 4,5 Mio. € aufwies. Im Investitionsbetrag des Vorjahres ist außerdem der Zugang des Sachanlagevermögens der HamaTech APE GmbH & Co. KG enthalten, der sich im Erstkonsolidierungszeitpunkt auf 0,4 Mio. € belief. Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 Mio. € gestiegen.

Die latenten Steueransprüche reduzierten sich im Wesentlichen aufgrund gesunkener Verlustvträge bei der SÜSS MicroTec AG und geringerer temporärer Differenzen im Bereich der immateriellen Vermögenswerte um insgesamt 3,5 Mio. € und betragen zum Bilanzstichtag 5,4 Mio. €.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 12,9 Mio. € auf nun 150,1 Mio. € angestiegen. Dieser Anstieg resultierte im Wesentlichen aus den Vorräten, den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und dem Bestand an Wertpapieren.

Die Vorräte erhöhten sich von 64,4 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 71,6 Mio. €. Die Erhöhung ist teilweise auf einen höheren Bestand von Demonstrationsgeräten zurückzuführen, der im Geschäftsjahr von 11,0 Mio. € auf 12,5 Mio. € anstieg. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen erhöhte sich im Geschäftsjahr um 1,2 Mio. € auf 24,4 Mio. €. Auch die Bestände an Maschinen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, bei denen die Abnahme jedoch noch aussteht, haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht: Sie beliefen sich auf 17,4 Mio. € (nach 15,8 Mio. € im Vorjahr).

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 15,7 Mio. € auf 17,8 Mio. €. Hier wirkten veränderte Wechselkurse bei den Fremdwährungsforderungen mit 0,6 Mio. € werterhöhend. Der übrige Anstieg ist stichtagsbedingt und den zahlreichen Abnahmen von Maschinen zum Jahresende geschuldet.

Der Bestand an Wertpapieren des SÜSS MicroTec-Konzerns erhöhte sich 2011 von 16,0 Mio. € auf 19,4 Mio. €. Im Wertpapierbestand des Vorjahres waren 747.530 Aktien an Cascade Microtech Inc., Beaverton / Oregon (USA), enthalten, die zum 31. Dezember 2010 mit 2,4 Mio. € bilanziert waren. Mit Veräußerung der Aktien im Januar 2011 hat SÜSS MicroTec einen Veräußerungsgewinn von 0,8 Mio. € realisiert. 2011 wurden – unter Verwendung des erwirtschafteten freien Cashflows – Wertpapiere für rund 9,1 Mio. € erworben. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen.

Der Rückgang der sonstigen Vermögenswerte von 3,4 Mio. € im Vorjahr auf 2,8 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf geringere Umsatzsteuerforderungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

Die langfristigen Schulden verringerten sich von 20,8 Mio. € auf 10,5 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr um 10,1 Mio. € auf 4,3 Mio. € reduziert haben. Grund für den Rückgang ist zum einen die verringerte Restlaufzeit der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, die sich nun auf weniger als ein Jahr beläuft. Damit werden die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen in Höhe von 9,0 Mio. € unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen. Zum anderen haben sich die langfristigen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing im Geschäftsjahr um 0,9 Mio. € reduziert.

Bei den kurzfristigen Schulden war umgekehrt ein Anstieg von 54,4 Mio. € im Vorjahr auf 56,9 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Anstieg hatte der geänderte Ausweis der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen, die nun mit einem Buchwert von 9,0 Mio. € in den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten enthalten sind. Im Gegenzug haben sich die kurzfristigen Rückstellungen, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten um insgesamt 6,4 Mio. € verringert. Die kurzfristigen Rückstellungen sind um 1,3 Mio. € auf 3,3 Mio. € zurückgegangen, was im Wesentlichen auf den Verbrauch der im Vorjahr passivierten Restrukturierungsrückstellung in Höhe von 1,4 Mio. € zurückzuführen ist. Der Rückgang der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten von 27,0 Mio. € auf 24,1 Mio. € resultiert vor allem aus dem deutlich gesunkenen Bestand an erhaltenen Anzahlungen, die sich zum Stichtag auf 18,4 Mio. € (2010: 23,6 Mio. €) beliefen. Im Gegenzug haben sich die in den sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten enthaltenen Personalarückstellungen um 0,8 Mio. € auf 3,6 Mio. € erhöht. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt von 9,7 Mio. € im Vorjahr auf nun 7,6 Mio. € reduziert.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2010 um 14,0 Mio. € auf 120,4 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote stieg im Jahresvergleich von 58,6 % auf 64,1 %.

Durch die Ausübung von insgesamt 379.990 Aktienoptionen durch Vorstand und Mitarbeiter erhöhte sich das Stammkapital um 1,00 € pro Aktienoption und betrug zum Bilanzstichtag 19,1 Mio. €. Pro ausgeübter Aktienoption wurden 0,30 € in die Kapitalrücklage eingestellt.

GESAMTAUSSAGE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN LAGE

Die Umsatz- und Ergebnissituation von SÜSS MicroTec hat sich im Berichtsjahr erneut sehr erfreulich dargestellt. Der SÜSS MicroTec-Konzern konnte ein EBIT von 18,6 Mio. € (fortgeführte Aktivitäten) und eine EBIT-Marge von 10,6% erzielen.

Durch die erneut verbesserte Net Cash-Position von 42,0 Mio. € (Vorjahr: 34,6 Mio. €) verfügt der Konzern über ausreichend finanziellen Spielraum, um Investitionen in neue Produktentwicklungen zu forcieren sowie andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

INVESTITIONEN

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in Sachanlagen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2% des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind. Investitionen in diesem Bereich führen unmittelbar zu einem deutlichen Anstieg der Sachanlage-Investitionen im Konzern.

Ein Teil der Investitionen ist dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen, da für Entwicklungskosten unter Vorliegen bestimmter Voraussetzungen nach IFRS eine Aktivierungspflicht besteht.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein weiterer Roll-Out des konzernweit führenden ERP-Systems SAP durchgeführt. So wurde das SAP-System erfolgreich bei der SÜSS MicroTec Inc. (Sunnyvale, Kalifornien / USA) eingeführt und im Mai 2011 produktiv eingesetzt. Die Aufwendungen für die SAP-Einführung beliefen sich insgesamt auf rund 0,1 Mio. €. Sie wurden aktiviert und werden über eine Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben.

DIE HOLDING – SÜSS MICROTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

DARSTELLUNG DER FINANZIELLEN KENNZAHLEN DER HOLDING in T€

Gesellschaft	SMT AG (HGB)			
	2011	2010	Änderungen	in %
Jahresüberschuss	9.762	6.217	3.545	57%
Eigenkapital	102.146	91.843	10.303	11%
Bilanzsumme	134.577	126.414	8.163	6%
EK Quote in %	76%	73%		
Anlagevermögen	71.982	68.422	3.560	5%
in % der Bilanzsumme	53%	54%		
Umlaufvermögen und Rechnungs- abgrenzungsposten	62.595	57.992	4.603	8%
in % der Bilanzsumme	47%	46%		

Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage

Die immateriellen Vermögensgegenstände sanken im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,5 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 2,2 Mio. €. Der Rückgang beruht ausschließlich auf planmäßigen Abschreibungen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 55,7 Mio. € und sind damit um 0,4 Mio. € geringer als im Vorjahr. Der Rückgang resultiert aus einer Abwertung der Anteile an der SÜSS MicroTec Ltd., Coventry (Großbritannien), die aufgrund der Konzernplanung für 2012 sowie erwarteter Umsatzschwankungen notwendig wurde.

Der Anstieg der Ausleihungen an verbundene Unternehmen resultiert aus einem Darlehen gegenüber der Suss MicroTec KK in Höhe von 4,8 Mio. € und planmäßigen Tilgungen in Höhe von 0,5 Mio. €.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen stiegen insgesamt um 1,0 Mio. €. Die Forderungen erhöhten sich deutlich durch die Jahresüberschüsse der Suss MicroTec Lithography GmbH und der Suss MicroTec REMAN GmbH, die aufgrund der bestehenden Ergebnisabführungsverträge insgesamt ein positives Ergebnis von 11,3 Mio. € an die SÜSS MicroTec AG abführten. Im Gegenzug wurde eine kurzfristige Forderung gegen die Suss MicroTec KK in ein langfristiges Darlehen umgewandelt. Darüber hinaus waren planmäßige Rückzahlungen von kurzfristigen Forderungen der HamaTech APE und der Suss MicroTec Inc. zu verzeichnen. Dadurch sanken die kurzfristigen Forderungen um 10,3 Mio. €.

Die SÜSS MicroTec AG konnte im Berichtsjahr ihre Liquiditätsposition weiter ausbauen. Der Ausbau resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Die Erhöhung der Liquiditätsposition wird sowohl im Anstieg der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 0,2 Mio. € als auch im Zuwachs von Wertpapieren in Höhe von 3,4 Mio. € sichtbar. Bei den Wertpapieren handelt es sich im Wesentlichen um Unternehmens- und Staatsanleihen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sanken im Berichtsjahr in Summe um 0,2 Mio. €. Der Rückgang resultierte aus der Rückführung von Verbindlichkeiten durch die Suss MicroTec Lithography GmbH. Gegenläufig entstanden im Jahr 2011 Verbindlichkeiten gegenüber der Suss MicroTec Inc., die in ein langfristiges Darlehen umgewandelt wurden. Zum Stichtag beläuft sich die Darlehensverbindlichkeit auf umgerechnet rund 7,7 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Verlauf des Jahres 2011 um 0,2 Mio. €. Der Rückgang resultiert aus planmäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels. Weiterhin unverändert besteht das im Dezember 2012 fällige Schuldscheindarlehen.

Das erhöhte Eigenkapital (+10,3 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres (9,8 Mio. €) und der im Geschäftsjahr ausgeübten Aktienoptionen (0,5 Mio. €).

Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2011 ein Jahresüberschuss von 9,8 Mio. € (Vorjahr: 6,2 Mio. €).

Aufgrund des zum 01. Januar 2011 gültigen Gewinnabführungsvertrags mit der Suss MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 10,2 Mio. € ergebniswirksam gebucht. Aufgrund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Gewinnabführungsvertrags mit der Suss MicroTec REMAN GmbH, Oberschleissheim, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 1,1 Mio. € (Vorjahr: 1 T€ Verlust) ergebniswirksam erfasst.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Fremdwährungsgewinne in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 4,0 Mio. €) und Mieterlöse in Höhe von 1,0 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 3,4 Mio. € (nach 1,5 Mio. € im Vorjahr).

Die Zinsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr um 0,1 Mio. €, was im Wesentlichen auf das 2010 neu hinzugekommene Darlehen zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2011 durchschnittlich 20 (Vorjahr: 19) Mitarbeiter tätig.

Neben der Entwicklung des US-Dollars hängt die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft.

MITARBEITER IM KONZERN

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Auch die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 waren 624 (Vorjahr: 616) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.

MITARBEITER BEREICHE

▶▶ 2010 ▶▶ 2011

VERWALTUNG

▶▶ 74
▶▶ 68

MARKETING UND VERTRIEB

▶▶ 234
▶▶ 256

PRODUKTION UND TECHNIK

▶▶ 308
▶▶ 300

SÜSS-GRUPPE

▶▶ 616
▶▶ 624

ANGABEN GEMÄSS § 315 ABS. 4 HGB

Infolge der im Jahr 2011 durchgeführten Kapitalerhöhungen aufgrund von Ausübungen von Aktienoptionen, unter Nutzung des bedingten Kapitals, hat sich das gezeichnete Kapital der SÜSS MicroTec AG zum 31.12.2011 auf 19.101.028 € erhöht. Es ist aufgeteilt in 19.101.028 auf den Namen lautende Stückaktien. Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen.

Es bestehen keine Beschränkungen bezüglich der Stimmrechte oder der Übertragung von Aktien.

Zum Bilanzstichtag gibt es keine direkten oder indirekten Beteiligungen am Kapital der SÜSS MicroTec AG, die 10 % überschreiten.

Sonderrechte von Aktionären, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Über die bestehenden Aktienoptionspläne sind Arbeitnehmer nach Ausübung ihrer Optionen am Kapital der Gesellschaft beteiligt. Die ihnen hieraus entstehenden Kontrollrechte üben sie unmittelbar aus.

Die Regelungen zur Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern der SÜSS MicroTec AG ergeben sich aus den §§ 84 f. AktG. Die Satzung enthält diesbezüglich keine weitergehenden Regelungen. Die Zahl der Mitglieder des Vorstands bestimmt gemäß § 7 der Satzung der Aufsichtsrat. Dieser kann auch ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden oder Sprecher des Vorstands und ein weiteres Mitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden ernennen.

Satzungsänderungen sind in den §§ 133, 179 AktG geregelt. Die Befugnis zu Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, wurde gemäß § 179 Abs. 1 Satz 2 AktG an den Aufsichtsrat delegiert.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 19. Juni 2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.552.863 € durch Ausgabe von bis zu 2.552.863 neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Namensaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand durch Beschluss der Hauptversammlung am 21. Juni 2011 ermächtigt worden, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.500.000 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils Namensaktien. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Die bestehenden Schuldscheinverträge beinhalten eine Change-of-Control-Klausel. Demzufolge haben die Darlehensgeber die Möglichkeit zur außerordentlichen Kündigung, wenn eine oder mehrere Personen, die nicht dem Kreis der bestehenden Hauptaktionäre zuzurechnen sind, eine Anzahl von Aktien an der SÜSS MicroTec AG halten oder erworben haben, auf die 50 % oder mehr der Stimmrechte entfallen.

Mit den zwei Banken des bestehenden Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse / ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Weitere wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

Entschädigungsvereinbarungen o. ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können mit Ausnahme des Schuldscheindarlehens im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende „Change-of-Control“-Klauseln nicht wegfallen.

ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG GEMÄSS § 289A HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 8. März 2012 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach §289a HGB abgegeben und diese auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.suss.com/de/investor-relations/corporate-governance/erklarung-zur-unternehmensfuehrung.html allgemein zugänglich gemacht.

NACHTRAGSBERICHT

AKTUELLE EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG

Im Rahmen der Veräußerung des Test Business zum 28. Januar 2010 wurden vom Kaufpreis insgesamt 2,5 Mio. € auf Treuhandkonten eingestellt. Die Auszahlung war abhängig von bestimmten Bedingungen, die nach der Transaktion von SÜSS MicroTec erfüllt werden mussten. Zum 31.12.2011 wiesen die Treuhandkonten einen verbleibenden Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € aus. Am 27. Januar 2012 (24 Monate nach Abschluss des Kaufvertrags) galten die entsprechenden Bedingungen als erfüllt. Der Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € wurde im Februar 2012 an die SÜSS MicroTec AG ausbezahlt und ertragswirksam erfasst. Der Ertrag wird 2012 als „Gewinn aus nicht fortgeführten Aktivitäten“ ausgewiesen werden.

STIMMRECHTSMITTEILUNGEN NACH DEM STICHTAG

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG am 21. Februar 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Februar 2012 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,54% beträgt (486.093 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,28% (436.843 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

RISIKOBERICHT

RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

Organisation und Dokumentation des Risikomanagements

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Das eingerichtete Risikofrüherkennungs-System wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung jährlich geprüft.

Risikoidentifikation

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen.

Auf Basis dieser Workshops werden vierteljährlich Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

Risikobewertung

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, die entsprechende Gegenmaßnahmen berücksichtigt und, wie auch die Ermittlung der maximalen Schadenshöhe, auf den Kenntnissen und Erfahrungen der Risikobeauftragten beruht und somit stets dem aktuellsten Stand entspricht. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden 12 bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikoklassen eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

Risikohandhabung

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falschaussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelungskonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Wirksamkeit des internen Kontroll- und Risikofrüherkennungssystems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft. Eine absolute Sicherheit kann jedoch auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der Süss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu (Taiwan), verwendet. Im Geschäftsjahr wurde SAP schließlich bei der Süss MicroTec Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA), implementiert. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssysteme „MIS Package“. Die Einzelabschlüsse werden schließlich in ein zentrales Konsolidierungssystem eingelesen. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurückberichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

ALLGEMEINE WIRTSCHAFTLICHE RISIKEN UND BRANCHENRISIKEN

Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Unser Geschäftsumfeld wird durch die regionalen wie auch die weltweiten konjunkturellen Bedingungen beeinflusst. Die Weltwirtschaft hat im Verlauf des Jahres 2011 spürbar an Dynamik verloren. Insbesondere die Zuspitzung der Schuldenkrise im Euroraum, der kräftige Anstieg des Ölpreises im Zusammenhang mit den politischen Veränderungen in den arabischen Ländern und die Auswirkungen des Erdbebens in Japan sorgten für erhebliche Unsicherheiten, die die wirtschaftliche Entwicklung drosselten. Das Welt-Bruttoinlandsprodukt weist 2011 nur einen Zuwachs von etwa 2,6 % auf (nach einem Anstieg von circa 3,7% 2010).

Trotz der eher verhaltenen Entwicklung der Weltwirtschaft konnte SÜSS MicroTec (wie auch andere Unternehmen der Halbleiterbranche) den Umsatz 2011 deutlich ausweiten, was jedoch teilweise auf den hohen Auftragsbestand zum Jahresbeginn zurückzuführen ist. Der höchste Umsatzanteil wurde wieder in den Regionen China, Taiwan und sonstiges Asien erzielt. Auch die Umsätze mit japanischen Kunden haben sich – entgegen den Erwartungen – deutlich erhöht. Besonders positiv haben sich 2011 die Umsätze mit Kunden in Nordamerika entwickelt: Hier konnte ein Umsatzzuwachs von etwa knapp 55 % erreicht werden. Die Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung machte sich jedoch insbesondere in der zweiten Jahreshälfte bemerkbar, in der ein deutlicher Rückgang des Auftragseingangs zu verzeichnen war.

Zyklische Marktschwankungen und Marktentwicklung

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Diesen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

Marktpositionierung

Neue technologische Entwicklungen des Wettbewerbs könnten Teile des Produktportfolios und damit Teile des Potenzials ungeplant obsolet machen, wenn neue Technologien schnellere, effizientere oder günstigere Lösungen für das gleiche Problem bieten würden. Diesem Risiko begegnen wir vor allem durch gezielte Forschung und Entwicklung und durch einen laufenden Abgleich der Entwicklungsplanung mit den wesentlichen Kunden.

Abhängigkeit von einzelnen „Know-how“-Trägern

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

BETRIEBLICHE RISIKEN

Vermögens- und Ertragslage

Angesichts der äußerst positiven Entwicklung des Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, überschaubar. Der Break-Even-Umsatz liegt auch 2011 wieder deutlich unter dem tatsächlich erwirtschafteten Umsatz. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2011 vorhandenen Auftragsbestands gehen wir davon aus, dass wir 2012 wieder einen Umsatz deutlich über dem Break-Even-Umsatz erwirtschaften werden.

Zum 31.12.2011 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 13,6 Mio. € aus, der ausschließlich dem Bereich Lithografie zuzuordnen ist. Der Bereich Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und trägt ganz wesentlich zu einem positiven Konzernergebnis bei. Für 2012 erwarten wir zwar rückläufige Umsätze in diesem Segment. Der Bereich Lithografie wird jedoch auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin sehr profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Preisdruck

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erreicht werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Rechtliche Risiken, insbesondere Haftungsrisiken

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert.

Änderungen der Konzernstruktur

2011 hat sich die Konzernstruktur nur unwesentlich verändert. Im Juli 2011 wurde die SUSS MicroTec Asia Company Ltd., Bangkok (Thailand), liquidiert und zum 28. Juli 2011 entkonsolidiert. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde bereits 2009 stillgelegt.

Im Oktober 2011 hat SÜSS MicroTec sein Maskengeschäft – die Herstellung von Fotomaschinen durch die SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. – verkauft. Dieser Schritt unterstützt das Geschäft von SÜSS MicroTec mit Fotomaschinen-Equipment, indem mögliche Konkurrenzsituationen mit Kunden ausgeschlossen werden. Der Verkauf erfolgte als Asset Deal, so dass die Gesellschaft SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. zwar weiterhin zum Konzern gehört, jedoch nun keinen Geschäftsbetrieb mehr beinhaltet.

Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs nach Deutschland

Die Verlagerung des im US-amerikanischen Waterbury (Vermont) ansässigen Geschäftsbereichs Substrat Bonder nach Deutschland wurde im April 2011 abgeschlossen. SÜSS MicroTec war darauf vorbereitet, auftretenden Schwierigkeiten zu begegnen und hat verschiedene Risiken identifiziert, die den Umzug, die Integration des Bonder-Bereichs in die Suss MicroTec Lithography GmbH und die Neuordnung des Vertriebs negativ beeinflussen könnten. Nachdem die Verlagerung abgeschlossen und die Bonder-Produktion in Sternenfels eingerichtet war, hat sich herausgestellt, dass die befürchteten Schwierigkeiten in weit geringerem Maß eingetreten sind als erwartet.

Für eine erfolgreiche Verlagerung und Fortführung des Substrat Bonder Bereichs war SÜSS MicroTec darauf angewiesen, dass das bei den nordamerikanischen Mitarbeitern vorhandene Know-how bewahrt und auf die nun in Sternenfels bzw. Kalifornien tätigen Mitarbeiter übertragen wird. Erfreulicherweise konnte SÜSS MicroTec mehrere Mitarbeiter aus Waterbury für einen Zeitraum von sechs bis 15 Monaten in Sternenfels weiter beschäftigen. Die Einarbeitung der ca. 50 neu eingestellten Mitarbeiter in Sternenfels und der Erfahrungsaustausch mit den US-Kollegen haben hervorragend funktioniert, so dass kein Know-how verloren ging. Ein Mitarbeiter des ehemaligen Standorts Waterbury wurde inzwischen unbefristet bei der Süss MicroTec Lithography GmbH in Sternenfels angestellt. Die Neuorganisation der Produktion, der Forschung und Entwicklung sowie des Produktmanagements für den Bereich Bonder konnte somit erfolgreich abgeschlossen werden.

SÜSS MicroTec hat (per Ad-Hoc-Mitteilung vom 10. Juni 2010) bereits frühzeitig über die Details und den Zeitplan der Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs und der nordamerikanischen Vertriebs- und Serviceorganisation informiert. Sowohl Kunden als auch Lieferanten des Substrat Bonder Bereichs hatten damit sehr lange Gelegenheit, sich auf die sich verändernden Verhältnisse vorzubereiten. Zu zahlreichen US-Lieferanten wurden die Geschäftsbeziehungen aufrechterhalten und funktionieren heute – nach Überwindung einiger Anlaufschwierigkeiten – reibungslos. Zusätzlich wurden neue Lieferbeziehungen mit europäischen Lieferanten eingerichtet. Leider haben der Umzug und die Neuorganisation der Lieferbeziehungen zwischenzeitlich zu verlängerten Lieferzeiten auf Kundenseite geführt. Diese so nicht erwarteten langen Lieferzeiten verursachten einen Teil des Umsatzrückgangs im Substrat Bonder Bereich.

In den kommenden Jahren erwartet SÜSS MicroTec ein deutliches Wachstum im Bereich Substrat Bonder. Nach der erfolgreichen Integration des Substrat Bonder Bereichs in die Süss MicroTec Lithography GmbH und der Neuausrichtung der Lieferantenbeziehungen sieht sich SÜSS MicroTec in diesem Bereich sehr gut aufgestellt.

FINANZMARKTRISIKEN

Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in „Risk Countries“ angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswerts, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in „Non Risk Countries“ ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 18,3 Mio. € (Vorjahr: 16,4 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 13,4 Mio. € (Vorjahr: 6,8 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2011 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar (in T€):

	2011	2010
Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung		
1 - 30 Tage	832	2.164
31 - 60 Tage	925	1.645
61 - 90 Tage	1.231	2.211
91 - 180 Tage	1.215	1.606
Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung	4.203	7.626

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 0,8 Mio. € (Vorjahr: 2,0 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt (in T€):

	2011	2010
Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigung		
91 - 180 Tage	148	196
181 - 360 Tage	300	1.239
> 360 Tage	302	557
Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung	750	1.992

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

Liquiditätsrisiken

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net Cash-Bestand von 42,0 Mio. € aus (Vorjahr: 34,6 Mio. €). Der Free Cashflow belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 3,5 Mio. € (Vorjahr: 14,1 Mio. €).

Das 2007 begebene Schuldscheindarlehen in Höhe von 9 Mio. € ist im Dezember 2012 zur Rückzahlung fällig. Aufgrund der aktuell sehr positiven Finanzlage und der positiven Planung für das Jahr 2012 wird SÜSS MicroTec in der Lage sein, den im Dezember 2012 fälligen Betrag aus eigenen Mitteln zu tilgen. Unabhängig davon wird SÜSS MicroTec bei Fälligkeit des Schuldscheindarlehens die zukünftige Finanzierung des Konzerns unter Berücksichtigung der aktuellen Situation beurteilen und eventuell neu ordnen.

Derzeit stellen zwei Banken im Rahmen eines Bankenkonsortiums eine Kreditlinie von 8,0 Mio. €, die zunächst bis zum 31. März 2012 befristet ist. Zusätzlich kann SÜSS MicroTec eine Kreditlinie der DZ Bank AG in Höhe von 2,0 Mio. € nutzen, die ebenfalls bis 31. März 2012 befristet ist. Darüber hinaus besteht eine Avallinie in Höhe von 2,5 Mio. € bei einer Versicherungsgesellschaft. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der HamaTech APE GmbH & Co. KG zur Verfügung. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Sollte es nicht gelingen, die Kreditlinien des Bankenkonsortiums und der DZ BANK über den 31. März 2012 hinaus zu verlängern, müssten wir zukünftig bei einzelnen Kunden, die auf solche Bürgschaften bestehen, auf Anzahlungen verzichten. Dies wiederum würde die vollständige Vorfinanzierung von Kundenaufträgen bedingen sowie die Wahrscheinlichkeit für Stornierungen von Aufträgen erhöhen.

Für 2012 ist geplant, Kreditverträge mit einem auf drei Banken ausgelegten Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB abzuschließen, um die für die Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften notwendigen Kreditlinien auch weiterhin zur Verfügung zu haben. Die Verhandlungen sind bereits weit fortgeschritten. Die neuen Verträge werden voraussichtlich Ende März 2012 abgeschlossen werden. Wir gehen fest davon aus, dass wir damit auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (29).

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer zehnpromtigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Erhöhung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 53 T€ (Vorjahr: Reduzierung um 501 T€) und einer entsprechenden Erhöhung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag (in T€):

	2011		
	USD	JPY	SUMME
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	1.843	6	1.849
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.671	0	1.671
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.390	-108	-1.498
Kundenanzahlungen	-2.602	0	-2.602
Netto-Exposure	-478	-102	-580
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 %iger Aufwertung des Euro	43	9	53

	2010		
	USD	JPY	SUMME
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	5.573	374	5.947
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.694	1.344	5.038
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-683	-58	-741
Kundenanzahlungen	-4.729	0	-4.729
Netto-Exposure	3.855	1.660	5.515
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10 %iger Aufwertung des Euro	-350	-151	-501

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf die im Geschäftsjahr 2007 platzierten variablen Teile des Schuldscheindarlehens laufzeitkongruente Zinsswaps gelegt wurden. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Auch das variabel verzinsten Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung in Sternenfels wurde mit einem laufzeitkongruenten Zinsswap gesichert.

Alle weiteren wesentlichen Finanzschulden von SÜSS MicroTec basieren auf Darlehensverträgen mit festen Zinssätzen und unterliegen keinem Zinsänderungsrisiko.

Das Unternehmen hält festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die zu jeder Zeit über eine Bank oder über die Börse veräußert werden können. Der Kurs ist unter anderem auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. Sollte das Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit veräußern (z. B. zur Deckung eines ungeplanten Liquiditätsbedarfs, der nicht durch freie Mittel gedeckt werden kann), könnten ungeplante Kursverluste entstehen.

Gesamtrisiko

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2011 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

PROGNOSEBERICHT

Die volkswirtschaftlichen Vorgaben für das abgelaufene Geschäftsjahr waren insgesamt sehr positiv. Nach einem starken Wachstumsjahr 2010 verzeichnete auch das Jahr 2011 zunächst einen guten Start. Die konjunkturellen Erwartungen trübten sich allerdings erstmals mit der Japan-Krise im März 2011 ein. Die schwere Naturkatastrophe hatte jedoch weitaus weniger Einfluss auf die Weltwirtschaft als man es anfangs erwartet hatte. Auch die Schuldenkrise in Europa hatte zunächst wenige Auswirkungen auf die Märkte. Als jedoch im Sommer 2011 zu dem Schuldenproblem in Griechenland auch noch politische Turbulenzen in Italien sowie heftige Diskussionen über die Ausweitungen der Schuldenobergrenze in den USA hinzukamen, traf dies nun auch die bis dahin vergleichsweise stabilen Aktien- und Anleihemärkte. Dieses Zusammenspiel zeigt, dass in der aktuellen Schuldenkrise der Politikfaktor eine große Rolle spielt, dieser jedoch als unberechenbar angesehen wird und somit starke Auswirkungen auf die konjunkturellen Erwartungen hat. So hat das bewegte Börsenjahr 2011 schlussendlich überwiegend mit Verlusten geschlossen, der Deutsche Leitindex DAX verzeichnete beispielsweise ein Minus von 16 % gegenüber dem Vorjahr.

Wie das Wirtschafts- und Börsenjahr 2012 aussehen wird, darüber gibt es bei den Experten folgende Ansichten. In seiner Jahresprojektion für 2012 rechnet das deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut rwi in Essen laut einer Meldung Dezember 2011 mit einer Zunahme des Bruttoinlandsproduktes um 0,6 % nach 3,0 % 2011, für die gesamte Weltwirtschaft rechnet man laut Herbstgutachten der deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für 2012 mit einem Wachstum von rund 2,5 % nach 2,6 % 2011. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die OECD, sie erwartet für Deutschland ein Wachstum von 0,6 % nach 3,0 % im Vorjahr. Der Internationale Währungsfonds rechnete in seinem „World Economic Survey“ von September 2011 noch mit einem globalen Wirtschaftswachstum von rund 4 % für 2012, sagt aber auch sehr deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit eines realen BIP-Wachstums von unter 2 % in der zweiten Jahreshälfte 2011 deutlich zugenommen hat. Für den Euroraum wird ein Wachstum von lediglich 1,1 % und für Deutschland ein Wachstum von 1,3 % erwartet. Die Abschwächung des globalen Wachstums dürfte sich auch negativ auf die Entwicklung an den Aktien- und Bondmärkten auswirken.

Die im dritten und vierten Quartal 2011 rückläufigen Auftragszahlen für Halbleiter-Equipment im Front- und Backend wurden durch die zuletzt negative Stimmung auf den Weltmärkten ausgelöst. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Unsicherheit bzw. der Erwartung eines negativen Halbleiterwachstums seitens der Markt- und Branchenbeobachter, geht SÜSS MicroTec für das Jahr 2012 von einer rückläufigen Auftragseingangs-, Umsatz- und Ergebnisentwicklung aus.

In diesem Prognosebericht gehen wir kurz erläuternd auf die exogenen und endogenen Faktoren ein, die wir ebenso wie führende Branchenbeobachter als maßgeblich für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens ansehen.

HALBLEITERINDUSTRIE

Die erste Jahreshälfte 2011 war von kräftigem Wachstum in der Halbleiterindustrie geprägt. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Teil des Wachstums dem hohen Auftragsbestand zum Ende des Geschäftsjahres 2010 geschuldet ist. In der zweiten Jahreshälfte 2011 haben die verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen Auswirkungen auf die Auftragsgänge in der Halbleiterindustrie gezeigt. Das Marktforschungsinstitut Gartner erwartet ein weltweites Wachstum der Halbleiterindustrie von 0,9 % 2011. Dies würde einem Gesamtmarktvolumen von rund 302 Mrd. USD entsprechen. Für Europa übersetzt sich dies laut ZVEI in ein stagnierendes Umsatzvolumen im Halbleiterbereich.

Für 2012 wurden die Schätzungen zum Jahresende nach unten korrigiert, so erwartet Gartner für das kommende Geschäftsjahr ein Wachstum von rund 2,2 %. Damit wurden die eigenen Erwartungen, die noch im dritten Quartal bei 4,6 % Wachstum lagen, deutlich nach unten angepasst. Als Grund werden auch hier die verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen, die mit einer allgemeinen Verunsicherung der Endverbraucher und auch der Unternehmen einhergehen, genannt.

HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

Laut dem Marktforschungsinstitut Gartner verzeichnete die Halbleiter-Equipment-Industrie 2011 ein Marktwachstum von knapp 14 %. Für 2012 wird dagegen ein Rückgang um 19,5 % bei Halbleiter-Equipment-Herstellern erwartet. Als Begründung nennt Gartner die generell verschlechterten makroökonomischen Rahmenbedingungen sowie die hohen Bestände bei den verschiedenen Kunden. Die Nachfrage sollte sich jedoch ab Jahresmitte wieder erholen und für 2013 erwartet man erneut ein Wachstum von mehr als 19 %.

Für den Spezialbereich Verpackung und Montage erwartet Gartner für 2012 einen allgemeinen Rückgang der Umsätze, wobei die Equipment-Hersteller für sogenannte „Advanced Packaging-Anwendungen“ einen schwächeren Rückgang sehen sollten. Das Marktforschungsinstitut SEMI Industry Research and Statistics erwartet im Spezialbereich Verpackung und Montage nach einem Rückgang von 12,5 % 2011, einen weiteren Rückgang um rund 10 % 2012 und ein Wachstum von knapp 7 % 2013.

ERWARTETE ENTWICKLUNG IN DEN HAUPTMÄRKTEN

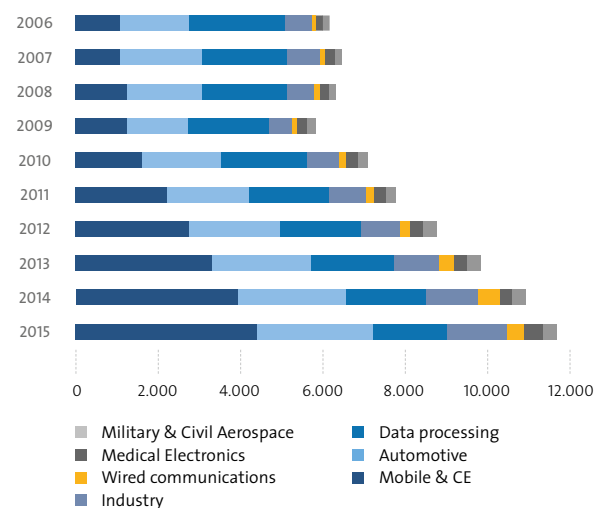
Markt für Mikrosystemtechnik

Der Markt für Mikrosystemtechnik (MEMS) hat nach einem starken Jahr 2010 ein weiteres Wachstumsjahr vollendet. Für den gesamten MEMS-Markt erwartet iSuppli 2011 ein Wachstum von rund 10 %, Yole Développement, ein französisches Marktforschungsinstitut, erwartet für den gleichen Zeitraum sogar ein Wachstum von 16 %. Bei einem Betrachtungszeitraum bis 2015 sind die Erwartungen der verschiedenen Marktforschungsinstitute sehr ähnlich, hier wird von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 10 % ausgegangen. Hauptgrund hierfür sind vor allem die Anwendungen im stark wachsenden Segment Smartphones sowie in den Segmenten Konsumelektronik und Automotive.

So ist beispielsweise der Markt für MEMS im Bereich Konsumelektronik und mobile Anwendungen nach einem Wachstum von 27 % 2010, im abgelaufenen Geschäftsjahr um 37 % gewachsen. Bis 2015 erwartet ein Analyst von Techeye in diesem Bereich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von mehr als 22 %. Neuere Anwendungen, beispielsweise in der Medizintechnik, erreichen bereits hohe Wachstumsraten, jedoch ist das Gesamtvolumen hier noch vergleichsweise gering.

Bei der Interpretation der Marktzahlen ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Equipment-Markt in diesem Bereich weniger schnell wächst als der MEMS-Markt selbst, da durch die gesteigerte Produktivität der Fertigungssysteme eine stets höhere Anzahl an MEMS-Bauteilen pro Maschine gefertigt werden kann.

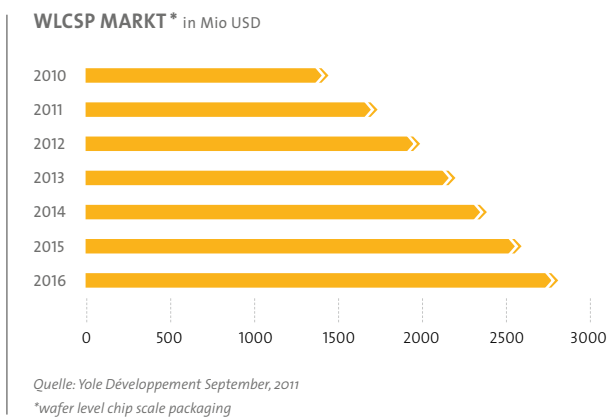
DER MEMS-MARKT in Mio USD



Quelle: iSuppli MEMS Market Tracker Q2 2011

Advanced Packaging und 3D-Integration

Für das Wafer Level Packaging (Advanced Packaging) prognostizieren die Forscher von Yole Développement für den Zeitraum von 2010 bis 2016 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von rund 12 %. Dies ist jedoch eine Verringerung gegenüber der Schätzung aus 2010, in welcher noch ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 22 % erwartet wurde.



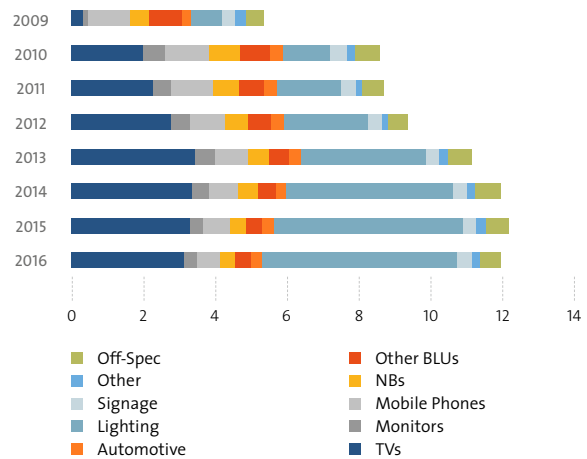
Bei der 3D Integration sehen die erwarteten Wachstumsraten deutlich größer aus. Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Yole Développement soll der Equipment-Markt für temporäres Wafer Bonden bis 2016 ein Volumen von rund 300 Mio. USD erreichen, der Equipment-Markt für permanentes Bonden soll im gleichen Zeitraum auf ein Volumen von mehr als 500 Mio. USD anwachsen. Ein großer Teil dieses Wachstums wird durch die 3D-Integration getrieben werden.

Verbindungshalbleiter (LED)

SÜSS MicroTec konzentriert sich im Markt für Verbindungshalbleiter auf das Wachstumssegment LEDs (Leuchtdioden) und adressiert mit seinen Produktlösungen insbesondere Hersteller von höherwertigen Leuchtdioden, sogenannten High Brightness (HB)- und Ultra High Brightness (UHB)-LEDs. SÜSS MicroTec beteiligt sich aktiv an den neuesten Technologiegenerationen, die insbesondere Dünnwaferhandling erfordern.

Gemäß den Schätzungen von IMS-Research ist der Markt für „packaged“ LEDs 2011 um rund 6 % geschrumpft. Für 2012 wird ein erneutes Wachstum in Höhe von 5 % erwartet, wobei jedoch die Marktgröße von 2010 noch nicht wieder erreicht werden dürfte. Auch für die kommenden Jahre bis 2015 wird ein positives Wachstum prognostiziert. Insbesondere für die Jahre 2013 und 2014 wird ein Zuwachs von jeweils mehr als 10 % vorhergesagt. Grund hierfür ist die verstärkte Marktdurchdringung des Beleuchtungssegments mit LEDs, die durch die fallenden Verkaufspreise erwartet wird. Die Analysten von IMS-Research erwarten eine Steigerung des Anteils der allgemeinen Beleuchtung am gesamten LED-Markt von 21 % 2011 auf mehr als 49 % 2016. Damit dürfte die allgemeine Beleuchtung den Anteil des heute größten Segments – dem TV Geschäft – bereits ab 2014 deutlich überschreiten.

PACKAGED LEDs NACH ANWENDUNG in Mrd. USD



Quelle: IMS Research, August 2011

ENDOGENE INDIKATOREN

Neben dem Zustand der Märkte ist für unseren Erfolg auch das Innovationspotenzial unseres Produktangebots entscheidend. Das Unternehmen ist auch im Geschäftsjahr 2011 weitere Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung eingegangen. Im Januar 2011 hat SÜSS MicroTec die strategische Zusammenarbeit mit der NanoScale Science & Technology Fakultät (CNF) der nordamerikanischen Cornell-Universität bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Cornell-Mitarbeiter an bereits existierenden und neuen Lithografie-Systemen von SÜSS MicroTec, darunter innovative Aufrüstsätze für Mask Aligner sowie ein Sprühbelacker der Gamma-Serie, Forschungsarbeiten durchführen. Darüber hinaus ist SÜSS MicroTec mit dem Centre for NanoHealth (CNH) der britischen Universität Swansea eine Zusammenarbeit eingegangen, um zukunftsfähige Technologien zu entwickeln und zu verbessern. Im Dezember 2011 wurde die Zusammenarbeit mit der Brewer Science Inc. auf dem Gebiet der Handhabung von gedünnten Wafern und dem temporären Bonden von Wafern bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit ist besonders vor dem Hintergrund des erwarteten Wachstums im Bereich 3D-Integration von großer Bedeutung.

GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNS

Im Geschäftsbericht 2010 haben wir an dieser Stelle berichtet, dass die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten zum damaligen Zeitpunkt keine negativen Auswirkungen auf die Nachfrageentwicklung hatten. Diese Situation hat sich im Vergleich zum Vorjahr spürbar verändert. Die Verunsicherung bei den Verbrauchern hat in der zweiten Jahreshälfte 2011 zu einer deutlichen Eintrübung der Konjunkturaussichten geführt. Darüber hinaus haben die politischen Akteure bis heute keine praktikable Lösung der sich immer weiter zuspitzenden Schuldenproblematik in Europa präsentiert. Vor diesem Hintergrund sehen unsere Prognosen für 2012 dennoch verhalten optimistisch aus, denn abgesehen von den makroökonomischen Gegebenheiten sehen wir, dass die Trends, die das Geschäft von SÜSS MicroTec treiben, weiterhin intakt sind.

Insgesamt rechnen wir für das Geschäftsjahr 2012 mit einem Umsatz von mehr als 145 Mio. € und einer EBIT-Marge zwischen 5 % und 10 %. Der freie Cashflow kann aus heutiger Sicht einen mittleren einstelligen Millionenbetrag erreichen.

Entwickeln sich die von uns adressierten Märkte in der oben beschriebenen Form und stabilisieren sich die makroökonomischen und politischen Rahmenbedingungen, gehen wir für 2013 von erneut steigenden Auftragseingängen und Umsätzen aus. Wir bestätigen erneut das Ziel, eine EBIT-Marge zwischen 10 % und 15 % zu erwirtschaften. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Dieser Geschäftsbericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 12. März 2012

Der Vorstand



Frank Averdung
Vorstandsvorsitzender



Michael Knopp
Finanzvorstand

Konzernabschluss

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2011



74 KONZERNABSCHLUSS NACH IFRS

- 74 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)
- 75 Gesamtergebnisrechnung (IFRS)
- 76 Konzernbilanz (IFRS)
- 78 Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)
- 80 Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)
- 82 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2011
- 84 Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2010
- 86 Segmentberichterstattung

88 KONZERNANHANG

- 105 Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
- 113 Erläuterungen zu den AKTIVA
- 117 Erläuterungen zu den PASSIVA
- 119 Aktienoptionspläne der SÜSS MicroTec AG
- 130 Sonstige Angaben

144 VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

145 BESTÄTIGUNGSVERMERK

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in T€	Anhang	01.01.2011 – 31.12.2011	01.01.2010 – 31.12.2010
Umsatzerlöse	(3)	175.427	139.085
Umsatzkosten	(4)	-109.069	-88.000
Bruttoergebnis vom Umsatz		66.358	51.085
Vertriebskosten		-19.001	-17.408
Forschungs- und Entwicklungskosten		-12.936	-6.824
Verwaltungskosten		-15.719	-17.826
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	4.767	9.996
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-4.894	-4.709
Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT)			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		24.926	20.515
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-6.351	-6.201
Operatives Ergebnis (EBIT)		18.575	14.314
Finanzerträge		2.017	654
Finanzaufwendungen		-996	-940
Finanzergebnis	(7)	1.021	-286
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten vor Steuern		19.596	14.028
Ertragsteuern	(8)	-5.789	-993
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten		13.807	13.035
Gewinn / Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten (nach Steuern)		-21	332
Gewinn		13.786	13.367
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		13.513	13.230
Davon Minderheitsanteile		273	137
Ergebnis je Aktie (unverwässert)			
	(9)		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		0,72	0,71
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,00	0,02
Ergebnis je Aktie (verwässert)			
	(9)		
Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Aktivitäten in €		0,71	0,70
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführten Aktivitäten in €		0,00	0,02

Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in T€	31.12.2011	31.12.2010
Periodenergebnis	13.786	13.367
Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	-30	-19
Fremdwährungsanpassung	-146	320
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-230	101
Effekt aus der Entkonsolidierung Süss MicroTec Test Systems	0	-253
Latente Steuern	70	-5
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen	-336	144
Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen	13.450	13.511
Davon SÜSS MicroTec-Aktionäre	13.160	13.314
Davon Minderheitsanteile	290	197

Konzernbilanz (IFRS)

AKTIVA in T€	Anhang	31.12.2011	31.12.2010
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		37.691	44.312
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	8.568	11.891
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	13.599	13.599
Sachanlagen	(13)	9.462	9.356
Steuererstattungsansprüche	(19)	87	108
Sonstige Vermögenswerte	(14)	592	485
Latente Steueransprüche	(8)	5.383	8.873
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE		150.055	137.248
Vorräte	(15)	71.632	64.431
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16)	17.790	15.659
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(17)	756	640
Wertpapiere	(18)	19.362	15.977
Steuererstattungsansprüche	(19)	686	620
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		37.036	36.525
Sonstige Vermögenswerte	(20)	2.793	3.396
BILANZSUMME		187.746	181.560

PASSIVA in T€	Anhang	31.12.2011	31.12.2010
EIGENKAPITAL		120.393	106.404
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		119.704	106.006
Gezeichnetes Kapital	(21)	19.101	18.721
Rücklagen	(21)	101.616	87.944
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(21)	-1.013	-659
Minderheitsanteile		689	398
LANGFRISTIGE SCHULDEN		10.500	20.775
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(22)	2.872	2.919
Rückstellungen	(23)	348	508
Finanzschulden	(24)	4.279	14.367
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		244	240
Latente Steuerschulden	(8)	2.757	2.741
KURZFRISTIGE SCHULDEN		56.853	54.381
Rückstellungen	(25)	3.322	4.613
Steuerschulden	(28)	5.734	5.412
Finanzschulden	(24)	10.131	1.119
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(26)	5.995	6.458
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		7.582	9.746
Sonstige Verbindlichkeiten	(27)	24.089	27.033
BILANZSUMME		187.746	181.560

Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)

in T€	01.01.2011 – 31.12.2011	01.01.2010 – 31.12.2010
Gewinn (nach Steuern)	13.786	13.367
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	4.211	4.225
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.140	1.990
Aktivierete Eigenleistungen	-291	0
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	-127	237
Ergebnis aus dem Abgang der Cascade-Aktien	-833	0
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	189	-484
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen	-194	301
Zahlungsunwirksamer Personalaufwand aus Aktienoptionsplänen	45	187
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	-29
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-566	-2.854
Badwill aus dem Erwerb HamaTech	0	-2.678
Entkonsolidierungserfolg aus dem Verkauf SMTTS	0	-1.641
Veränderung des Vorratsvermögens	-7.682	-16.544
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.325	2.039
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	335	-2.230
Veränderung der Pensionsrückstellungen	-47	31
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.441	3.446
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-4.565	20.150
Veränderung der latenten Steuern	3.506	-3.419
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit	6.141	16.094

in T€	01.01.2011 – 31.12.2011	01.01.2010 – 31.12.2010
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-2.462	-2.597
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-895	-391
Auszahlungen für den Erwerb von kurzfristigen zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	-9.067	-6.059
Einzahlungen aus Einlösung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	3.099	3.000
Einzahlungen aus dem Verkauf der Cascade-Aktien	3.333	0
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	732	201
Auszahlungen für den Erwerb HamaTech	0	-8.031
Einzahlungen aus dem Verkauf des Test Business	0	3.315
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.260	-10.562
Aufnahme von Bankdarlehen	0	4.500
Tilgung von Bankdarlehen	-180	0
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	28	-808
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-924	-915
Einzahlungen aus der Ausübung von Bezugsrechten	494	0
Einzahlungen aus der Kapitalerhöhung	0	6.808
Auszahlungen für Aufwendungen der Kapitalerhöhung	0	-227
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-582	9.358
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	212	836
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	511	15.726
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang*	36.525	20.799
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode	37.036	36.525
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält:		
Zinszahlungen während der Periode	420	742
Zinseinnahmen während der Periode	1.031	588
Steuerzahlungen während der Periode	2.170	391
Steuererstattungen während der Periode	16	151

* Der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2010 beinhaltet auch die flüssigen Mittel der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte und der nicht fortgeführten Aktivitäten (178€)

Konzerneigenkapital- Veränderungsrechnung (IFRS)

in T€	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	
Stand 01.01.2010	17.019	93.094	
Kapitalerhöhung	1.702	4.944	
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		187	
Periodenergebnis			
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen			
Stand 31.12.2010	18.721	98.225	
Stand 01.01.2011	18.721	98.225	
Ausübung von Aktienoptionen	380	114	
Zuführung aufgrund Ausgabe von Bezugsrechten		45	
Periodenergebnis			
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen			
Stand 31.12.2011	19.101	98.384	

	Gewinnrücklage	Bilanzgewinn / -verlust	Kumuliertes übriges Eigenkapital	Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG	Minderheitsanteile	Eigenkapital
	433	-23.944	-743	85.859	201	86.060
				6.646		6.646
				187		187
		13.230		13.230	137	13.367
			84	84	60	144
	433	-10.714	-659	106.006	398	106.404
	433	-10.714	-659	106.006	398	106.404
				494		494
				45		45
		13.513		13.513	273	13.786
			-354	-354	18	-336
	433	2.799	-1.013	119.704	689	120.393

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Anlagespiegel 2011

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.11	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang
I. Immaterielle Vermögenswerte					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.264	40	783	-353	166
2. Entwicklungskosten	28.452	0	112	727	22
3. Aktivierte Leasinggegenstände					
Software	3.178	19	0	0	0
4. Andere immaterielle Vermögensgegenstände	960		0	0	0
	47.854	59	895	374	188
II. Geschäfts- oder Firmenwert	32.436	0	0	0	0
III. Sachanlagen					
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.195	102	507	778	1.040
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.082	380	510	-480	8.414
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.447	104	920	140	1.931
4. Fahrzeuge	477	6	19	0	129
5. Anlagen im Bau	67	2	759	-812	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände					
Technische Anlagen und Maschinen	845	42	0	0	116
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	766	3	0	0	50
Fuhrpark	0	0	38	0	0
	31.879	639	2.753	-374	11.680
IV. Finanzanlagen					
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	0
	2.263	0	0	0	0

	Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwerte		
	31.12.11	01.01.11	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang	31.12.11	31.12.10	31.12.11
	15.568	13.359	30	550	-76	157	13.706	1.905	1.862
	29.269	20.869	0	2.518	436	0	23.823	7.583	5.446
	3.197	1.330	19	887	0	0	2.236	1.848	961
	960	405	0	256	0	0	661	555	299
	48.994	35.963	49	4.211	360	157	40.426	11.891	8.568
	32.436	18.837	0	0	0	0	18.837	13.599	13.599
	7.542	2.144	84	376	0	1.012	1.592	5.051	5.950
	4.078	10.342	338	842	-480	8.038	3.004	1.740	1.074
	9.680	8.123	89	844	120	1.797	7.379	2.324	2.301
	373	427	4	27	0	105	353	50	20
	16	0	0	0	0	0	0	67	16
	771	729	40	47	0	104	712	116	59
	719	758	3	3	0	50	714	8	5
	38	0	0	1	0	0	1	0	37
	23.217	22.523	558	2.140	-360	11.106	13.755	9.356	9.462
	2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0
	2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0

Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

Anlagespiegel 2010

in T€	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					
	01.01.10	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Zugang aus dem Erwerb HamaTech	Umbuchungen / Umgliederungen	Abgang
I. Immaterielle Vermögenswerte						
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.560	83	235	386	0	0
2. Entwicklungskosten	31.370	914	157	0	0	3.989
3. Aktivierte Leasinggegenstände						
Software	3.138	40	0	0	0	0
4. Andere immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	960	0	0
	49.068	1.037	392	1.346	0	3.989
II. Geschäfts- oder Firmenwert	32.436	0	0	0	0	0
III. Sachanlagen						
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	3.749	290	301	4.469	68	1.682
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.277	1.002	944	1	135	277
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.743	333	1.269	377	-203	1.072
4. Fahrzeuge	464	12	8	0	0	7
5. Anlagen im Bau	0	0	67	0	0	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände						
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	423	35	0	0	-458	0
Technische Anlagen und Maschinen	338	52	0	0	455	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	7	0	0	0	0
	25.753	1.731	2.589	4.847	-3	3.038
IV. Finanzanlagen						
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	0	0
	2.263	0	0	0	0	0

		Kumulierte Abschreibungen					Restbuchwerte		
31.12.10	01.01.10	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.10	31.12.09	31.12.10	
15.264	12.768	48	543	0	0	13.359	1.792	1.905	
28.452	22.060	425	2.383	0	3.999	20.869	9.310	7.583	
3.178	403	40	887	0	0	1.330	2.735	1.848	
960	0	0	405	0	0	405	0	555	
47.854	35.231	513	4.218	0	3.999	35.963	13.837	11.891	
32.436	18.837	0	0	0	0	18.837	13.599	13.599	
7.195	3.129	229	312	0	1.526	2.144	620	5.051	
12.082	8.780	843	892	0	173	10.342	1.497	1.740	
10.447	8.004	279	712	0	872	8.123	1.739	2.324	
477	415	8	9	0	5	427	49	50	
67	0	0	0	0	0	0	0	67	
0	330	27	0	-357	0	0	93	0	
845	267	53	54	355	0	729	71	116	
766	747	7	4	0	0	758	12	8	
31.879	21.672	1.446	1.983	-2	2.576	22.523	4.081	9.356	
2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0	
2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0	

SEGMENTBERICHTERSTATTUNG (IFRS)

Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern

	Lithografie		Substrat Bonder		Fotomaschinen Equipment	
in T€	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Außenumsatz	111.500	88.932	20.474	24.722	36.345	18.429
Innenumsatz	0	0	0	0	0	0
Gesamter Umsatz	111.500	88.932	20.474	24.722	36.345	18.429
Segmentergebnis (EBIT)	25.541	16.952	-11.085	-7.066	5.264	2.113
Ergebnis vor Steuern	25.468	16.896	-11.087	-7.072	5.260	2.106
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-) / Erträge	-831	-1.223	-2.394	-1.212	-393	-173
Segmentvermögen	57.893	56.311	36.229	30.102	17.593	17.315
davon Geschäfts- oder Firmenwert	13.599	13.599	0	0	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen						
Konzernaktiva						
Segmentsschulden	-21.800	-27.286	-8.500	-6.987	-6.065	-6.328
Nicht zugeordnete Konzernschulden						
Konzernschulden						
Abschreibungen	1.621	1.675	2.098	2.239	629	760
davon planmäßig	1.621	1.600	2.098	2.124	629	760
davon außerplanmäßig	0	75	0	115	0	0
Investitionen	1.418	1.450	921	501	329	2.178
Mitarbeiter zum 31.12.	340	324	136	141	106	91

Segmentinformationen nach Regionen

	Umsatzerlöse (fortgeführte Aktivitäten)		Investitionen		Vermögen	
in T€	2011	2010	2011	2010	2011	2010
Europa	40.160	36.687	2.607	8.369	107.201	83.839
Nordamerika	29.461	19.033	880	662	7.707	27.523
Japan	12.983	6.906	41	59	3.945	1.975
Sonstiges Asien	92.775	76.254	120	84	1.447	1.414
Rest	48	206	0	0	0	0
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	752	185
Gesamt	175.427	139.086	3.648	9.174	121.052	114.936

	Sonstige		Fortgeführte Aktivitäten		Nicht fortgeführte Aktivitäten (Test Business)		Konsolidierungseffekte		Summe	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
	7.108	7.003	175.427	139.086	382	1.774	0	0	175.809	140.860
	6.973	6.379	6.973	6.379	0	0	-6.973	-6.379	0	0
	14.081	13.382	182.400	145.465	382	1.774	-6.973	-6.379	175.809	140.860
	-1.145	2.315	18.575	14.314	-21	331	0	0	18.554	14.645
	-45	2.098	19.596	14.028	-23	330	0	0	19.573	14.358
	-44	-197	-3.662	-2.805	0	-29	0	0	-3.662	-2.834
	9.337	11.208	121.052	114.936	0	0	0	0	121.052	114.936
	0	0	13.599	13.599	0	0	0	0	13.599	13.599
									66.694	66.624
									187.746	181.560
	-2.126	-3.291	-38.491	-43.892	0	0	0	0	-38.491	-43.892
									-28.862	-31.265
									-67.353	-75.157
	2.003	1.527	6.351	6.201	0	14	0	0	6.351	6.215
	2.003	1.527	6.351	6.011	0	14	0	0	6.351	6.025
	0	0	0	190	0	0	0	0	0	190
	980	5.045	3.648	9.174	0	0	0	0	3.648	9.174
	42	60	624	616	0	0	0	0	624	616

Anhang zum IFRS – Konzernabschluss

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2011



(1) BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleissheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden ein international tätiges Unternehmen, das Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland sowie Waterbury (bis März 2011) und Palo Alto (bis Oktober 2011) in den USA und Neuchâtel in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbstständige Vertriebsgesellschaften in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

(2) ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

A) GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein börsennotiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2011 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

B) ERSTMALIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB und das International Financial Reporting Interpretations Committee haben den nachfolgenden Standard neu verabschiedet, der verpflichtend im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 anzuwenden ist und Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Gesellschaft hat:

„Improvements to IFRS (2009)“

Der Standard mit dem Titel „Improvements to IFRS (2009)“ fasst verschiedene kleinere Änderungen an bestehenden Standards zusammen, die aus einem Zyklus jährlicher Verbesserungen an den IFRS resultieren. Diese Änderungen haben keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss.

C) NICHT VORZEITIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB hat die nachfolgend dargestellten Standards, Interpretationen und Änderungen zu bestehenden Standards herausgegeben, deren Anwendung noch die Übernahme in EU-Recht („Endorsement“) erfordert:

IFRS 9: „Financial Instruments“

Im November 2009 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 9 „Financial Instruments“ zur Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten. Dieser Standard ist der erste Teil des dreiteiligen Projekts zur vollständigen Ablösung von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“. Im Oktober 2010 veröffentlichte das IASB Vorschriften zur Bilanzierung finanzieller Verbindlichkeiten, die den IFRS 9 „Financial Instruments“ ergänzen und die Phase zur Klassifizierung und Bewertung des IASB-Projekts zur Ablösung von IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ abschließen. Ergänzend zum IFRS 9 (2009) enthält der IFRS 9 (2010) Regelungen für die Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Verbindlichkeiten sowie zur Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten. Am 16. Dezember 2011 hat das IASB unter dem Titel „Verpflichtender Anwendungszeitpunkt und Anhangangaben bei Übergang“ Änderungen an IFRS 9 veröffentlicht.

Gemäß der Methodik von IFRS 9 sind finanzielle Vermögenswerte entweder zu fortgeführten Anschaffungskosten oder zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Die Zuordnung zu einer der beiden Bewertungskategorien hängt davon ab, wie das Unternehmen seine Finanzinstrumente steuert (sog. Geschäftsmodell) und welche Produktmerkmale die einzelnen finanziellen Vermögenswerte haben.

Der Standard ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2015 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards haben wird, sofern der Standard von der EU in dieser Form übernommen wird.

IAS 12: „Income Taxes“

Im Dezember 2010 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 12 „Income Taxes“. Die Änderungen enthalten eine teilweise Klarstellung zur Behandlung temporärer steuerlicher Differenzen im Zusammenhang mit der Anwendung des Zeitwertmodells von IAS 40.

IAS 12 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2012 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

IFRS 10: „Consolidated Financial Statements“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“, mit dem eine einheitliche Definition für den Begriff „Beherrschung“ und damit eine einheitliche Grundlage für das Vorliegen einer Mutter-Tochter-Beziehung und die hiermit verbundene Abgrenzung des Konsolidierungskreises geschaffen wird. Der neue Standard ersetzt die bisher relevanten IAS 27 (2008) „Consolidated and Separate Financial Statements“ und SIC-12 „Consolidation – Special Purpose Entities“.

IFRS 10 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 11 und IFRS 12 sowie mit den in 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

IFRS 11: „Joint Arrangements“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 11 „Joint Arrangements“. Der Standard regelt die Bilanzierung von Sachverhalten, in denen ein Unternehmen gemeinschaftliche Führung (joint control) über ein Gemeinschaftsunternehmen (joint venture) oder eine gemeinschaftliche Tätigkeit (joint operation) ausübt. Der neue Standard ersetzt IAS 31 „Interests in Joint Ventures“ und SIC-13 „Jointly Controlled Entities – Non-Monetary Contributions by Venturers“ als die bisher für Fragen der Bilanzierung von Gemeinschaftsunternehmen einschlägigen Vorschriften.

IFRS 11 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 10 und IFRS 12 sowie mit den in 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

IFRS 12: „Disclosure of Interests in Other Entities“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 12 „Disclosure of Interests in Other Entities“. Aus dem Standard ergeben sich die Anhangangaben zu Unternehmensverbindungen im Konzernabschluss (neuer IFRS 10) und Joint Arrangements (neuer IFRS 11).

IFRS 12 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist nur zeitgleich mit IFRS 10 und IFRS 11 sowie mit den in 2011 geänderten IAS 27 und IAS 28 zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

IAS 27 (2011): „Separate Financial Statements“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den geänderten Standard IAS 27 (2011) „Separate Financial Statements“. Im Rahmen der Verabschiedung des IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“ werden die Regelungen für das Kontrollprinzip und die Anforderungen an die Erstellung von Konzernabschlüssen aus dem IAS 27 ausgelagert und abschließend im IFRS 10 behandelt (siehe Ausführungen zu IFRS 10). Im Ergebnis enthält IAS 27 künftig nur die Regelungen zur Bilanzierung von Tochtergesellschaften, Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen in IFRS-Einzelabschlüssen.

IAS 27 (2011) ist – vorbehaltlich einer noch ausstehenden Übernahme in EU-Recht – verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

IAS 28 (2011): „Investments in Associates and Joint Ventures“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den geänderten Standard IAS 28 (2011) „Investments in Associates and Joint Ventures“. Im Rahmen der Verabschiedung des IFRS 11 „Joint Arrangements“ erfolgten auch Anpassungen des IAS 28, dessen Anwendungsbereich durch den neuen IFRS 11 erheblich erweitert wird.

IAS 28 (2011) ist – vorbehaltlich einer noch ausstehenden Übernahme in EU-Recht – verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

IFRS 13: „Fair Value Measurement“

Am 12. Mai 2011 veröffentlichte das IASB den neuen Standard IFRS 13 „Fair Value Measurement“. Der Standard befasst sich mit der Zeitwertermittlung sowie mit zugehörigen Anhangangaben und verfolgt das Ziel einer weiteren Annäherung der IFRS und der US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätze (US GAAP).

IFRS 13 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

IAS 19: „Leistungen an Arbeitnehmer“

Am 16. Juni 2011 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 19 „Leistungen an Arbeitnehmer“. Der geänderte Standard regelt, dass künftig unerwartete Schwankungen der Pensionsverpflichtungen sowie etwaiger Planvermögensbestände unmittelbar im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) erfasst werden müssen. Das bisherige Wahlrecht zwischen sofortiger Erfassung im Gewinn oder Verlust, im sonstigen Ergebnis (other comprehensive income) oder der zeitverzögerten Erfassung nach der sogenannten Korridormethode wird abgeschafft. Zudem werden derzeit die erwarteten Erträge des Planvermögens anhand der subjektiven Erwartungen des Managements über die Wertentwicklung des Anlageportfolios ermittelt. Mit Anwendung des geänderten IAS 19 ist nur noch eine typisierende Verzinsung des Planvermögens in Höhe des aktuellen Diskontierungszinssatzes der Pensionsverpflichtung zulässig.

Der geänderte IAS 19 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

Da die SÜSS MicroTec AG derzeit die Korridormethode anwendet, würde die Änderung – bei Anwendung auf die Verhältnisse zum 31. Dezember 2011 – zu einer Erhöhung der Pensionsrückstellung um T€ 632 führen. Mit dem Wechsel von der Korridormethode hin zur geänderten Methode bleibt die Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS MicroTec AG zukünftig frei von Effekten aus versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten (z. B. aufgrund von Zinsschwankungen), da diese dann zwingend im sonstigen Ergebnis zu erfassen sind.

IAS 1: „Darstellung des Abschlusses“

Am 16. Juni 2011 veröffentlichte das IASB Änderungen des IAS 1 „Darstellung des Abschlusses“. Nach dem geänderten Standard ist zukünftig die IFRS-Erfolgsrechnung formal als ein einziger Abschlussbestandteil darzustellen, dem „Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income“. Gleichwohl muss diese formal zusammengefasste Erfolgsrechnung künftig verpflichtend in zwei Sektionen unterteilt werden, die zum einen den Gewinn oder Verlust und zum anderen das sonstige Ergebnis ausweisen. Zudem verlangt der geänderte Standard, dass die Bestandteile des sonstigen Ergebnisses separat dargestellt werden als Posten, die später in die Gewinn- und Verlustrechnung reklassifiziert werden und Posten, die niemals reklassifiziert werden, sondern im sonstigen Ergebnis verbleiben.

Der geänderte IAS 1 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2012 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

IAS 32: „Finanzinstrumente: Darstellung“

Am 16. Dezember 2011 veröffentlichte das IASB eine Ergänzung zum IAS 32 „Finanzinstrumente: Darstellung“, die die Voraussetzungen für die Saldierung von Finanzinstrumenten klarstellt. Zusammen mit diesen Klarstellungen wurden auch die Vorschriften zu den Anhangangaben im IFRS 7 erweitert.

Die Ergänzung zu IAS 32 ist verpflichtend retrospektiv anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2014 beginnen. Die Änderung des IFRS 7 ist erstmals anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen wird, keine Auswirkungen.

Der nachfolgend dargestellte geänderte Standard wurde bereits von der EU-Kommission in EU-Recht übernommen, ist jedoch im Geschäftsjahr 2011 noch nicht verpflichtend anzuwenden. Von einer vorzeitigen Anwendung des geänderten Standards wurde kein Gebrauch gemacht.

IFRS 7: „Anhangangaben – Übertragungen finanzieller Vermögenswerte“

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 23. November 2011 wurde die Verordnung Nr. 1205 / 2011 bekannt gemacht, mit der die vom IASB am 7. Oktober 2010 veröffentlichten Änderungen an IFRS 7 „Anhangangaben – Übertragungen finanzieller Vermögenswerte“ übernommen wurden. Die Änderungen an IFRS betreffen erweiterte Angabepflichten bei der Übertragung finanzieller Vermögenswerte und sollen den Bilanzadressaten ein besseres Verständnis der Auswirkungen der beim Unternehmen verbleibenden Risiken ermöglichen.

Der geänderte IFRS 7 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2011 beginnen; eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

D) WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des „true and fair views“ sowie der „fair presentation“. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zu Grunde gelegt:

Geschäfts- oder Firmenwert

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS MicroTec-Konzern den Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag eines Segments auf der Basis des Nutzungswerts errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswerts ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS MicroTec-Gruppe nicht vor.

Sachanlagen

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwerts aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrags getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

Vorräte

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswerts.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

Finanzinstrumente

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS MicroTec-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Darüber hinaus werden Wertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur überfälliger Forderungen gebildet. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

Wertpapiere

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monate haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Aktienbasierte Vergütungen

Die Gesellschaft bilanziert ihre Verpflichtungen aus den bestehenden Aktienoptionsplänen gemäß IFRS 2. Der Zeitwert der ausgegebenen Aktienoptionen wird unter Berücksichtigung des Erdienungszeitraums aufwandswirksam im Eigenkapital erfasst. Die Ermittlung des Zeitwerts erfolgt dabei auf Grundlage des Black-Scholes-Modells.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert. Die Verpflichtungen werden mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (Planvermögen). Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste werden erst erfolgswirksam verrechnet, wenn sie außerhalb einer Bandbreite von 10 % des Verpflichtungsumfangs liegen. In diesem Fall werden sie über die künftige durchschnittliche Restdienstzeit der Belegschaft verteilt. Die Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsverpflichtungen werden als Bestandteil der jeweiligen Funktionskosten ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrags zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

Finanzschulden

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und aus den Schuldscheindarlehen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Nicht fortgeführte Aktivitäten

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

Umsatzrealisierung

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 erfasst, wenn die Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung erfüllt sind. Umsatzerlöse werden zum Zeitpunkt der Übertragung der maßgeblich mit dem Eigentum der verkauften Ware verbundenen Risiken und Chancen auf den Käufer realisiert, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft der wirtschaftliche Nutzen aus dem Verkauf zufließen wird. Die Höhe der erfassten Umsatzerlöse basiert auf den beizulegenden Zeitwerten der zu erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung.

Kundenaufträge der Gesellschaft beinhalten in der Regel Installationsleistungen, die notwendig sind, um die verkaufte Maschine in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Aufgrund der Komplexität der Installationsvorgänge geht die Gesellschaft davon aus, dass signifikante Eigentumsrisiken bis zum Abschluss der Installation beim Unternehmen verbleiben. Daher wird bei Verträgen, bei denen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und die Endabnahme mit dem Kunden vereinbart ist, der Umsatz erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind und die Endabnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

Umsatzkosten

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

Forschungs- und Entwicklungskosten

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

Latente Steuern

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

Derivative Finanzinstrumente

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS MicroTec-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im Kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

Cashflow Hedges

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im Kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Bilanzierung von Zuschüssen

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden aktivisch abgesetzt.

Transaktionen in Fremdwährung

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

E) VERWENDUNG VON SCHÄTZUNGEN

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunktorentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2011 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen T€ 546 (2010: T€ 740).

Wertminderungen

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum errechnet sich dabei ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 19,0% (2010: 18,9%).

Die hohe Wachstumsrate ist zum einen zurückzuführen auf die außerordentlich hohen Umsatzzuwächse, die im Bereich Substrat Bonder erwartet werden. Zum anderen werden auch für den Bereich Lithografie, der den größten Geschäftsbereich der SÜSS MicroTec-Gruppe darstellt, weiterhin hohe Zuwachsraten unterstellt. Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 10,1% (2010: 10,4%) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrundeliegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

Rückstellungen

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

Purchase Price Allocation

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis für den Unternehmenserwerb auf die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte Vergütungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

F) KONSOLIDIERUNG

Konsolidierungsgrundsätze

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2011		2010	
	Bilanz	GuV	Bilanz	GuV
1 EUR vs 1 USD	1,294	1,394	1,339	1,330
1 EUR vs 1 JPY	100,100	111,148	108,820	116,688
1 EUR vs 1 GBP	0,837	0,871	0,862	0,858
1 EUR vs 1 CHF	1,216	1,234	1,253	1,379
1 EUR vs 1 TWD	39,338	41,101	38,964	41,793
1 EUR vs 1 SGD	1,682	1,750	1,717	1,812
1 EUR vs 1 CNY	8,234	9,016	8,763	9,004
1 EUR vs 1 KRW	1.495,670	1.544,865	1.502,610	1.541,242
1 EUR vs 1 THB	40,775	42,850	40,525	42,563

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (Kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

Angaben zum Konsolidierungskreis

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2010 ergab sich folgende Veränderung im Konsolidierungskreis:

Die SÜSS MicroTec Asia Company Ltd., Bangkok (Thailand) wurde im dritten Quartal 2011 liquidiert und zum 28. Juli 2011 entkonsolidiert. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft wurde bereits 2009 stillgelegt.

Weitere Veränderungen im Konsolidierungskreis ergaben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung):

Gesellschaft	Währung	gezeichnetes		Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
		Kapital	Beteiligung			
SÜSS MicroTec AG, Garching ⁽¹⁾	EUR	19.101.028,00	Holding	90.883.717,25	-1.500.351,76	voll
Suss MicroTec Lithography GmbH, Garching ⁽²⁾	EUR	2.000.100,00	100 %	61.168.527,53	10.221.025,64	voll
HamaTech APE GmbH & Co. KG, Sternenfels	EUR	3.000.000,00	100 %	-1.462.949,51	2.815.652,38	voll
HamaTech APE Beteiligungs GmbH, Sternenfels	EUR	25.000,00	100 %	17.631,64	-911,52	voll
Suss MicroTec Ltd., Coventry	GBP	10.000,00	100 %	1.140.788,07	-30.127,27	voll
Suss MicroTec KK, Yokohama	JPY	30.000.000,00	100 %	-256.533.347,00	39.817.571,00	voll
Suss MicroTec S.A.S., Lyon	EUR	114.750,00	100 %	720.783,00	265.345,00	voll
Suss MicroOptics S.A., Neuchâtel	CHF	500.000,00	85 %	6.243.301,97	2.311.059,88	voll
Suss MicroTec Inc., Sunnyvale	USD	105.000,00	100 %	21.000.329,85	-16.018.305,78	voll
Suss MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsin Chu	TWD	5.000.000,00	100 %	130.272.316,00	39.873.949,00	voll
Suss MicroTec Company Ltd., Shanghai	CNY	1.655.320,00	100 %	16.810.531,57	8.773.162,48	voll
SÜSS MicroTec Precision Photomask Inc., Palo Alto	USD	24.287,00	100 %	792.207,26	-1.105.908,15	voll
HUGLE Lithography Inc., San Jose ⁽³⁾	USD	1.190.442,00	53,1%	-39.579,00	-1.800,00	at cost
Suss MicroTec ReMan GmbH, Oberschleisheim ⁽²⁾	EUR	25.564,59	100 %	1.247.477,69	1.041.605,63	voll
Suss MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100 %	1.391.171,92	1.144.279,57	voll
Suss MicroTec Korea Co. Ltd., Seoul	KRW	50.000.000,00	100 %	587.675.273,00	281.098.347,00	voll
ELECTRON MEC. S.R.L., Mailand ⁽⁴⁾	EUR	52.000,00	10 %	1.059.803,00	-103.510,00	at cost

⁽¹⁾ Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisabführungsverträge mit der Suss MicroTec Lithography GmbH und der Suss MicroTec ReMan GmbH

⁽²⁾ Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrags mit der SÜSS MicroTec AG

⁽³⁾ aufgrund Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

⁽⁴⁾ Zahlen laut Jahresabschluss 31.12.2010

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Von den inländischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft haben die Suss MicroTec Lithography GmbH, Garching und die Suss MicroTec ReMan GmbH, Oberschleisheim, die gemäß § 264 Abs. 3 HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Die HamaTech APE GmbH & Co. KG (in der Rechtsform der Personengesellschaft) hat die gemäß § 264b HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Unternehmenserwerbe

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2011 keine Akquisitionen vorgenommen.

Im Vorjahr erwarb die SÜSS MicroTec AG mit Wirkung vom 15. Februar 2010 100 % der Anteile an der HamaTech APE GmbH & Co. KG, Sternenfels, sowie der HamaTech APE Beteiligungs GmbH, Sternenfels, von der Singulus Technologies AG. Daneben hat die SÜSS MicroTec AG auch das Betriebsgrundstück und die Firmengebäude am Standort Sternenfels sowie ein Gesellschafterdarlehen mit einem Nennwert von rund 10,1 Mio. € erworben.

Der Kaufpreis für das Betriebsgrundstück und die Firmengebäude belief sich auf 4,5 Mio. €. Der Kaufpreis für die Anteile an der HamaTech APE GmbH & Co. KG und das Gesellschafterdarlehen setzte sich zusammen aus einer fixen Komponente in Höhe von rund 3,5 Mio. € und einer Earn-Out-Komponente in Höhe von 1 Mio. €. Darüber hinaus hat die SÜSS MicroTec AG weitere Intercompany-Forderungen der Singulus Technologies AG in Höhe von rund 1,0 Mio. € abgelöst, die aus der laufenden Geschäftstätigkeit der HamaTech APE GmbH & Co. KG seit dem 1. Januar 2010 resultierten. Bereits im ersten Quartal 2010 hat die SÜSS MicroTec AG den kompletten (fixen) Kaufpreis von rund 9,0 Mio. € bezahlt.

Der Erwerb der Anteile und Vermögenswerte bzw. Schulden wurde im Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG nach den International Financial Reporting Standards als Unternehmenszusammenschluss gemäß IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) abgebildet. In diesem Zusammenhang sind die erworbenen Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden (mit einzelnen Ausnahmen) zu ihrem beizulegenden Zeitwert im Erwerbszeitpunkt anzusetzen (IFRS 3.18). Hierbei sind – nach den Vorschriften des IFRS 3 in Verbindung mit IAS 38 – nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

Vor diesem Hintergrund wurde im Vorjahr für die erworbenen Vermögenswerte und Schulden eine Purchase Price Allocation durchgeführt. Die erworbenen Vermögenswerte und Schulden wurden im Erstkonsolidierungszeitpunkt im Vorjahr wie folgt angesetzt:

in Mio €	Buchwert nach IFRS per 28.02.2010	Bei Erwerb angesetzt (gemäß PPA)
Immaterielle Vermögenswerte	3,1	1,3
Sachanlagen	0,3	0,4
Kurzfristige Vermögenswerte	7,6	7,6
Summe Vermögenswerte	11,0	9,3
Langfristige Schulden	0,0	0,0
Kurzfristige Schulden	2,6	2,6
Summe Schulden	2,6	2,6
Nettovermögen	8,4	6,7
Anschaffungskosten		4,5
Rückstellungen für Earn-Out		0,8
Badwill		1,4

Die bisher unter den immateriellen Vermögenswerten angesetzten aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 2,7 Mio. € wurden im Erwerbszeitpunkt mit 0 € bewertet. Stattdessen wurden bislang noch nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 0,9 Mio. € aktiviert, die zum größten Teil die erworbene Technologie betrafen. Die Bewertung der Technologie basierte auf einer Planung für die Jahre 2010 bis 2013 und den daraus resultierenden Zahlungsströmen. Darüber hinaus wurden stille Reserven in den Sachanlagen in Höhe von 0,1 Mio. € aufgedeckt.

Da die Summe der beizulegenden Zeitwerte der angesetzten identifizierten Vermögenswerte und Schulden die Anschaffungskosten überstieg, ergab sich aus dem Unternehmenszusammenschluss ein Badwill, der gemäß IFRS 3 im Vorjahr erfolgswirksam erfasst wurde.

Im Rahmen des Kaufs der HamaTech APE GmbH & Co. KG ist eine Eigenkapitalgarantie des Verkäufers, der Singulus Technologies AG dahingehend abgegeben worden, dass das Eigenkapital der HamaTech APE GmbH & Co. KG nach HGB zum Zeitpunkt des Closings einen bestimmten Betrag nicht unterschreiten wird. Die Eigenkapitalgarantie wurde verfehlt. Im Rahmen einer Vergleichsvereinbarung haben sich Käufer und Verkäufer auf einen Ausgleich in Form einer nachträglichen Kaufpreisanpassung geeinigt. Zum einen hat die Singulus Technologies AG vom bereits erhaltenen Kaufpreis 0,7 Mio. € an die SÜSS MicroTec AG zurückerstattet. Zum anderen wurde die Earn-Out-Komponente von bisher 1 Mio. € auf einen Betrag von 0,3 Mio. € reduziert.

Durch die mit Singulus Technologies AG geschlossene Vergleichsvereinbarung reduzierte sich die Rückstellung für die Earn-Out-Komponente auf 0,3 Mio. €. Der Badwill erhöhte sich auf 2,7 Mio. €. Der Badwill wurde gemäß IFRS 3,34 im Vorjahr erfolgswirksam unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Das der Earn-Out-Komponente zugrunde liegende Umsatzziel der HamaTech APE GmbH & Co. KG wurde im Geschäftsjahr 2010 erreicht. Damit war die SÜSS MicroTec AG verpflichtet, der Singulus Technologies AG den vereinbarten Earn-Out in Höhe von 0,3 Mio. € auszusahlen. Im Konzernabschluss wurde im Vorjahr eine Verbindlichkeit in entsprechender Höhe passiviert.

In die Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres sind die Erträge und Aufwendungen der HamaTech APE GmbH & Co. KG der Monate März bis Dezember 2010 eingeflossen. In diesem Zeitraum trug der Bereich Fotomasken Equipment mit Umsätzen in Höhe von 18,4 Mio. € und einem Ergebnis von 1,6 Mio. € zum Konzernergebnis nach Steuern bei. Hätte die SÜSS MicroTec AG die HamaTech bereits zum Beginn der Vorjahresperiode erworben, hätten sich im Vorjahr Konzernumsätze von 139,4 Mio. € und ein Konzernergebnis nach Steuern von 12,9 Mio. € ergeben.

G) NICHT FORTGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN

Im Vorjahr hat sich die SÜSS MicroTec AG von ihrem Geschäft mit Test Systemen getrennt und das Segment Test Systeme zum 28. Januar 2010 veräußert. Wesentlicher Bestandteil der Transaktion waren die Anteile an der Suss MicroTec Test Systems GmbH. Zudem wurden einzelne Vermögenswerte von Auslandstöchtern veräußert, die ebenfalls dem Bereich Test Systeme zugeordnet waren.

Der Kaufpreis für das Segment Test Systeme bestand aus einem festen und einem treuhänderisch verwalteten Anteil. Die fixe Komponente betrug 4,5 Mio. €, wovon 2,0 Mio. € in bar und 2,5 Mio. € in Stammaktien der Käuferin (Cascade Microtech Inc.) bezahlt wurden. Ein weiterer Betrag von 2,5 Mio. € wurde auf ein Treuhandkonto eingestellt, dessen Auszahlung von bestimmten Bedingungen abhängig war, die nach der Transaktion von dem Verkäufer erfüllt werden mussten und zu einer entsprechenden Kaufpreisanpassung führten. Bis zum 31. Dezember 2011 sind der SÜSS MicroTec AG aus diesem Treuhandkonto 0,8 Mio. € zugeflossen. Darüber hinaus hat die SÜSS MicroTec AG aus Kaufpreisanpassungen 0,8 Mio. € erhalten. Von dem Gesamtbetrag von insgesamt 1,6 Mio. € wurden 2009 bereits 1,0 Mio. € im Rahmen der Bewertung der zur Veräußerung bestimmten Vermögenswerte und Schulden berücksichtigt. Die Treuhandkonten weisen zum Stichtag einen verbleibenden Betrag in Höhe von 1,5 Mio. € aus, die im Februar 2012 an die SÜSS MicroTec AG ausbezahlt wurden.

Zum 27. Januar 2010 wurde die Suss MicroTec Test Systems GmbH entkonsolidiert. Der Gewinn aus der Entkonsolidierung belief sich im Vorjahr auf 1,6 Mio. €. Insgesamt belief sich das EBIT des Segments Test Systeme (nicht fortgeführte Aktivitäten) im Geschäftsjahr 2010 auf 0,3 Mio. €.

Das Ergebnis des Segments Test Systeme, das in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen wurde, stellte sich wie folgt dar:

in T€	2011	2010
Umsatzerlöse	382	1.774
Kosten und Aufwendungen	-403	-3.085
Gewinn aus Entkonsolidierung	0	1.641
Gewinn / Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten vor Ertragsteuern	-21	330
Ertragsteuern	0	2
Gewinn/Verlust aus nicht fortgeführten Aktivitäten nach Ertragsteuern	-21	332

Risikoberichterstattung

Auf die Ausführungen zur Risikoberichterstattung im Lagebericht wird verwiesen. Diese sind als Bestandteil dieses Anhangs zu betrachten.

ERLÄUTERUNGEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die folgenden Erläuterungen zur Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns.

(3) UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Maschinen	147.846	111.966
Ersatzteile und Upgrades	13.825	13.460
Serviceleistungen	7.438	6.754
Sonstige	6.318	6.905
Umsatzerlöse	175.427	139.085

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus dem Maskengeschäft und aus dem Bereich Mikrooptik.

(4) UMSATZKOSTEN

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von T€ 2.518 (2010: T€ 2.383) enthalten. Die Abschreibungen betreffen mit T€ 768 (2010: T€ 809) Entwicklungsprojekte im Bereich Lithografie und mit T€ 1.750 (2010: T€ 1.574) den Bereich Substrat Bonder. Darüber hinaus sind in den Umsatzkosten planmäßige Abschreibungen auf die erworbene Technologie der HamaTech in Höhe von T€ 256 (2010: T€ 213) enthalten.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von T€ 3.817 (2010: T€ 2.278) eingeflossen. Dabei entfallen T€ 1.071 (2010: T€ 1.085) auf Bestände des Bereichs Lithografie und T€ 2.371 (2010: T€ 1.056) auf Bestände des Bereichs Substrat Bonder. Die Bestände des Bereichs Fotomasken Equipment wurden um T€ 375 (2010: T€ 137) abgewertet.

(5) SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Fremdwährungsgewinne	3.562	5.475
Kommissionen	334	231
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	241	0
Kfz-Sachbezüge	197	190
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	127	0
Sonstige Zuschüsse	20	76
Rückstellungsaufösungen	0	29
Badwill Erstkonsolidierung HamaTech	0	2.678
Stornogebühren von Kunden	0	718
Ausbuchung von Verbindlichkeiten (Verzicht des Gläubigers)	0	464
Sonstiges	286	135
Sonstige betriebliche Erträge	4.767	9.996

Die Fremdwährungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus verschiedenen Geschäftsvorfällen im operativen Bereich, die in Fremdwährung abgewickelt wurden (vorwiegend in US-Dollar und japanischen Yen) und durch die unterjährige Veränderung der Wechselkurse beeinflusst waren. Zudem realisierte das Unternehmen Kursgewinne aus der Devisenkursicherung.

Im Vorjahr resultierten T€ 1.821 der Fremdwährungsgewinne aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten durch die Süss MicroTec Inc., Waterbury, im Zusammenhang mit der im Dezember 2010 erfolgten Übertragung von immateriellen Vermögenswerten an die Süss MicroTec Lithography GmbH.

Die Kommissionen wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt. Im Vorjahr erzielte daneben auch unsere Tochtergesellschaft in Taiwan Kommissionserträge.

Die sonstigen Zuschüsse betreffen Zuschüsse der Arbeitsagentur für Eingliederungsmaßnahmen und Altersteilzeit. Im Vorjahr erhielt das Unternehmen Aufwandszuschüsse aus Förderprojekten, welche ergebniswirksam zu vereinnahmen waren.

Im Vorjahr entstanden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Im Vorjahr wurden die Stornogebühren von der Süss MicroTec Inc., Waterbury, vereinnahmt.

Im Vorjahr wurden Erträge aus der Ausbuchung von bestehenden Verbindlichkeiten realisiert. Diese standen im Zusammenhang mit der Bereinigung von Verrechnungskonten zwischen der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der Singulus Technologies AG. In diesem Zusammenhang wurden im Vorjahr auch Forderungen in Höhe von T€ 306 ausgebucht (erfasst unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen).

(6) SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Fremdwährungsverluste	3.856	2.731
Sonstige Steuern	283	522
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	262	0
Vertragsstrafen	125	0
Lizenzgebühren	101	0
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	50	385
Aufwendungen für Forderungsverzicht	0	306
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	263
Aufwendungen für Mitarbeiterentsendungen	0	143
Sonstiges	217	359
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.894	4.709

Die Fremdwährungsverluste entstanden im Wesentlichen aus Bewertungsänderungen von Kundenforderungen in US-Dollar aufgrund unterjährig veränderter Wechselkurse sowie aus Bewertungsänderungen von konzerninternen Verrechnungskonten in Fremdwährung. Darüber hinaus sind dem Unternehmen Kursverluste aus Devisenkurssicherungsgeschäften entstanden.

Die Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen betreffen eine Maschine der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. Sämtliche Vermögenswerte und Schulden der SUSS MicroTec Precision Photomask Inc. wurden im vierten Quartal im Rahmen eines Asset Deals veräußert.

Die Lizenzgebühren betreffen ebenfalls die SUSS MicroTec Precision Photomask Inc.

Im Vorjahr standen die Aufwendungen für Forderungsverzicht im Zusammenhang mit der Bereinigung von Verrechnungskonten zwischen der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der Singulus Technologies AG. In diesem Zusammenhang wurden im Vorjahr auch Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 464 ausgebucht (erfasst unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen).

(7) FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie sonstigen Finanzaufwendungen und sonstigen Finanzerträgen zusammen.

Die Finanzaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in T€	2011	2010
Bankverbindlichkeiten	749	676
Zinsswaps	-137	51
Bezahlte Stückzinsen	186	14
Zinsen für Finanzierungsleasing	49	78
Avalprovisionen	67	46
Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	82	75
Finanzaufwendungen	996	940

Die Höhe der gesamten Finanzaufwendungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht. Die Zinsen für Bankverbindlichkeiten haben sich um rund T€ 73 erhöht, während sich für die Zinsswaps, die im Zusammenhang mit dem Schuldscheindarlehen stehen, im Berichtsjahr ein positiver Effekt und damit ein Ertrag in Höhe von insgesamt T€ 137 ergab. Die Erhöhung der Bankzinsen resultierte im Wesentlichen aus zusätzlichen Zinsaufwendungen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels, da im Berichtsjahr für dieses Darlehen erstmals Zinsen für volle 12 Monate anfielen.

Die Finanzerträge enthalten Zinserträge in Höhe von T€ 1.184 (2010: T€ 654), die im Wesentlichen aus Geldmarktanlagen sowie Wertpapieren resultieren. In 2011 sind hier auch die Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf der Cascade-Aktien in Höhe von T€ 833 erfasst.

(8) ERTRAGSTEUERN

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in T€	2011	2010
Laufender Steueraufwand	2.223	4.802
Latenter Steuerertrag (-) / -aufwand	3.566	-3.809
... davon auf temporäre Differenzen	1.827	-268
Gesamtaufwand	5.789	993

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

Angenommener Steuersatz	2011	2010
Körperschaftsteuer	15,00 %	15,00 %
Solidaritätszuschlag	5,50 %	5,50 %
Gewerbsteuer	12,43 %	12,43 %
Kombinierter Steuersatz	28,25 %	28,25 %

in T€	2011	2010
Ergebnis vor Steuern	19.596	14.028
Erwartete Ertragsteuern	5.536	3.963
Abweichende Steuersätze im Ausland	-866	5
Gewerbsteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	44	62
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	75	201
Steueraufwand Vorjahre	49	1.351
Veränderung in der Realisierbarkeit latenter Steueransprüche	0	-1.721
Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern	1.668	1.238
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	-359	-3.541
Steuerfreie Erträge	-270	-464
Dem Organträger zuzurechnendes Einkommen aus nicht fortgeführten Aktivitäten	-6	94
Sonstiges	-82	-195
Effektive Ertragsteuern	5.789	993

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von T€ 253 (2010: T€ -2.970). Statt einen Steueraufwand in Höhe von T€ 5.536 auszuweisen, verbuchte das Unternehmen im Berichtsjahr einen Steueraufwand in Höhe von T€ 5.789.

Im Berichtsjahr wurden zusätzliche Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von T€ 1.668 gebildet. Der größte Wertberichtigungsbedarf entstand bei der Suss MicroTec Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA), für die auf Basis der aktuellen Konzernplanung in den nächsten Jahren ein konstant positives, jedoch geringeres Ergebnis erwartet wird. Grund für das geringere Ergebnis ist unter anderem auch das geänderte Geschäftsmodell der Suss MicroTec Inc., die zukünftig als Repräsentant den Vertrieb unserer Produkte im nordamerikanischen Raum durchführen wird. Bisher war die Suss MicroTec Inc. als Reseller tätig.

Der positive Steuereffekt aus der Erzielung von steuerfreien Erträgen ist im Wesentlichen auf die Veräußerung von 747.530 Cascade-Aktien zurückzuführen, die bei der SÜSS MicroTec AG einen steuerfreien Veräußerungsgewinn in Höhe von T€ 833 erzeugten.

Der positive Effekt aus der Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge resultiert aus einem positiven Jahresergebnis der Süss MicroTec KK, Yokohama (Japan) sowie der Süss MicroTec S.A.S., Lyon (Frankreich).

Im Vorjahr beliefen sich die tatsächlichen Steuern lediglich auf T€ 993, während die erwarteten Steuern rund T€ 3.963 betragen. Damit wurden im Vorjahr T€ 2.970 weniger Steuern erfasst als erwartet.

Der positive Effekt resultierte im Vorjahr im Wesentlichen aus der Verlagerung des Geschäftsbereichs Substrat Bonder von den USA nach Deutschland und dem damit im Zusammenhang stehenden Verkauf der immateriellen Vermögenswerte von der Süss MicroTec Inc., Waterbury / Vermont (USA) an die Süss MicroTec Lithography GmbH, Sternfels. Durch den Verkauf wurden bei der Süss MicroTec Inc. 2010 (für die steuerliche Ergebnisrechnung) stille Reserven in Höhe von rund 22 Mio. USD aufgedeckt. Der dadurch in den USA angefallene Ertrag konnte durch die Nutzung der dort vorhandenen Verlustvorträge vollständig steuerfrei vereinnahmt werden. Da die aktiven latenten Steueransprüche auf diese Verlustvorträge in den Jahren vor 2010 komplett wertberichtigt waren, ergab sich im Vorjahr ein positiver latenter Steuereffekt von T€ 3.298. Die bis dahin auf die aktivierten Entwicklungskosten gebildeten passiven latenten Steuern konnten vollständig ergebniswirksam aufgelöst werden. Durch die Umstrukturierung und Verlagerung des Substrat Bonder Bereichs von den USA nach Deutschland veränderte sich außerdem die Einschätzung der Realisierbarkeit latenter Steueransprüche der Süss MicroTec Inc. in den USA. Daraus resultierte im Vorjahr insgesamt ein positiver Steuereffekt in Höhe von T€ 1.721.

Gegenläufig wirkten sich in 2010 verschiedene Vorjahresanpassungen der steuerlichen Net Operating Losses der Süss MicroTec Inc. aus, die zu einem zusätzlichen latenten Steueraufwand von T€ 1.482 führten. Die Süss MicroTec Precision Photomask Inc., Palo Alto / Kalifornien (USA), realisierte hingegen 2010 durch einen Verlustrücktrag einen positiven Steuereffekt in Höhe von T€ 305.

Die Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern betraf im Vorjahr im Wesentlichen die Süss MicroTec KK, Yokohama (Japan). Die in 2010 entstandenen Verluste erhöhen die steuerlichen Verlustvorträge. Die darauf zu bildenden aktiven latenten Steuern von T€ 1.026 wurden zu 100 % wertberichtigt.

Aus der Entkonsolidierung der SÜSS MicroTec Test Systems GmbH realisierte die SÜSS MicroTec AG im Vorjahr einen Entkonsolidierungsgewinn in Höhe von T€ 1.641, der als steuerfreier Ertrag zu einem positiven latenten Steuereffekt in Höhe von T€ 464 führte.

Der nicht fortgeführte Bereich Test Systeme bzw. die Süss MicroTec Test Systems GmbH bildete bis zum Vollzug der Transaktion eine ertragsteuerliche Organshaft mit der SÜSS MicroTec AG. Im Vorjahr resultierte aus dem Bereich Test Systeme ein positives Ergebnis in Höhe von T€ 332; der darauf entfallende Steueraufwand betrug T€ 94.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

in T€	Aktiva		Passiva	
	2011	2010	2011	2010
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	284	1.173	0	98
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	630	687	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13	56	111	40
Langfristige Rückstellungen	20	376	62	0
Immaterielle Vermögenswerte	2.551	2.928	21	193
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	15	1	0	108
Finanzschulden	11	5	0	0
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	1.807	1.571
Passiver Ausgleichsposten HamaTech	0	0	515	542
Vorräte	698	809	0	58
Sachanlagen	5	0	113	46
Sonstiges	57	0	128	85
Verlustvorträge	1.099	2.838	0	0
Gesamt	5.383	8.873	2.757	2.741

Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von T€ 21.054 (2010: T€ 25.220). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2019 insgesamt T€ 6.106. Im Zeitraum von 2028 bis 2031 verfallen insgesamt T€ 11.213. Verlustvorträge in Höhe von T€ 3.735 sind unbegrenzt nutzbar.

Der Rückgang der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Süss MicroTec Lithography GmbH sowie der Süss MicroTec ReMan GmbH, deren positives Jahresergebnis aufgrund der bestehenden Ergebnisabführungsverträge die Verlustvorträge der SÜSS MicroTec AG mindern.

Für Verlustvorträge in Höhe von T€ 17.906 (2010: T€ 15.336) und temporäre Differenzen in Höhe von T€ 3.409 (2010: T€ 1.588) wurden keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

(9) ERGEBNIS JE AKTIE

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in T€	2011	2010
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten	13.807	13.035
Abzüglich: Minderheitsanteile	-273	-137
Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten, der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	13.534	12.898
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (Stück)	18.908.799	18.072.913
Effekt aus der (potenziellen) Ausübung von Aktienoptionen (Stück)	14.510	402.000
Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück)	18.923.309	18.474.913
Ergebnis je Aktie in EUR aus fortgeführten Aktivitäten – unverwässert	0,72	0,71
Ergebnis je Aktie in EUR aus fortgeführten Aktivitäten – verwässert	0,71	0,70

In die Berechnung des Ergebnisses je Aktie (verwässert) wurde der gewichtete Durchschnitt von 186.800 Aktien (2010: 390.214 Aktien) nicht mit einbezogen, da die Ausübungsvoraussetzungen im Berichtsjahr nicht erfüllt waren.

Weitere Informationen zu den Aktienoptionsprogrammen finden sich im Anhang unter Textziffer 21.

(10) SONSTIGE ANGABEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

PERSONALAUFWAND

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS MicroTec-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in T€	2011	2010
Löhne und Gehälter	39.826	34.294
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.436	3.904
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.426	2.339
Personalaufwand	45.688	40.537

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

MATERIALAUFWAND

Die Materialaufwendungen betragen in 2011 T€ 91.111 (2010: T€ 70.590).

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Immaterielle Vermögenswerte	4.211	4.218
Sachanlagen	2.140	1.983
Abschreibungen	6.351	6.201

Neben aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von T€ 2.518 (2010: T€ 2.383) wurden im Geschäftsjahr Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von T€ 550 (2010: T€ 543) abgeschrieben. Außerdem wurden Abschreibungen auf die zum 1. Oktober 2009 an eine Leasinggesellschaft verkaufte und zurückgeleaste SAP-Software in Höhe von T€ 887 (2010: T€ 887) vorgenommen. Darüber hinaus entstanden Abschreibungen auf die im Rahmen der Unternehmensakquisition HamaTech erworbene Technologie und weiterer erworbener immaterieller Vermögenswerte in Höhe von T€ 256 (2010: T€ 405).

In den Abschreibungen des Vorjahres auf Sachanlagen waren außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 190 enthalten, die Mietereinbauten an den aufgegebenen Standorten Vaihingen und Waterbury betrafen.

Die auf aktivierte Entwicklungsleistungen vorgenommenen Abschreibungen betreffen ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN AKTIVA

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns.

(11) IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von T€ 3.122 (2010: T€ 4.308) Entwicklungsleistungen von T€ 5.446 (2010: T€ 7.583) ausgewiesen.

In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das geleaste SAP-System mit einem Restbuchwert von T€ 961 (2010: T€ 1.848) enthalten.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen in den Segmenten Lithografie und Substrat Bonder.

(12) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von T€ 13.599 (2010: T€ 13.599) entfällt in voller Höhe auf das Segment Lithografie und enthält keinen Fremdwährungsanteil.

(13) SACHANLAGEN

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von T€ 101 (2010: T€ 124) auch geleaste technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung und geleaster Fuhrpark enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrundeliegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

(14) SONSTIGE (LANGFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten vor allem Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen und von Zeitkontenrückdeckungen sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

in T€	2011	2010
Rückdeckungsversicherung	380	305
Kautionen	212	179
Sonstiges	0	1
Sonstige langfristige Vermögenswerte	592	485

(15) VORRÄTE

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in T€	2011	2010
Materialien und Hilfsstoffe	24.382	23.175
Unfertige Erzeugnisse	23.128	23.802
Fertigerzeugnisse	19.970	17.842
Demonstrationsgeräte	12.469	10.991
Handelswaren	211	130
Wertberichtigungen	-8.528	-11.509
Vorratsvermögen	71.632	64.431

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2011 bilanzierten Vorräte in Höhe von T€ 71.632 (2010: T€ 64.431) sind T€ 7.210 (2010: T€ 13.469) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

Der Betrag der Vorräte, die in den Geschäftsjahren 2011 und 2010 als Aufwand erfasst wurden, entspricht im Wesentlichen dem Betrag der Umsatzkosten des jeweiligen Geschäftsjahres.

(16) FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in T€	2011	2010
Forderungen gegen Dritte	18.336	16.399
Wertberichtigungen	-546	-740
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.790	15.659

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in T€	2011	2010
Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres	740	383
Ausbuchung von Forderungen	-3	-27
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-241	-82
Zuführung	50	466
Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende	546	740

(17) SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in T€	2011	2010
Aktivierte Stückzinsen	379	273
Positive Marktwerte aus Devisentermingeschäften	0	150
Förderprojekte	186	144
Lieferantenboni	54	0
Bietungsgarantien	57	0
Sonstiges	80	73
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	756	640

Unter den aktivierten Stückzinsen werden geleistete Vorauszahlungen auf Zinsforderungen aus erworbenen Wertpapieren dargestellt.

(18) WERTPAPIERE

Die SÜSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Teil ihrer Liquidität in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere investiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Zum Bilanzstichtag verfügte die Gesellschaft über Wertpapiere in Höhe von T€ 19.362 (2010: T€ 15.977).

(19) STEUERERSTATTUNGSANSPRÜCHE

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von T€ 87 (2010: T€ 108) in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 4,37% p.a. zugrunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuerforderungen bestehen aus geleisteten Steuervorauszahlungen in Höhe von T€ 686 (2010: T€ 620).

(20) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in T€	2011	2010
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.055	837
Geleistete Anzahlungen	671	404
Umsatzsteuer	379	1.272
Kautionen	30	187
Forderungen aus Förderprojekten	213	365
Sonstiges	445	331
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	2.793	3.396

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, zum Beispiel Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PASSIVA

(21) EIGENKAPITAL

GEZEICHNETES KAPITAL

Aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 wurden im Geschäftsjahr insgesamt 379.990 Bezugsrechte ausgeübt.

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG wurde von 18.721.038,00 € (eingeteilt in 18.721.038 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €) um einen Betrag von 379,990,00 € erhöht und betrug zum Bilanzstichtag 19.101.028,00 €. Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung.

Jede Stückaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stückaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag T€ 9.053 (2010: T€ 2.553).

Am 31. Dezember 2011 verfügt die Gesellschaft über ein bedingtes Kapital in Höhe von insgesamt T€ 1.270 (2010: T€ 1.695). Es ist für die Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- bzw. Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte des Konzerns vorgesehen. Dabei sind T€ 750 dem Aktienoptionsplan 2005 und T€ 520 dem Aktienoptionsplan 2008 zuzuordnen.

in T€	2011	2010
Grundkapital	19.101	18.721
genehmigtes Kapital	9.053	2.553
bedingtes Kapital	1.270	1.695

RÜCKLAGEN

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Kapitalrücklage	98.384	98.225
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzgewinn (Vj. Bilanzverlust)	2.799	-10.714
Rücklagen	101.616	87.944

Der Kapitalrücklage wurden aus der Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen der bestehenden Aktienoptionspläne T€ 45 (2010: T€ 187) ergebniswirksam zugeführt. Aus den Ausübungen von Aktienoptionen wurden T€ 114 (2010: T€ 0) der Kapitalrücklage zugeführt.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Der bisherige Bilanzverlust veränderte sich durch das positive Jahresergebnis von T€ 13.513 vor Berücksichtigung von Minderheiten auf einen Bilanzgewinn von T€ 2.799.

KUMULIERTES ÜBRIGES EIGENKAPITAL

Die Entwicklung des Kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in T€	2011	2010
Fremdwährungsanpassungen	-824	-833
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-101	-202
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	307	326
Steuereffekte		
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-98	-91
Absicherung künftiger Zahlungsströme	57	57
Stand zu Beginn der Periode	-659	-743
Veränderungen vor Steuern		
Fremdwährungsanpassungen	-164	262
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-230	101
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-30	-19
Auflösung Other Comprehensive Income „Test“ (Entkonsolidierung)	0	-253
Steuereffekte		
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	8	-7
Absicherung künftiger Zahlungsströme	62	0
Stand am Ende der Periode	-1.013	-659

Die SÜSS MicroTec AG hat im Vorjahr einen Zinsswap als Sicherungsinstrument für das variabel verzinsliche Darlehen, das der Finanzierung des neu erworbenen Grundstücks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Für diesen Zinsswap wurde Hedge Accounting angewendet: Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Marktwertänderungen im Kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Eigenkapitalmanagement

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr aus dem operativen Geschäft einen positiven Cashflow zu erwirtschaften. Unabhängig davon besteht bei einer Verfehlung der Planung die Gefahr, dass sich das Eigenkapital in Folge eines Jahresfehlbetrags verringern könnte.

AKTIONSOPTIONSPÄNE DER SÜSS MICROTEC AG

Aktienoptionsplan 2005

In der Hauptversammlung vom 21. Juni 2005 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 750 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 750.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- ▶▶ der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDAX entwickelt hat

oder

- ▶▶ der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Die Bezugsrechte erlöschen bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses innerhalb der Wartefrist bzw. am Ende der Laufzeit. Die Laufzeit der Aktienoptionen beginnt mit dem Ausgabetag und endet nach Ablauf von fünf Jahren.

Aktienoptionsplan 2008

In der Hauptversammlung vom 19. Juni 2008 wurde der Beschluss gefasst, das Grundkapital um bis zu T€ 900 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 900.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstands- und Geschäftsführungsmitglieder und weitere Führungskräfte der Konzerngesellschaften zu erhöhen. Der Bezugspreis für die Aktien entspricht dem Marktwert am Gewährungsstichtag. Die Bezugsrechte können erst nach Ablauf einer Wartefrist von rund zwei Jahren ausgeübt werden.

Die Bezugsrechte können nur von den Berechtigten ausgeübt werden, wenn entweder

- ▶▶ der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,625 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist und der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie sich prozentual gleich oder besser als der TecDAX entwickelt hat

oder

- ▶▶ der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie im Zeitraum zwischen Ausgabetag und erstem Tag des Ausübungszeitraums, in dem die Aktienoption ausgeübt wird, um mindestens 0,8333 % pro vollem Kalendermonat gestiegen ist.

Zusätzlich zu diesen Erfolgszielen muss der Börsenkurs der SÜSS MicroTec-Aktie für die Ausübungszeiträume, die innerhalb der ersten 36 Monate der Laufzeit der Aktienoptionen liegen, während der Laufzeit bis zum ersten Tag des Ausübungszeitraums mindestens einmal bei € 5,00, für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 37. Monat bis zum 48. Monat liegen, mindestens einmal während der Laufzeit bei € 5,75 und für Ausübungszeiträume, die zwischen dem 49. Monat und 60. Monat mindestens einmal während der Laufzeit bei € 6,60 gelegen haben.

Im Geschäftsjahr wurde eine erfolgswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage in Höhe von T€ 45 (2010: T€ 187) für diese Pläne vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden wie im Vorjahr keine Bezugsrechte ausgegeben.

Am 31. Dezember 2011 bestanden noch insgesamt 461.750 begebare Bezugsrechte (2010: 461.750 begebare Bezugsrechte).

Die von der Gesellschaft gewährten Bezugsrechte zum Aktienwerb haben sich wie folgt entwickelt:

	Anzahl	gewichteter durchschnittlicher Bezugspreis in €
01.01.08	668.950	7,26
gewährt 2008	0	0,00
ausgeübt 2008	0	0,00
verfallen 2008	81.300	7,30
31.12.08	587.650	7,26
gewährt 2009	438.250	1,30
ausgeübt 2009	0	0,00
verfallen 2009	170.700	7,04
31.12.09	855.200	4,25
gewährt 2010	0	0,00
ausgeübt 2010	0	0,00
verfallen 2010	158.400	4,59
31.12.10	696.800	4,18
gewährt 2011	0	0,00
ausgeübt 2011	379.990	1,30
verfallen 2011	115.500	7,21
31.12.11	201.310	7,88
noch begebbar	461.750	

Nachfolgende Tabelle fasst die Informationen hinsichtlich aller durch die Gesellschaft ausgegebenen Bezugsrechte nochmals zusammen:

Bereich des Bezugspreises	Anzahl Bezugsrechte	gewichteter durchschnittl. Bezugspreis in €	gewichtete durchschnittl. Restlaufzeit in Monaten
unter EUR 2,50	14.510	1,30	28
EUR 2,50 – EUR 4,99	0,00	0,00	0
EUR 5,00 – EUR 7,49	0,00	0,00	0
EUR 7,50 – EUR 9,99	186.800	8,39	5
	201.310	7,88	7

(22) PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich i.d.R. auf Basis der Gehälter der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Inländische Verpflichtungen	1.683	1.823
Ausländische Verpflichtungen	1.189	1.096
Gesamt	2.872	2.919

LEISTUNGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED BENEFIT PLANS“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2011	2010
Abzinsungsfaktor	4,83 % – 5,16 %	4,50 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	5,80 %	3,90 % – 5,20 %
Gehaltssteigerung	0,00 %	0,00 %
Rentensteigerung	2,00 %	2,00 %
Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G		

Beim Gehalt wurden nur in der Schweiz Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80 % eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

	2011	2010
Abzinsungsfaktor	2,50 %	2,75 %
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	2,50 %	2,75 %
Gehaltssteigerung	1,50 %	1,50 %
Rentensteigerung	0,25 %	0,50 %

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und die Marktwerte des Fondsvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2011 und 2010 wie folgt entwickelt:

in T€	2011	2010
Anwartschaftsbarwert am 1.1.	5.610	5.014
Dienstzeitaufwand	272	283
Zinsaufwand	207	209
Pensionszahlungen	-387	-819
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust	-417	573
Währungsveränderungen	120	350
Anwartschaftsbarwert am 31.12.	5.405	5.610

in T€	2011	2010
Planvermögen am 1.1.	1.913	1.645
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	84	76
Geleistete Fondsdotierungen	20	-65
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn / (-) Verlust	-141	179
Währungsveränderungen	25	78
Planvermögen am 31.12.	1.901	1.913

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

in T€	2011	2010
Barwert der Pensionsverpflichtungen	5.405	5.610
Zeitwert des Planvermögens	-1.901	-1.913
Errechnete Pensionsverbindlichkeit	3.504	3.697
Nicht realisierte versicherungsmathematische (+) Gewinne und (-) Verluste	-632	-778
Rückstellung	2.872	2.919

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von T€ 3.401 (2010: T€ 3.538) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in T€	2011	2010
Dienstzeitaufwand	189	339
Personalaufwandskomponente	189	339
Zinsaufwand	207	209
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-84	-76
Zinsaufwandskomponente	123	133

Die Personalaufwandskomponente des Geschäftsjahres entfällt in Höhe von T€ 133 (2010: T€ 201) auf die Verwaltungskosten und in Höhe von T€ 56 (2010: T€ 138) auf die Vertriebskosten.

Die Entwicklung des Anwartschaftsbarwerts und des Planvermögens zeigt folgende Tabelle:

in T€	2011	2010	2009	2008	2007
Anwartschaftsbarwert	5.405	5.610	5.014	4.819	4.174
Planvermögen	1.901	1.913	1.645	1.664	1.640
Deckungsstatus	3.504	3.697	3.369	3.155	2.534

Erfahrungsbedingte Anpassungen gem. IAS 19.120 A(p) waren im Betrachtungszeitraum nicht notwendig.

BEITRAGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED CONTRIBUTION PLANS“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA, die 21 Jahre oder älter sind und die ein Minimum von 1.000 Stunden pro Jahr arbeiten, einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Der Plan beinhaltet zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge werden jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag USD 0,50 für jeden USD 1,00 des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von USD 2.000 (d.h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt USD 1.000). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Im Geschäftsjahr 2011 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den 401 (k) Plan TUSD 141 (2010: TUSD 148).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von T€ 2.324 (2010: T€ 2.227) abgeführt.

(23) (LANGFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2011	Verbrauch	Zuführung	Stand 31.12.2011
Altersteilzeit	508	-200	40	348

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Altersteilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der Süss MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebensjahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei Jahre eine Vollzeitbeschäftigung / Teilzeitbeschäftigung ausgeübt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regelarbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Altersteilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird (Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist, dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 % des monatlichen Vollzeitnettoarbeitsentgelts beträgt. Der Aufstockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

(24) FINANZSCHULDEN

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen sowie der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum 31. Dezember 2011 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31. Dezember 2011	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	182	720	3.420	4.322
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	8.984	0	0	8.984
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	965	139	0	1.104
Gesamt	10.131	859	3.420	14.410

31. Dezember 2010	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	203	720	3.600	4.523
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	0	8.964	0	8.964
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	916	1.083	0	1.999
Gesamt	1.119	10.767	3.600	15.486

VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Verbindlichkeiten aus einem langfristigen Darlehensvertrag in Höhe von 4.320 € (2010: 4.500 €), der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks Sternenfels dient. Der Darlehensvertrag wurde am 25./28. Mai 2010 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen belief sich auf 4,5 Mio. € und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde am 6. Juli 2010 valuiert und zur Auszahlung gebracht.

Im einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

KONZERNGESELLSCHAFT

in T€	2011	2010	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	4.320	4.500	3,98%	30.6.2020
Suss MicroTec Precision Photomask Inc.	0	23	9,27%	26.3.2011
Gesamt	4.320	4.523		
...davon kurzfristig fällig	180	203		
...davon langfristig fällig	4.140	4.320		
... fällig 2012	180			
2013	180			
2014	180			
2015	180			
2016	180			
...später	3.420			
	4.320			

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2011	2010
Kreditlinie	13.700	9.700
Inanspruchnahme	2.894	5.649
Verfügbare Kreditlinie	10.806	4.051

Die von dem Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB bereitgestellte Kreditlinie in Höhe von 6 Mio. € lief bis zum 31. März 2011. Mit dem Kreditvertrag vom 30./31. März 2011 wurden neue Kreditverträge mit dem bisherigen Bankenkonsortium abgeschlossen. Mit den neuen Kreditverträgen wurde die Kreditlinie auf insgesamt 8 Mio. € erhöht. Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit bis zum 31. März 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Mit Vertrag vom 1. April / 5. April 2011 haben die SÜSS MicroTec AG und die SÜSS MicroTec Lithography GmbH mit der DZ BANK AG einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 2 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft bis zum 31. März 2012 und wurde ohne Covenants gestellt. Sie dient in erster Linie der Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften.

Für 2012 ist geplant, Kreditverträge mit einem auf drei Banken ausgelegten Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB abzuschließen, um die für die Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften notwendigen Kreditlinien auch weiterhin zur Verfügung zu haben. Die Verhandlungen sind bereits weit fortgeschritten. Die neuen Verträge werden voraussichtlich Ende März 2012 abgeschlossen werden.

Im Mai 2010 hat die HamaTech APE GmbH & Co. KG mit der BW Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die HamaTech APE GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherung besteht eine weitere Kreditlinie zur Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften in Höhe von 2,5 Mio. €.

Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Höhe von 2.894 € (Vorjahr: 5.649 €) in Form von Avalen genutzt.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien betrug 1,2 % (2010: 1,1 %).

VERBINDLICHKEITEN AUS SCHULDSCHEINDARLEHEN

Die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen betreffen ausschließlich die SÜSS MicroTec AG und setzen sich wie folgt zusammen:

KONZERNGESELLSCHAFT

in T€	2011	2010	Zinssatz	Fälligkeit
SÜSS MicroTec AG	2.995	2.988	6,00 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.995	2.988	6,17 %	18.12.2012
SÜSS MicroTec AG	2.994	2.988	6,06 %	21.12.2012
Gesamt	8.984	8.964		
...davon kurzfristig fällig	8.984	0		
...davon langfristig fällig	0	8.964		
... fällig 2012	8.984			
2013	0			
2014	0			
2015	0			
2016	0			
...später	0			
	8.984			

VERBINDLICHKEITEN AUS FINANCE LEASE

Die Gesellschaft least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- wie auch im Verwaltungsbereich unter Operating Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Software, Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance Lease-Verträge, deren zugrundeliegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in T€	Finance Lease	Operating Lease	davon Operating Lease mit nahestehenden Personen
Abschreibungen / Aufwendungen 2011	948	2.370	0
Abschreibungen / Aufwendungen 2010	945	2.286	0
Künftige Verpflichtungen ... fällig 2012	985	2.011	0
2013	109	1.689	0
2014	14	298	0
2015	9	196	0
2016	0	8	0
... später	0	0	0
Gesamt zukünftig	1.117	4.202	0
Zinsanteil	13		
Verbindlichkeit 31.12.2011	1.104		
... davon kurzfristig	965		
... davon langfristig	139		

(25) (KURZFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Garantierückstellungen	2.085	1.941
Restrukturierung	54	1.457
Übrige Rückstellungen	1.183	1.215
Kurzfristige Rückstellungen	3.322	4.613

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verlagerung des im US-amerikanischen Waterbury (Vermont) ansässigen Geschäftsbereichs Substrat Bonder nach Deutschland wurde im April 2011 abgeschlossen. Im Zuge der Umstrukturierung wurden die Funktionsbereiche Forschung und Entwicklung, Produktion sowie das Produktmanagement der Bonder-Produktlinien an den Standort Sternenfels verlegt. Die nordamerikanische Service- und Vertriebsorganisation sowie das Applikationscenter wurden von Waterbury ins „Silicon Valley“, Kalifornien, verlagert.

Die Aufwendungen der Umstrukturierung beliefen sich auf insgesamt rund 5,3 Mio. €, von denen 3,9 Mio. € bereits im Vorjahr erfasst wurden. Im August 2011 wurde der Standort Waterbury endgültig geschlossen und das angemietete Gebäude an den Vermieter zurückgegeben. Zum Ende des dritten Quartals 2011 ist für SÜSS MicroTec das Projekt „Umstrukturierung USA“ abgeschlossen. Weitere Aufwendungen werden nicht erwartet. Die Restrukturierungsrückstellung beläuft sich zum 31. Dezember 2011 auf T€ 54.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	Stand 01.01.2011	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2011
Garantierückstellungen	1.941	-1.916	0	2.060	2.085
Restrukturierung	1.457	-1.403	0	0	54
Übrige Rückstellungen	1.215	-957	0	925	1.183
Kurzfristige Rückstellungen	4.613	-4.276	0	2.985	3.322

(26) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2011	2010
Prämien und Provisionen	2.943	2.781
Fremdleistungen	1.794	2.392
Aufsichtsratsvergütung	152	161
Negative Marktwerte aus Devisentermingeschäften	148	111
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	478	390
Sonstiges	480	623
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	5.995	6.458

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte aus den Devisentermingeschäften und Zinsderivaten aus. Weitere Einzelheiten zu den Devisentermingeschäften und Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer 29 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

(27) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in T€	2011	2010
Erhaltene Anzahlungen	18.446	23.580
Abgegrenzte Personalkosten	3.621	2.795
Passive Rechnungsabgrenzung	1.444	480
Umsatzsteuer	0	53
Sonstiges	578	125
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	24.089	27.033

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

(28) STEUERSCHULDEN

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 5.344 (2010: T€ 4.917) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von T€ 390 (2010: T€ 495).

SONSTIGE ANGABEN

(29) ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER FINANZINSTRUMENTE

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen als auch Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in T€	2011	2010
Finanzielle Vermögenswerte		
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	19.362	15.977
Kredite und Forderungen	18.546	16.149
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	0	150
	37.908	32.276
Finanzielle Verbindlichkeiten		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	627	501
Finanzielle Verbindlichkeiten	27.371	31.189
	27.998	31.690

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

in T€	2011		2010	
	Buchwert	Marktwert	Buchwert	Marktwert
Finanzielle Vermögenswerte				
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	37.036	37.036	36.525	36.525
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.790	17.790	15.659	15.659
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	756	756	640	640
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	756	756	490	490
bewertet zum Marktwert	0	0	150	150
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	19.362	19.362	15.977	15.977
Finanzielle Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.582	7.582	9.746	9.746
Finanzschulden	14.410	15.251	15.486	16.527
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.322	4.713	4.523	4.691
Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen	8.984	9.415	8.964	9.810
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	1.104	1.123	1.999	2.026
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	5.995	5.995	6.458	6.458
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	5.368	5.368	5.957	5.957
bewertet zum Marktwert	627	627	501	501

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

Forderungen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

Sonstige finanzielle Vermögenswerte / Verbindlichkeiten: Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

Wertpapiere: Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen: Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Verbindlichkeiten aus Finance Lease: Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2011	2010
Kredite und Forderungen	196	-342
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	-276	65
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	-154	-31

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Nettogewinne bzw. -verluste aus zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten enthalten Marktwertveränderungen der derivativen Finanzinstrumente.

Im Berichtsjahr wurde die während der Laufzeit im Kumulierten übrigen Eigenkapital – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – erfasste Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von T€ -63 (2010: T€ -31) infolge der Endfälligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

Derivative Finanzinstrumente

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in T€	2011		2010	
	positiver Marktwert	negativer Marktwert	positiver Marktwert	negativer Marktwert
Devisentermingeschäfte	0	148	150	111
Zinsswaps	0	478	0	390

Konzerninterne Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den Tochtergesellschaften. Dies betrifft vor allem die Konzerngesellschaften in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von Schwestergesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. Sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinsniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten, wie Zinsswaps, zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Teil des 2007 begebenen Schuldscheindarlehens mit laufzeitkongruenten Swap-Kontrakten gesichert. Auch das 2010 aufgenommene Darlehen, das der Finanzierung des Grundstücks Sternenfels dient und einen variablen Zins aufweist, wurde mit einem laufzeitkongruenten Swap gesichert. Die Zinsswaps gleichen die Auswirkung zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlagen aus. Um die Marktwertschwankungen des Zinsswaps für das Grundstücksdarlehen im kumulierten übrigen Eigenkapital abzubilden, hat die Gesellschaft für diesen Zinsswap Hedge Accounting angewendet. Die Marktwertschwankungen der Zinsswaps für den variablen Teil des Schuldscheindarlehens wurden in den Zinserträgen bzw. -aufwendungen erfasst.

(30) NAHESTEHENDE PERSONEN

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20 % oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Im Geschäftsjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen“ – mit Ausnahme der Angaben zur Vergütung der Organe – nicht berührt.

(31) FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Bestellobligo	24.493	17.171
Mietverpflichtungen	4.003	4.677
Summe	28.496	21.848

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

(32) ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG

In der Konzern-Kapitalflussrechnung des SÜSS MicroTec-Konzerns wird entsprechend IAS 7 („Cashflow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Betrag von T€ 350 (2010: T€ 350) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von T€ -594 (2010: T€ -2.854) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte.

Der Erwerb der HamaTech APE wurde im Vorjahr zusammen mit dem Erwerb des Grundstückes Sternenfels als Investition im Cashflow aus Investitionstätigkeit dargestellt. Der im Vorjahr erfolgte Verkauf des Bereichs Test Systeme wurde als Desinvestition im Cashflow aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Durch den Verkauf und die Entkonsolidierung der Süss MicroTec Test Systems GmbH sind im Vorjahr (am 27.01.2010) Zahlungsmittel dieser Gesellschaft in Höhe von T€ 2.834 aus dem Konzern abgeflossen. Mit dem Erwerb und der Erstkonsolidierung der HamaTech APE GmbH & Co. KG und der HamaTech Beteiligungs GmbH hat der Konzern im Vorjahr (am 15. Februar 2010) Zahlungsmittel dieser Gesellschaften in Höhe von T€ 220 übernommen.

(33) SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien und nach Regionen abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung sowie Berichterstattung und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden in die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment aufgeteilt. Zusammen mit dem Segment Sonstige werden diese Aktivitäten in der Segmentberichterstattung unter den fortgeführten Aktivitäten ausgewiesen. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt. Unter den nicht fortgeführten Aktivitäten wird das Segment Test Systeme ausgewiesen.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS MicroTec-Konzern die Produktlinien Mask Aligner und Coater. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für dieses Segment tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Mikrosystemtechnik, Verbindungshalbleiter und Advanced Packaging vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind seit März 2011 in Sternenfels bei Stuttgart konzentriert. Im Vorjahr war dieser Geschäftszweig mit Produktion, Entwicklung und Vertrieb noch in Waterbury, Vermont, in den USA angesiedelt. Das Unternehmen hat diesen Geschäftszweig Anfang des Jahres 2011 komplett nach Deutschland (Sternenfels) verlagert und den Standort Waterbury geschlossen. Der Vertrieb für das Segment Substrat Bonder ist über Sternenfels hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa, in den USA und in Asien ansässig. In diesem Segment bildet der XBC300, ein Produktions-Bonder für bis zu 300 mm Wafer, die Ausgangsplattform für die drei wichtigsten Bondtechniken im Bereich der 3D-Integration (einer unserer Zukunftsmärkte): das temporäre und permanente Bonden sowie das Debonden. Zu den Schlüsseltechnologien, die die 3D-Integration erfordert, zählen darüber hinaus das Dünnen von Wafern sowie die weitere Handhabung dieser äußerst fragilen Substrate („Thin Wafer Handling“). Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten.

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMx, ASx, MaskTrack und MaskTrack Pro der am 15. Februar 2010 akquirierten HamaTech APE GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels angesiedelt.

Das in Sacka bei Dresden angesiedelte Segment Test Systeme ist am 27. Januar 2010 verkauft worden. Die im Berichtsjahr noch vereinzelt angefallenen Geschäftsvorfälle werden in der Segmentberichterstattung als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen. Das Segment Test Systeme umfasste die Entwicklung, Produktion sowie den Vertrieb in Europa von Test-Equipment. Die Test Systeme sind im Wesentlichen für Laboranwendungen, insbesondere z.B. für die Fehleranalyse, aber auch teilweise für Anwendungen im Produktionsumfeld (Mikrosystemtechnik, LED-Testsysteme) bestimmt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Maskenbereich, im Bereich Mikrooptik sowie im Bereich C4NP gezeigt.

SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN ZUR SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. In Folge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung die Angabe eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich.

Im Geschäftsjahr erzielte SÜSS MicroTec mit einem Kunden Umsätze, die einen Anteil von 11,2% am Gesamtumsatz ausmachten. Diese Umsätze betrafen die Segmente Fotomasken Equipment sowie Lithografie. Im Vorjahr lagen sämtliche Umsätze mit einzelnen Kunden unter einem Anteil von 10%.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch der Personalaufwand aus den Aktienoptionsplänen sowie die Auflösung von Rückstellungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inkl. Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Für die geografische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. Eine Erhebung dieser Information für das Inland ist nicht Gegenstand des Konzernreportings. Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt.

(34) VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

VORSTAND DER KONZERNBERGEGESellschaft

Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec AG im Jahr 2011 waren:

Frank Averdung	Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender
Zuständigkeitsbereiche	Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Investor Relations, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie
Michael Knopp	Diplom-Kaufmann, Ratingen, Mitglied des Vorstands
Zuständigkeitsbereiche:	Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Materialwirtschaft, Logistik, Facility Management

Die Bezüge des Vorstandes enthalten fixe und variable Bestandteile. Als fixe Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder monatliche Gehaltszahlungen, Zuschüsse zur Sozialversicherung sowie einen Firmenwagen mit privater Nutzungsmöglichkeit.

Als variable Vergütung erhalten die Vorstandsmitglieder einen Jahresbonus, der sich an individuell festgelegten Zielen orientiert.

Die gesamte Barvergütung des Vorstands betrug im Geschäftsjahr T€ 657. Neben dem bezogenen Fixgehalt (einschließlich der Zuschüsse zur Sozialversicherung und dem geldwerten Vorteil aus der privaten Nutzung des Firmenfahrzeugs) wurden Herrn Averdung T€ 190 und Herrn Knopp T€ 152 aus der zum Vorjahresstichtag gebildeten Rückstellung für den variablen Gehaltsbestandteil ausbezahlt.

Für den Jahresbonus 2011 von Herrn Averdung und Herrn Knopp wurde im Geschäftsjahr eine Rückstellung von T€ 151 gebildet.

Diese Vergütungen teilen sich wie folgt auf die einzelnen Vorstandsmitglieder auf:

2011 in T€	Frank Averdung	Michael Knopp
Barvergütung		
Fixum	272	234
Erfolgsbezogen	82	69
Summe	354	303

2010 in T€	Frank Averdung	Michael Knopp
Barvergütung		
Fixum	267	223
Erfolgsbezogen	188	150
Summe	455	373

Weiterhin wurden aufgrund der an Vorstände gewährten Optionen T€ 16 (2010: T€ 64) als Personalaufwand in der Holding erfasst.

Für ein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft besteht eine Pensionsrückstellung von T€ 7 (2010: T€ 7).

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr 2011:

Dr. Stefan Reineck Kirchartd, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender

weitere Mandate: AttoCube Systems AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
 NanoScape AG, München (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
 Bosch Solar CISTech GmbH, Brandenburg an der Havel (Mitglied im Beirat)
 Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im Board of Directors)
 Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)

Jan Teichert Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats

weitere Mandate: keine

Gerhard Pegam Au bei Bad Aibling, Vorstandsvorsitzender der EPCOS AG, München (bis 31.01.2012, im Aufsichtsrat seit 21. Juni 2011)

Weitere Mandate: TDK-EPC Corporation, Tokio, Japan (Mitglied des Board of Directors, bis 31.01.2012)
 OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)
 In folgenden Tochtergesellschaften der EPCOS AG:
 EPCOS (Shanghai) Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
 EPCOS (China) Investment Ltd., Shanghai, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
 EPCOS Limited, Hong Kong, Volksrepublik China (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
 EPCOS Inc., Iselin, New Jersey, USA (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
 Becromal S.p.A., Mailand, Italien (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)
 Becromal Iceland ehf, Akureyri, Island (Vorsitzender des Board of Directors, bis 31.01.2012)

Sebastian Repegather Zürich, Investment Director bei der Fidinam S.A., Lugano, Schweiz (im Aufsichtsrat bis 21. Juni 2011)

weitere Mandate: Sterling Strategic Value Limited, Tortola, British Virgin Islands (Mitglied im Board of Directors)
 International Equity Development S.L., Barcelona, Spanien (Mitglied der Geschäftsführung)

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält außer dem Ersatz seiner ihm bei Wahrnehmung seines Amtes entstandenen Auslagen eine feste Vergütung pro Geschäftsjahr. Gemäß der Satzungsänderung vom 23. Juni 2010 erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats € 45.000 p.a., sein Stellvertreter € 40.000 p.a. und jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrats € 35.000 p.a. Gehört ein Mitglied dem Aufsichtsrat nur einen Teil des Geschäftsjahres an, bestimmt sich die Vergütung pro rata temporis. Darüber hinaus erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von € 1.500 für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse.

Im Einzelnen setzen sich die Aufsichtsratsvergütungen für das abgelaufene Geschäftsjahr wie folgt zusammen:

2011 in €	Zeitraum der Zugehörigkeit	2011			Gesamt
		Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz	
Dr. Stefan Reineck	ganzjährig	45.000,00	10.500,00	7.352,44	62.852,44
Gerhard Pegam	seit 21.06.2011	17.500,00	4.500,00	83,00	22.083,00
Sebastian Repegather	bis 21.06.2011	17.500,00	6.000,00	5.292,66	28.792,66
Jan Teichert	ganzjährig	40.000,00	10.500,00	295,65	50.795,65

Im Vorjahr setzten sich die Aufsichtsratsvergütungen wie folgt zusammen:

2010 in €	Zeitraum der Zugehörigkeit	2010			Gesamt
		Feste Vergütung	Sitzungsgeld	Auslagenersatz	
Sebastian Repegather	ganzjährig	35.000,00	13.500,00	4.910,76	53.410,76
Dr. Stefan Reineck	ganzjährig	45.000,00	13.500,00	6.756,14	65.256,14
Jan Teichert	ganzjährig	40.000,00	13.500,00	201,75	53.701,75

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

	2011		2010	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Michael Knopp	35.000	41.400	37.500	97.500
Frank Averdung	82.000	0	42.500	67.500
Dr. Stefan Reineck	9.600	40.000	9.600	40.000

(35) MITARBEITER

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 631 Mitarbeiter (2010: 591 Mitarbeiter) in der SÜSS MicroTec-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2011	2010
Verwaltung	68	74
Marketing und Vertrieb	256	234
Produktion und Technik	300	308
Summe	624	616

(36) HONORARE DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Das im Geschäftsjahr für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, erfasste Honorar nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB beträgt T€ 306 (2010: T€ 320) und setzt sich wie folgt zusammen:

in T€	2011	2010
Abschlussprüfung	286	284
Steuerberatung	20	36
Sonstige Leistungen	0	0
Gesamt	306	320

Die Position Abschlussprüfung enthält das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften. Im Vorjahresbetrag ist außerdem das Honorar für die Unterstützung bei der Anfang 2010 durchgeführten Prüfung durch die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung enthalten.

Für 2011 wird lediglich das Honorar an die rechtlich selbstständige Einheit des Abschlussprüfers angegeben. Im Vorjahr war darüber hinaus das Honorar für ein weiteres Unternehmen des KPMG-Verbundes enthalten.

Das Honorar für Steuerberatung betrifft die steuerliche Beratung der SÜSS MicroTec AG in ausgewählten steuerlichen Einzelfragen sowie die laufende steuerliche Beratung der HamaTech APE GmbH & Co. KG.

(37) CORPORATE GOVERNANCE

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Juli 2011 die Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 26. Mai 2010 mit fünf Ausnahmen – Einladung zur Hauptversammlung / Stimmrechtsvertreter, Briefwahl / Stimmrechtsvertreter, Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, Bildung von Ausschüssen und Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern – entsprochen haben und entsprechen werden.

Die Entsprechenserklärung wurde im Internet unter www.suss.com dauerhaft zugänglich gemacht.

(38) ANGABE GEMÄSS § 160 NR. 8 AKTG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die SÜSSvest SCS, Strassen, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13. Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte).

Die Stichting Vest, Amsterdam, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13. Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Stichting Vest 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die Crest Capital S.A., Strassen, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 WpHG am 13. Januar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. Januar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,3078 % beträgt (432.049 Stimmrechte). Davon sind der Crest Capital S.A. 2,3078 % (432.049 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 1. Februar 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 1. Februar 2011 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,94 % beträgt (550.000 Stimmrechte).

Die Credit Suisse Fund Management S.A, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. März 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. Februar 2011 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,35 % beträgt (627.435 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,99 % (185.380 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die Capital Group International, Inc., Los Angeles, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 7. März 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. März 2003 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,85 % beträgt (724.695 Stimmrechte). 4,85 % (724.695 Stimmrechte) sind ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 WpHG zuzurechnen.

Die Capital Guardian Trust Company, Los Angeles, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 14. März 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 18. März 2003 die Schwelle von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 4,68 % beträgt (698.495 Stimmrechte). 4,68 % (698.495 Stimmrechte) sind ihr nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG am 25. Oktober 2011 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 24. Oktober 2011 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,08 % beträgt (587.056 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,66 % (507.356 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die Universal Investment Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG am 21 Februar 2012 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 20. Februar 2012 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,54 % beträgt (486.093 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,28 % (436.843 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

(39) FREIGABE DES ABSCHLUSSES

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS Konzernabschluss am 12. März 2012 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 12. März 2012

Der Vorstand



Frank Averdung



Michael Knopp

Versicherung der gesetzlichen Vertreter



Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, 12. März 2012

SÜSS MicroTec AG

Frank Averdung

Michael Knopp

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie ihren Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 12. März 2012

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Renner
Wirtschaftsprüfer

Dr. Rüttler
Wirtschaftsprüfer

Glossar



>> 3D-INTEGRATION

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer-Level-Packaging-Ebene gestapelt werden, ohne durch „Through Silicon Vias“ (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (Systems-on-Chip) sowie weitere Verfahren subsummiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire-Bonding („Drahtbonden“) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch „Through Silicon Vias“ (TSVs) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

>> 300-MM-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben z.B. aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (~42 Prozent) der heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 300mm. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro einzeltem Chip.

>> ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter „Advanced Packaging“ versteht man weiterentwickelte Packagingverfahren, die in der Regel Methoden einsetzen,

die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im „Frontend“ der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

>> BACKEND

„Backend“ bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat („Frontend“), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet. Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundrys) durchführen lassen.

>> BONDEN

Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafers mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte z.B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (Van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nicht lösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

>> BUMP

(engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold o.Ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugelchen auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

>> CHIP

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstelle, mit der der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire- oder Flip-Chip-Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

>> CLUSTER

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z.B. Coater, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

>> COATER (BESCHICHTUNGSGERÄT)

Coater sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

>> COMPOUND SEMICONDUCTOR

Siehe Verbindungshalbleiter

>> COST OF OWNERSHIP (COO)

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die „Cost of Ownership“ der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende CoO ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

>> C4NP

IBM hat in den späten 1960er Jahren den Weg für das Flip-Chip-Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem „IBM System 3“ eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen „IBM C4“ Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. „C4“ steht für „Controlled Collapse Chip Connection“ und wird teilweise auch synonym für Flip-Chip-Bonding verwendet. „C4NP“ ist die Technologie der nächsten Generation, die IBM gemeinsam mit SÜSS MicroTec auf Basis des bewährten C4-Prozesses entwickelt hat. „NP“ steht dabei für New Process.

>> DIE

„Die“, „IC“ (Integrated Circuit) und „Chip“ sind oft synonym verwendete Begriffe. „Die“ heißen die ICs, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies“. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der Dies spricht man von Chips.

>> DRAM

DRAM = Dynamic Random Access Memory. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird. Weltweit am weitesten verbreiteter Speicherchip.

>> FAB

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von ICs auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis zu 4 Milliarden US-Dollar.

>> FLIP-CHIP-BONDING

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d.h. der Chip muss vor der Montage umgedreht werden (engl.: to flip).

>> FOTORESIST

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, sodass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

>> FOUNDRY

Eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre F&E-Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundrys sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

>> FRONTEND

„Frontend“-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das „Backend“ an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

>> HALBLEITER

Einkristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch ICs aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

>> IC

Integrated Circuit. Ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Mikrochips geführt.

>> LED

Light Emitting Diode. Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LEDs leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnmal so lange Lebensdauer als eine normale Glühbirne.

>> LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der ICs werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichtenaufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresists, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Größenordnung von 32 Nanometer (0,032 Mikrometer) bis 0,6 Mikrometer. Im Backend werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip-Chip-Bonding herzustellen.

>> MASK ALIGNER (BELICHTUNGSGERÄT)

Mask Aligner richten eine Glasmaske submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmaske wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

>> Maske

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines ICs benötigt werden. Die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

>> MEMS

Micro Electro Mechanical System. MEMS ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

>> MIKROMETER / MIKRON

Metrisches Längenmaß. Symbol: μm . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60 μm .

>> MIKROSYSTEM

Ein System das aus verschiedenen Bauteilen zusammengesetzt ist, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen.

>> MIKROSYSTEMTECHNIK

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Mikro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder komplexer Systeme wie einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z.B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, der zum Auslösen des Airbags eingesetzt wird, oder die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

>> NANOIMPRINTING / NANO IMPRINT-LITHOGRAFIE (NIL)

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

>> NANOTECHNOLOGIE

(griech.: nānos = Zwerg) ist ein Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehrere hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter (10^{-9} m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometerbereich zu schaffen.

>> OPTOELEKTRONIK

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III/V-Materialien wie z.B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (Faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LEDs wegen ihrer vielen Vorteile wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer auch zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

>> PACKAGING FOUNDRIES

Siehe Backend

>> SENSOR

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung. Diese Größe wird in ein elektrisches Signal umgewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

>> SILIZIUM

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften. Halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

>> SUBSTRAT BONDER (VERBINDUNGSGERÄT)

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Löten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können unsere Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker etc. funktionieren.

>> SYSTEMS-ON-CHIP

Hochkomplexe ICs, die viele verschiedene Funktionen enthalten. Bis vor kurzem musste man diese noch auf mehreren ICs unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von ICs mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige erforderlich sind oder ein einzelner ausreicht und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem stetig günstiger werden sollen, verleiht Systems-on-Chips zunehmend größere Wichtigkeit.

>> THROUGH-SILICON-VIAS (TSV)

Bei der „Through-Silicon-Via“-Technik werden die einzelnen Chipkomponenten übereinander gestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen („Through-Silicon-Via“) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten und lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon-Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

>> TOOL

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw. unter Tools versteht man alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zur einer Produktionslinie kombiniert werden.

>> VERBINDUNGSHALBLEITER

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.). Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell, können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

>> WAFER

Runde Scheiben z.B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid etc.), auf denen Chips produziert werden. In den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300mm vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30 Prozent niedriger.

>> WIRE-BONDING

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden.

>> YIELD

Die Ausbeute – eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

Finanzkalender 2012



Geschäftsbericht 2011	30. März
Quartalsbericht 2012	8. Mai
Hauptversammlung, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München	20. Juni
Halbjahresfinanzbericht 2012	7. August
Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt / Main	12.-14. November
Neunmonatsbericht 2012	8. November

Highlights 2011



JANUAR

ZUSAMMENARBEIT MIT DER CORNELL UNIVERSITY IM BEREICH NANOFORSCHUNG

SÜSS MicroTec hat im Januar 2011 die strategische Zusammenarbeit mit der NanoScale Science & Technology-Fakultät (CNF) der nordamerikanischen Cornell-Universität bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden Cornell-Mitarbeiter an bereits existierenden und neuen Lithografiesystemen von SÜSS MicroTec, darunter innovative Aufrüstsätze für Mask Aligner sowie ein Sprühbelacker der Gamma-Serie, Forschungsarbeiten durchführen.

MÄRZ

SÜSS MICROTEC PRÄSENTIERT SICH AUF DER SEMICON CHINA

Vom 15. bis 17. März 2011 fand die Semicon China im Shanghai New International Expo Center statt. Auf dem 18 Quadratmeter großen Messestand hat SÜSS China sich internationalen Kunden und Geschäftspartnern präsentiert.

In diesem Jahr legte SÜSS China den Schwerpunkt auf die stark wachsenden Märkte MEMS, Advanced Packaging und LED. Der Messestand wurde insgesamt von rund 400 Gästen besucht, was die Messe zu einem großen Erfolg machte.

RÜCKKEHR IN DEN TECDAX

Die Aktien der SÜSS MicroTec AG werden seit dem 21. März 2011 wieder im TecDAX, dem Technologieindex, der Deutschen Börse, gehandelt. Der TecDAX umfasst die 30 größten Technologieunternehmen, die den im Standardwertindex DAX gelisteten Werten nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz nachfolgen. Durch die Mitgliedschaft im TecDAX gewinnt die SÜSS MicroTec-Aktie an Attraktivität und dürfte insbesondere bei den internationalen Investoren wieder deutlich mehr Aufmerksamkeit erfahren.

APRIL

ABSCHLUSS DER VERLAGERUNG DES GESCHÄFTSBEREICHS WAFER BONDER

Zu Beginn des zweiten Quartals 2011 konnte die Verlagerung des Geschäftsbereichs Substrat Bonder von Waterbury, USA, nach Sternenfels, Deutschland, erfolgreich abgeschlossen werden. Ziel der Zusammenlegung der Produktlinien Substrat Bonder, Coater/Developer und Fotomaschinen Equipment war die Hebung von Synergien im Bereich Forschung und Entwicklung, der Fertigung und im Einkauf sowie eine generelle Vereinfachung der Unternehmensstruktur. Darüber hinaus wurde auch der Umzug der nordamerikanischen Service- und Vertriebsorganisation sowie des Applikationscenters von Waterbury in das Silicon Valley in Kalifornien abgeschlossen.

JUNI

HAUPTVERSAMMLUNG 2011

Unsere Aktionäre haben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen gegeben, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der ordentlichen Hauptversammlung am 21. Juni 2011 präsentierten. Insgesamt sind in diesem Jahr mehr als 100 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt. Es waren rund 23 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend.



JULI

SÜSS MICROTEC PRÄSENTIERT SICH AUF DER SEMICON WEST IN SAN FRANCISCO

Vom 12. bis 14. Juli 2011 fand die Semicon West in San Francisco statt. Unter dem bekannten Motto „Shrink, Stack, Integrate“ hat sich SÜSS MicroTec auf dieser bedeutenden Halbleitermesse präsentiert. Der Schwerpunkt des Messestands lag auf dem Thema 3D Integration, zu welchem ein Workshop mit verschiedenen Kunden und Partnern veranstaltet wurde. Als Sprecher waren Vertreter vom Forschungsinstitut IMEC und vom SÜSS MicroTec Partnerunternehmen Brewer Science anwesend. SÜSS MicroTec präsentierte neue Maschinen und Prozesse zum temporären Bonden. Darüber hinaus wurde das Thema HB LED auf der Messe weiter beleuchtet.

SÜSS MICROTEC PRÄSENTIERT MASKTRACK PRO INSYNC

Am 13. Juli 2011 präsentierte SÜSS MicroTec den MaskTrack Pro InSync (MTP), ein neuentwickeltes System zur ganzheitlichen, automatisierten Maskenverarbeitung. MTP InSync, das sowohl als eigenständige Anlage als auch als Cluster-Modul angeboten wird, ermöglicht die reibungslose Synchronisierung der Prozessschritte, von der Reinigung über den Transport bis hin zur Inspektion und Lagerung der Maske. MTP InSync erzeugt eine partikelfreie Umgebung und gewährleistet somit höchste Reinheit der Maske beim Einbringen in das Vakuum des EUVL-Scanners. MaskTrack Pro InSync ist das einzige Masken-Management-System am Markt, das die Verwendung der sogenannten EUV Dual Pods in einer vollständig sicheren und gereinigten Atmosphäre ermöglicht. Maskenreinigung, Transport und Lagerung des inneren „Pods“ finden in ultrareinem Umfeld statt. Optional kann eine Partikelerkennung, sowie die Reinigung des inneren Pods integriert werden. Das Konzept des MTP InSync ermöglicht den direkten Transfer des Dual Pods vom Scanner zum Masken-Reinigungssystem.

SEPTEMBER

INTERNATIONALER LIEFERANTENTAG IN STERNENFELS

Im September 2011 fand erstmalig ein SÜSS MicroTec-Lieferantentag in Sternenfels statt. Er stand unter dem Motto Effizienzsteigerungen in der Supply Chain. Ziel dieses Zusammenkommens war das Kennenlernen der Entscheidungsträger auf den verschiedenen Seiten sowie das Knüpfen neuer Kontakte zu Ingenieuren und Konstrukteuren.

OKTOBER

INTERNATIONAL FÜHRENDER IDM ENTSCHEIDET SICH FÜR AUSRÜSTUNG VON SÜSS MICROTEC UND TMAT FÜR DIE 300 MM MASSENFERTIGUNG VON 3D-LOGIK- UND SPEICHER-ANWENDUNGEN

Im Oktober hat SÜSS MicroTec von einem international führenden IDM eine Bestellung für die neueste Generation des Produktions-Bondclusters von SÜSS MicroTec zum Einsatz in der Massenfertigung erhalten. Das Bondersystem wurde für das temporäre Bonden von 300 mm-Wafern für 3D-Integrationsprozesse bei Logik- und Speicheranwendungen unter Verwendung der Materialien von TMAT und für deren Prozess für temporäres Bonden konfiguriert. Die Plattform von SÜSS MicroTec konnte sich gegenüber Konkurrenzangeboten aufgrund ihrer hohen Durchsatzleistung und den daraus resultierenden günstigen Betriebskosten sowie der ausgeklügelten Prozesssteuerung für die Massenproduktion beim temporären Bonden durchsetzen.

VERKAUF DER SUSS MICROTEC PRECISION PHOTOMASK INC.

SÜSS MicroTec hat am 14. Oktober 2011 das Maskengeschäft – die SÜSS MicroTec Precision Photomask Inc. – in Palo Alto, Kalifornien, verkauft. Dieser Schritt unterstützt das Geschäft von SÜSS MicroTec mit Fotomaschinen Equipment, indem mögliche Konkurrenzsituationen mit Kunden ausgeschlossen werden. Mit den Kerngeschäftsfeldern bestanden kaum Synergien, sodass eine Entkonsolidierung ohne Probleme vorgenommen werden konnte.



ANALYSTENTAG IN STERNENFELS

SÜSS MicroTec hatte am 20. Oktober zu einem Analyistentag am Standort Sternenfels geladen. Die Einladung richtete sich an Finanzanalysten, die uns auf der Kapitalmarktseite betreuen und regelmäßig Berichte über SÜSS MicroTec schreiben. Nach einer kurzen Einführung stellte CEO Frank Averdung den Analysten unsere vier Produktlinien vor und antwortete auf die zahlreichen Fragen der Analysten. Im Anschluss daran führte Dr. Arendt die Gruppe, bestehend aus acht Analysten, durch die Fertigung in Sternenfels.

DEZEMBER

SÜSS MICROTEC PRÄSENTIERT XBS300

SÜSS MicroTec hat im Dezember mit der XBS300 die neueste Generation temporärer Bonder für die Massenfertigung in den Markt eingeführt. Dieser Bond Cluster wurde für das temporäre Bonden von 200 mm und 300 mm Wafern in der 3D-Integration entwickelt. Die XBS300 eignet sich auch für weitere Prozesse, die das Handling gedünnter Wafer erfordern. Die XBS300 unterstützt alle derzeit gängigen temporären Bondverfahren. Die Vielseitigkeit der XBS300 ermöglicht Prozesse mit sehr geringen Bondkräften wie dem Thin Materials (TMAT)-Prozess oder dem 3M™ Wafer Support System (WSS). Daneben kann der Bond Cluster auch bei Thermokompressionsverfahren mit höheren Bondkräften, wie beispielsweise dem BrewerScience® ZoneBOND™-Prozess eingesetzt werden. Mit der XBS300, rundet SÜSS MicroTec seine Produktpalette so ab, dass sie perfekt den künftigen Anforderungen der Kunden entspricht.



Impressum & Kontakt



IMPRESSUM

Herausgeber	SÜSS MicroTec AG
Redaktion	Finance, Julia Natterer Investor Relations, Franka Schielke
Wirtschaftsprüfer	KPMG Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung	Whitepark GmbH & Co., Hamburg
Druck	Druckerei BluePrint Group, München
Fotos	Michael Lange, SÜSS MicroTec AG

KONTAKT

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

Investor Relations
Telefon: +49 (0)89-32007-161
E-Mail: ir@suss.com

Zukunftsorientierte Aussagen: Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.

SÜSS MicroTec AG
Schleißheimer Straße 90
85748 Garching, Deutschland
Telefon: +49 (0)89-32007-0
E-Mail: info@suss.com

www.suss.com